



股票代碼：6202

盛群半導體股份有限公司

一〇七年度年報

刊印日期：中華民國一〇八年四月十五日

臺灣證券交易所公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司揭露年報相關資料之網址：<http://www.holtek.com.tw>

一、發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

姓 名：蔡榮宗
職 稱：業務行銷中心副總經理
聯絡電話：(03)563-1999
電子郵件信箱：armstro@holtek.com.tw

二、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

姓 名：廖明通
職 稱：財務會計處經理
聯絡電話：(03)563-1999
電子郵件信箱：eliao@holtek.com.tw

三、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司地址：新竹市科學工業園區研新二路 3 號
電 話：(03)563-1999
分公司地址：香港九龍長沙灣道 777-779 號天安工業大廈三字樓 A 座
Block A, 3/F Tin On Industrial Building
777-779 Cheung Sha Wan Rd.
Kowloon, Hong Kong
電 話：852-2745-8288
台北營業處：台北市南港區園區街 3 之 2 號 4 樓之 2
電 話：(02)2655-7070
大陸營業處：合泰半導體(中國)有限公司
中國東莞松山湖新竹路 4 號新竹苑 10 幢
電 話：86-769-2626-1300

四、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部
地 址：台北市博愛路 17 號 3 樓
網 址：www.sinotrade.com.tw
電 話：(02)2381-6288

五、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：曾漢鈺會計師、游萬淵會計師
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
地 址：台北市信義路五段 7 號 68 樓（台北 101 大樓）
網 址：www.kpmg.com.tw
電 話：(02)8101-6666

六、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式
無

七、公司網址

www.holtek.com.tw

盛群半導體股份有限公司

一〇七年度年報

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司簡介	
一、設立日期	3
二、公司沿革	3
參、公司治理報告	
一、組織系統	5
二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	8
三、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金	11
四、公司治理運作情形	17
五、會計師公費資訊	36
六、更換會計師資訊	36
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之情形	36
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	37
九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	38
十、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	39
肆、募資情形	
一、資本及股份	40
二、公司債	44
三、特別股	44
四、海外存託憑證	44
五、員工認股權憑證	44
六、限制員工權利新股	44
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	44
八、資金運用計畫執行情形	44

伍、營運概況

一、業務內容-----	45
二、市場及產銷概況-----	54
三、從業員工-----	60
四、環保支出資訊-----	60
五、勞資關係-----	60
六、重要契約-----	62

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表-----	63
二、最近五年度財務分析-----	67
三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告-----	69
四、最近年度財務報告-----	69
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告-----	69
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財 務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響-----	69

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況-----	181
二、財務績效-----	182
三、現金流量-----	183
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	183
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及 未來一年投資計畫-----	183
六、風險事項分析-----	184
七、其他重要事項-----	186

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料-----	187
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形-----	193
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票 情形-----	193
四、其他必要補充說明事項-----	193
五、依證券交易法第 36 條第三項第二款規定應揭露事項-----	193

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

盛群半導體股份有限公司（以下簡稱本公司）至 2018 年已成立二十年，二十年期間面臨了千禧年、全球金融海嘯或歐債危機等各種國際經濟情勢威脅，在經營團隊與全體同仁努力，不斷開發出新 IC 產品，並加強技術創新下，所推出之 MCU 及週邊 IC 均能符合最新產品應用趨勢，具有市場高競爭力，始保每年維持穩定獲利並屢創佳績。

2018 年仍充滿挑戰與各種威脅；包括中美貿易摩擦、全球經濟成長放緩，加上晶圓代工廠商漲價，致生產成本不斷攀升，以及大陸半導體產業不斷擴張，對本公司造成不利衝擊；所幸全球市場因記憶體／車載／智慧家庭／安全防護／物聯網等應用領域蓬勃發展，本公司才能續創營收及獲利之新高。另外，本公司因卓越的營運績效及財務結果，榮獲全球半導體協會 GSA 頒發之 2018 年最佳財務管理半導體公司獎，為臺灣唯一之獲獎公司，獲此殊榮實屬不易。

2018 年本公司全年營收為新台幣（以下同）48.6 億元；較 2017 年的 46.1 億元增加 5%，受惠於產品組合改善，毛利率提升至 49.2%，且歸屬母公司稅後淨利達 10.6 億元，較前一年度 9.3 億元成長 15%，為本公司成立以來之獲利新高，每股稅後盈餘達 4.7 元。本公司整體之 MCU IC 年度營收 37 億元，其中，觸控應用 MCU 年度出貨數量超過 1.3 億顆，出貨成長 8%；32 位元 MCU 達到年銷 1,600 萬顆以上，成長高達 42%；以上優異成績均顯示本公司無論在產品開發、銷售通路、產品品質與技術服務等各方面逐漸獲得全球客戶與市場的高度肯定。

2018 年本公司整體營運概況，分別從產品開發／業務／生產等方面簡要說明如下：

產品開發方面：

2018 年本公司產品開發主要著重於穿戴產品週邊零件整合、健康量測、智能家居及安全防護等應用產品，以公司自有 HT 8 位元與 Arm 32 位元（M0 +／M3）為核心開發一系列 Standard／ASSP／ASIC MCU；2018 年共推出了 51 項各類新型 MCU 及週邊 IC，主要有：觸控新抗干擾系列、32 位元 Standard／ASSP MCU、快充及無線充電專用 MCU、健康量測專用 MCU（包括體脂秤／血糖計／廚房秤／血壓計／紅外線測溫等）、煙感器／消防／紅外線偵測等專用 MCU，直流無刷／直流有刷馬達控制專用 MCU，及 RF Sub-1G 發射器 IC 與顯示驅動 IC 等，以上新推出之 IC 產品使本公司於各應用領域產品線更加完整，將對營收成長增添更多動能。

業務方面：

本公司 2018 年度營收來自大陸及香港地區佔比 76%，臺灣地區因 PC 產業侷限而營收佔比下降為 10%，海外地區因歐洲 E-banking 及中南美洲業務衰退，佔比降至 14%；表現最好之市場仍是大陸地區，大陸地區 2018 年營收年增 12%，主要原因是大陸仍為全球消費性電子產品生產製造最大的區域外，加上本公司產品銷售渠道深入大陸布局與技術服務到位，貼近大陸晶片市場在地化，進而增加產品導入與市占率提升之機會。

生產方面：

2018 年度本公司總 IC 出貨量成長 5%，其中 MCU 產品出貨量增加超過 8%，2018 年晶圓廠產能吃緊且由於矽晶圓漲價因素，產能調配及成本控制極為重要，業務與生產單位充分密切配合，使產能充分供應客戶市場所需並幸賴生產單位與上下游廠商密切配合成本控制得宜，能順利達成業務與客戶端的交貨需求，維持生產品質及交期的穩定。

2019 年主要營運重點：

展望 2019 年，面對全球經濟成長放緩、中美貿易戰、英國脫歐困難以及大陸 GDP 成長下滑，加上通膨與貨幣緊縮等風險，全球經濟預測普遍下調成長率，因此本公司亦謹慎看待 2019 年的發展，於此，經營團隊除持續切入新產品企劃開發、應用產品市場等面向，並積極加強創新理念，突破全球經濟景氣變化與大陸本土激烈競爭的影響。

產品開發方面，主要重點包括健康量測／RF 無線通訊／安全防護／圖像辨識／電動車與電動工具充電器／32 位元 MCU／BLDC 馬達舵機／家電及物聯網 IoT 與 NB IoT 相關／智能玩具應用模組等，著手開發相關高整合度之 MCU 及週邊 IC，並持續研發投資，加強有關 Sensor 感測模組研發團隊，推升相關感測模塊研究與開發，進而強化本公司在各類應用產品及 IoT 物聯網應用產品的完整性與競爭力。

業務方面，積極推廣現有 MCU 及週邊 IC 應用在家電／居家安防／個人穿戴／鋰電池手持應用／車載／各類儀表等領域，努力推廣歐／美／日／韓等國家的客戶外，並加強開拓新興發展中國家的新市場與新客戶，持續深入並擴大市場找出潛在顧客。2019 年業務布局重點除了加大力道執行印度在地化銷售推廣與技術服務外，亦將積極拓展東南亞地區(越南／泰國／印尼等新南向政策國家)市場分析與推廣作業，除降低產品銷售過度集中在大陸單一風險，並藉以擴大全球市場市佔率，持續增加營收動能。

生產方面，生產單位與產品開發部門積極針對本公司既有產品的製程技術及代工產能資源進行檢討，不斷提升製程技術及分散產能，讓本公司生產成本持續有效降低以彌補晶圓上漲成本增加的衝擊，兼顧產品品質，加強可靠度，改善生產時間與成本。此外，生產單位亦與長期往來之上下游晶圓代工／封裝／測試等廠商保持密切配合，爭取廠商價格支持及充足產能的支援，並持續提升本公司產品成本競爭力及交貨服務滿意度。

2019 年本公司將投入更多資源開發客戶所需高階 MCU 產品，生產方面發揮有效率配合，本公司所有同仁秉持一貫穩健且積極務實同心協力的做事理念執行各項工作任務；即使面對全球經濟負面發展，及大陸半導體產業強勢競爭及困難挑戰，本公司經營團隊在 2019 年仍會全力以赴落實各項工作，期能繼續創造營業向上成長的佳績，並為下一個二十年的願景目標勇往直前。

在此衷心感謝各位股東長期給予信賴與肯定，經營團隊將持續秉持研發創新的理念，深耕於各應用領域之 MCU 產品，並創造穩定成長的實質獲利回饋給所有股東。

祝福全體股東 健康如意、平安喜樂、財源廣進!

董事長

吳啟勇



總經理

高國棟



貳、公司簡介

一、 設立日期：民國八十七年十月一日。

二、 公司沿革

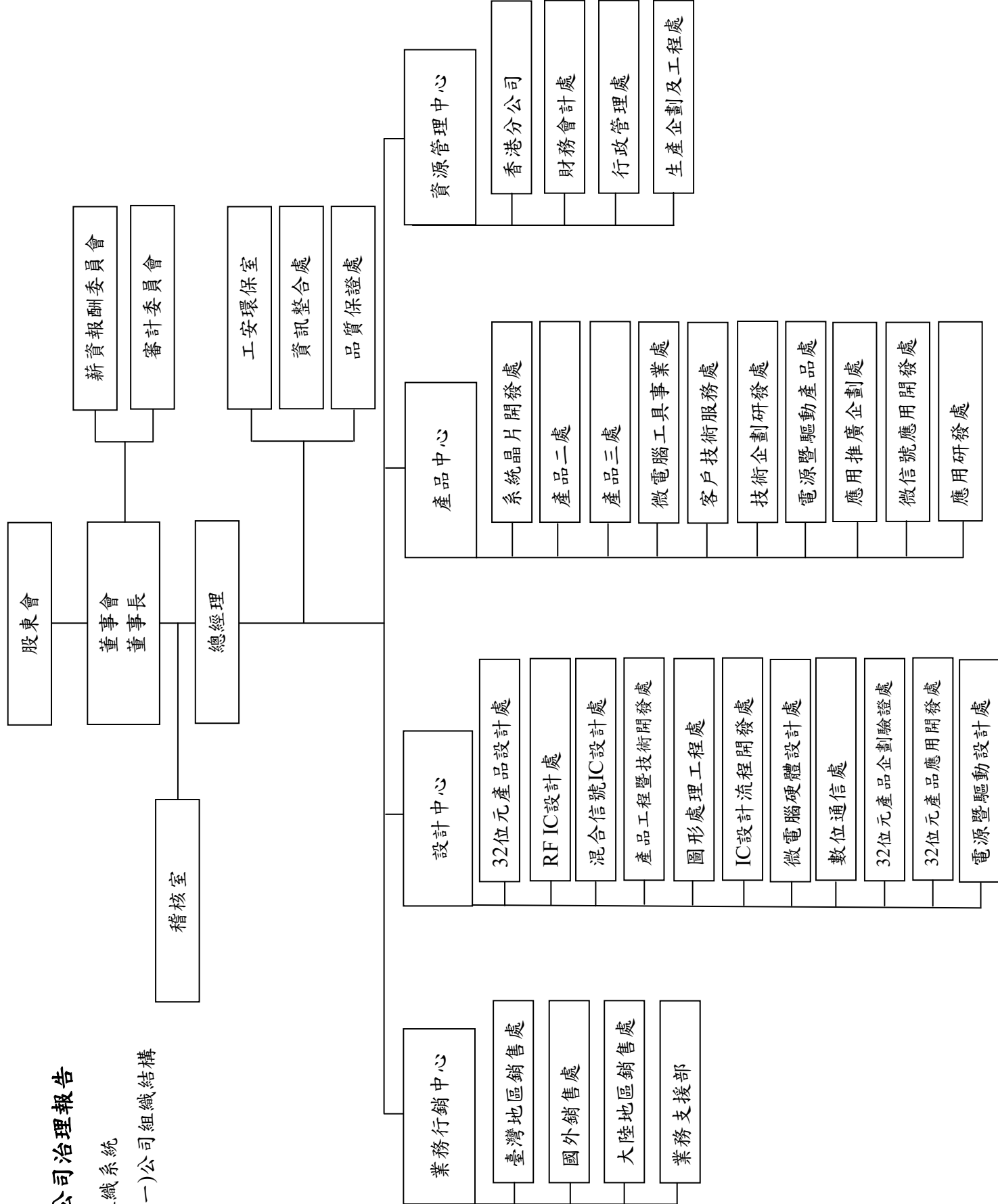
民國八十七年	十月	盛群半導體公司於新竹科學園區成立，設立實收資本額新台幣四億元。
民國八十八年	三月	現金增資新台幣六億元，實收資本額達新台幣十億元。
民國八十九年	三月	推出公司第一顆符合工業規格等級 8-bit OTP MCU。
	四月	設立香港分公司，從事香港及部份海外地區發貨及倉儲作業。
	五月	經財政部證券暨期貨管理委員會核准股票公開發行。
		通過國際 ISO 9001 品保認證。
民國九十年	三月	設立上海子公司（盛揚半導體(上海)有限公司），從事大陸地區 IC 銷售業務及提供技術支持與諮詢服務。
	五月	設立美國子公司（Holtek Semiconductor (USA), Inc.），從事北美地區 IC 銷售業務及提供技術支持與諮詢服務。
民國九十一年	八月	經財政部證券暨期貨管理委員會核准股票上櫃。
	十月	投資蘇州子公司（金科集成電路(蘇州)有限公司），負責大陸地區生產及出貨服務。
	十一月	股票正式櫃檯買賣。
民國九十二年	七月	通過國際 ISO 14001 環境管理系統驗證。
	八月	取得 SONY”Green Partner”認證。
	九月	獲頒經濟部第十二屆國家發明獎。
民國九十三年	九月	股票正式上市買賣。
	十二月	GSA 頒發 Outstanding Financial Performance Award。
民國九十四年	六月	取得華碩”Green Partner”認證。
	九月	取得經濟部核定在臺設立研發中心計劃。
	十月	取得三星電子”ECO Partner”認證。
	十一月	首屆盛群盃 MCU 校園競賽於臺灣地區舉行。
	十二月	取得經濟部核定在臺設立營運總部。
民國九十五年	五月	首屆盛群盃 MCU 校園競賽於大陸地區舉行。
	十一月	通過國際 OHSAS 18001 職業安全衛生管理認證。
民國九十六年	一月	推出公司第一顆符合工業規格等級 8-bit Flash MCU。
	五月	通過 IECQ QC080000HSPM 國際認證。
	十二月	Holtek 無線 USB 語音傳輸晶片 HT82A850R/HT82A851R 榮獲中國電子業界創新大獎。
民國九十七年	二月	投資廈門子公司（芯群集成電路(廈門)有限公司），負責大陸地區 IC 及微控制器應用工具技術支持與諮詢服務。
民國九十九年	一月	推出公司第一顆整合型 8-bit Touch Flash MCU。
民國一〇〇年	五月	盛揚半導體(上海)有限公司遷移至深圳，更名為盛揚半導體(深圳)有限公司，從事大陸地區 IC 銷售及技術支持服務。
	六月	推出公司第一顆 Arm® Cortex™-M3 32-bit Flash MCU。
	七月	取得經濟部核定在臺設立營運總部。
	十月	推出 Touch Key Flash MCU with LED / LCD Driver。
	十二月	公司 8-bit MCU 營收佔全球排名第 18 名。

民國一〇一年	六月	盛揚半導體(深圳)有限公司營運據點遷移，並於東莞松山湖設立子公司（合泰半導體(中國)有限公司），從事大陸地區 IC 銷售業務及提供技術支持與諮詢服務。
	十二月	公司 8-bit MCU 營收佔全球排名第 14 名。 101 年度新推出產品： (1) Smoke Detector ASSP Flash MCU。(2) Power Bank ASSP Flash MCU。
民國一〇二年	九月	合泰半導體(中國)有限公司北京辦事處成立，負責大陸華北地區之銷售及技術服務。 合泰半導體(中國)有限公司杭州辦事處成立，負責大陸華東及華中地區之銷售及技術服務。 合泰半導體(中國)有限公司順德辦事處成立，負責大陸順德地區之銷售及技術服務。
	十一月	通過 WPC 聯盟 Qi 標準。
	十二月	公司 8-bit MCU 營收佔全球排名第 12 名。 102 年度新推出產品： (1) 20-bit A/D + LCD Flash MCU。(2) Blood Pressure Meter ASSP Flash MCU。(3) Glucose Meter ASSP Flash MCU。
民國一〇三年	七月	推出全球最薄 6.5mm 及 4.9mm 光學式指紋辨識系列產品。 全球第五家擁有 UL 60730-1(家庭用電器用品安全機制)軟體認證的半導體公司。 取得經濟部核定在臺設立營運總部。
	十一月	無線充電微控制器 IC 取得 WPC 無線充電聯盟 Qi 規格認證。
	十二月	103 年度新推出產品： (1) 1.8V~5.5V Flash MCU。(2) 24-bit A/D LCD Flash MCU。(3) Wireless Power Transmitter (Qi) ASSP Flash MCU。(4) Body Fat ASSP Flash MCU。
民國一〇四年	三月	獲選第三屆中堅企業潛力企業。
	九月	移動電源微控制器 IC 取得 UL QC2.0 規格認證。
	十二月	盛群盃 HOLTEK MCU 創意大賽邁入第十屆擴大舉辦。 104 年度新推出產品： (1)全球最薄 1mm，擁有超高解析度且唯一量產的光電混合式指紋辨識感測器。(2) Arm® Cortex™-M0+ 之 32 位元 Flash MCU。(3) Fast Charge Power Bank MCU。
民國一〇五年	二月	盛群宣佈與 Sony Mobile 簽署合作意向書。 105 年度新推出產品： (1) 96MHz 高效能 Arm® Cortex™-M3 32 位元 Flash MCU。(2) BLE 透傳模組。(3) Sub-1GHz Tx/Rx SoC & IC。
民國一〇六年	四月	榮獲第三屆公司治理評鑑上市公司得分前百分之五。
	七月	取得經濟部核定在臺設立營運總部。
	十二月	公司 8-bit MCU 營收佔全球排名第 9 名。 106 年度新推出產品： (1) 一系列 Arm® Cortex®-M3 MCU、M0+ 5V MCU 及 Bridge MCU。 (2) A/D NFC™ MCU、Sub-1 GHz 超再生 Rx SoC MCU 及長距離 LoRa® 等產品。(3) USB Type-C PD ASSP MCU 及 15W 無線充電 Tx ASSP MCU。
民國一〇七年	十二月	盛群榮獲 GSA 頒發之 107 年最佳財務管理半導體公司獎。

參、公司治理報告

一、組織系統

(一)公司組織結構



(二)各主要部門所營業務

部 門	主要職掌
稽核室	全公司業務及行政之稽核。
工安環保室	工安、消防安全、醫療保健及環境保護等相關事宜。
資訊整合處	資訊系統開發架構、資安管理規劃、網路/硬體設施管理。
品質保證處	進出貨檢驗，外包廠品質監控與評鑑，品質活動推行，儀器校正作業，產品可靠度測試及客訴服務。
臺灣地區銷售處	臺灣地區產品推廣及銷售、Agent/Third party/客戶管理及技術服務。
國外銷售處	海外地區技術引進/情報收集、Agent/Third party/客戶管理、技術支援、產品推廣銷售與服務。
大陸地區銷售處	大陸地區市場開發、市場分析產品行銷及所屬代理商管理。
業務支援部	產品庫存之調節管理、業務資訊分析及產品訂價與成本管理。
32 位元產品設計處	32 位元微處理器之相關 IC/IP 設計開發與整合。
RF IC 設計處	無線射頻接收機系統設計、整合和研發。
混合信號 IC 設計處	(A)Analog IC/IP、Memory IC/IP、Digital Cell Library/IP 技術評估及電路設計。 (B)Special I/O 電路設計及 ESD/Latch-up Cell 標準化。
產品工程暨技術開發處	靜電防護工程與產品工程之評估、管理及驗證等。
圖形處理工程處	(A)圖形處理自動化環境及圖形資料庫之建立。 (B)光罩委外製作及圖形佈局工作。
IC 設計流程開發處	(A)設計工具、設計流程及測試工程等研發環境整合與技術支援。 (B)研發及委外測試技術之協調，並將測試流程導入量產及管理。
微電腦硬體設計處	MCU 產品設計技術之策略規劃及產品設計計劃管理。
數位通信處	數位信號處理器開發、數位信號處理演算法開發、通信系統架構分析與模擬、數位調變/解調技術開發、基頻資料封包處理/鏈結層控制器開發。
32 位元產品企劃驗證處	32 位元微處理器產品企劃工作，制定規格並執行相關功能驗證。
32 位元產品應用開發處	提供 32-bit MCU 平台之軟體及應用增值服務。
電源暨驅動設計處	電源驅動 IC 之設計評估及電路設計。
系統晶片開發處	影像及音頻訊號處理之系統技術建立與 SOC 開發。
產品二處	8-bit MCU 之規劃、開發及產品推廣。
產品三處	(A)統籌標準 MCU、嵌入式 MCU、特定產品專用 ASSP MCU、MCU 週邊相關 ASIC 等 IC 產品開發技術，前瞻產品技術之搜尋，關鍵技術研究，關鍵性 IP 建立。 (B)VFD/LED/LCD Display Controller/Driver IC 的相關規格制定、設計開發、產品驗證及軟、硬體技術支援。
微電腦工具事業處	專案技術開發、新技術評估與導入、工具開發技術評估；客服問題處理、落實改善計畫；實驗室維護管理、零件採購與寄送。
客戶技術服務處	對客戶需求提供技術及產品應用整合工作。

部 門	主要職掌
技術企劃研發處	(A)統籌標準 MCU、嵌入式 MCU、特定產品專用 ASSP MCU 等相關 IC 產品開發技術相關事宜，包含產品系統技術分析、IC 市場與技術開發評估、IC 規格技術企劃、IC 應用驗證、產品系統驗證、產品應用開發、技術文件及後續產品推廣技術服務等事項。 (B)前瞻產品技術之搜尋、關鍵技術研究、關鍵性 IP 建立與提升產品層次及競爭力。
電源暨驅動產品處	電源驅動 IC 之市場企劃、設計開發及新產品推廣。
應用推廣企劃處	(A)網站美術設計及運作維護。 (B)推廣文件、影片美術設計。 (C)技術文件編譯及翻譯。 (D)產學合作。
微信號應用開發處	傳感器產品應用開發、特定產品專用 ASSP MCU 產品開發、IP 建立。
應用研發處	新產品應用技術前置研發與執行、建立解決方案等。
香港分公司	從事香港及部份海外地區發貨及倉儲業務。
財務會計處	財會與稅務管理、轉投資管理、資金管理、客戶信用管理、進出口保稅管理、股務及投資人關係等。
行政管理處	人力資源管理、採購總務管理、法務與智財權管理。
生產企劃及工程處	統籌委外採購及封裝/測試委工、倉儲/物流管理、工具製造、封裝/測試工程等作業事宜；產銷協調，訂單交期及訂單監控，配貨出貨及貨源調配安排。

二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

日期：108 年 3 月 31 日 單位：股

職稱	國籍 或 註冊地	姓名	性別	選就任 日期	任期	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人	
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率				
董事長	中華民國	吳敏勇	男	1080527	3年	870907	7,665,809	33.9%	7,665,809	33.9%	2,745,598	1.21%	-	-	逢甲大學電子工程系 盛群公司董事長	盛群公司董事長 Holtek Semiconductor Holding (BV/I) Ltd.、Kingtek Semiconductor Holding (BV/I) Ltd.、BestComm RFI Electronics Inc.、金科集成電路(蘇州)等公司之法 人董事代表、盛凌投資、芯群集成電路(廈門)、 合泰半導體(中國)、盛通科技、優力科技、倍創 科技等公司之董事長、超豐電子(股)公司獨立董 事	-	-
董事	中華民國	高國棟	男	1080527	3年	870907	6,701,176	2.96%	6,701,176	2.96%	-	-	-	-	華夏工專電子工程科 盛群公司總經理	盛群公司總經理 Holtek Semiconductor Holding (BV/I) Ltd.、Kingtek Semiconductor Holding (BV/I) Ltd.、MCU Holdings Ltd.、Signos Holdings Ltd.、Holtek Semiconductor (USA) Inc.、Holtek Semiconductor (India) Private Limited、合泰半導體(中國)、芯群集成電路(廈 門)、芯通電子科技(東莞)、悠健電子(東莞)、盛 凌投資、盛通科技、倍創科技、欣宏電子、金生 科技等公司之法人董事代表、金科集成電路(蘇 州)有限公司董事長暨總經理	-	-
董事	中華民國	張 治	男	1080527	3年	930601	1,111,785	0.49%	1,111,785	0.49%	276,389	0.12%	-	-	成功大學電機所 盛群公司設計及產品中心執行副總	盛群公司設計及產品中心執行副總經理 金科集成電路(蘇州)、芯群集成電路(廈門)、盛 凌投資等公司之法人董事代表	-	-
董事	中華民國	林正鋒	男	1080527	3年	870907	1,842,697	0.81%	1,842,697	0.81%	290,513	0.13%	-	-	逢甲大學電子系 盛群公司總經理室副總經理	盛群公司總經理室副總經理 Signos Holdings Ltd.、MCU Holdings Ltd.、Best Health Electronics Corporation、Best Power Electronics Corporation等公司之法人董事代表	-	-
董事	中華民國	李佩榮	女	1080527	3年	990615	1,013,093	0.45%	1,013,093	0.45%	630	0.00%	-	-	加州大學河濱分校企管所 盛群公司資源管理中心副總經理	無	-	-
董事	中華民國	王仁宗	男	1080527	3年	930601	2,137,209	0.94%	2,137,209	0.94%	1,500,000	0.66%	-	-	清華大學科管所	定耀科技(股)公司法人董事代表	-	-
獨立 董事	中華民國	呂正樂	男	1080527	3年	910417	-	-	-	-	-	-	-	-	東吳大學會計研究所 亞東聯合會計師事務所合夥會計師	亞東聯合會計師事務所合夥會計師 元楨企業(股)公司獨立董事	-	-
獨立 董事	中華民國	邢智田	男	1080527	3年	930601	-	-	36,000	0.02%	-	-	-	-	美國佛羅里達大學電機博士 廣達電腦(股)公司資深副總暨廣達 研究院院長	波若威科技(股)公司獨立董事、和詮科技(股)公 司獨立董事	-	-
獨立 董事	中華民國	郭泰豪	男	1080527	3年	1050527	-	-	-	-	-	-	-	-	美國馬里蘭大學電機工程博士	成功大學電機工程學系教授 南茂科技(股)公司獨立董事	-	-

(二)董事所具專業知識及獨立性情形

姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形（註）										兼任 其他 公開 發行 公司 獨立 董事 家數
		商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
吳啟勇			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
高國棟			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
張 治			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
林正鋒			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
李佩縈			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
王仁宗			✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
呂正樂			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
邢智田			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2
郭泰豪	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1

註：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9)未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

(三)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

日期：108 年 3 月 31 日 單位：股

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份	利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股份率		股數	持股份率			職稱	姓名	關係
總經理	中華民國	高國棟	男	87/10/01	6,701,176	2.96%	-	-	-	華夏工專電子工程科	Holtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、Kingtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、MCU Holdings Ltd.、Signos Holdings Ltd.、Holtek Semiconductor(USA) Inc.、Holtek Semiconductor(India) Private Limited、合泰半導體中國、芯群集成電路(廈門)、芯通電子科技(東莞)、悠健電子(東莞)、盛凌投資、盛通科技、倍創科技、欣宏電子、金信科技等公司之法人董事代表、金料集成電路(蘇州)有限公司董事長暨總經理	-	-	-
設計及產品中心執行副總經理	中華民國	張 治	男	87/12/11	1,111,785	0.49%	276,389	0.12%	-	成功大學電機所	金料集成電路(蘇州)、芯群集成電路(廈門)、盛凌投資等公司之法人董事代表	-	-	-
總經理室副總經理	中華民國	林正鋒	男	87/12/11	1,842,697	0.81%	290,513	0.13%	-	逢甲大學電子系	Signos Holdings Ltd.、MCU Holdings Ltd.、Best Health Electronics Corporation、Best Power Electronics Corporation 等公司之法人董事代表	-	-	-
資源管理中心副總經理(註)	中華民國	李佩縈	女	92/01/06	1,013,093	0.45%	630	0.00%	-	加州大學河濱分校企管所	無	-	-	-
業務行銷中心副總經理	中華民國	蔡榮宗	男	99/06/15	322,684	0.14%	241,580	0.11%	-	逢甲大學自動控制系	Holtek Semiconductor(USA) Inc.、Santek Holdings Ltd.、新禾(廈門)電子、Newtek Electronics Ltd.、新鼎電子(深圳)、New Wave Electronics Holding Ltd.、Truetek Technology Ltd.、信霖電子商貿(上海)、E-Micro Technology Holding Ltd.、振揚電子(青島)、Forti Electronics Holding Ltd.、華榮匯電子科技(北京)、Crown Rich Technology Holding Ltd.、華瑞昇電子(深圳)、Qranding Technology Holding Ltd.、全鼎電子(蘇州)、金鑫高科、倍創科技、欣宏電子、鉅威科技等公司之法人董事代表、合泰半導體中國有限公司法人董事代表暨總經理、Holtek Semiconductor (India) Private Limited 法人董事代表暨總經理	-	-	-
品質保證處協理	中華民國	吳紹嵩	男	92/06/23	103,845	0.05%	10,080	0.00%	-	東海大學物理系	無	-	-	-
設計中心協理	中華民國	吳德傳	男	94/04/15	1,242,317	0.55%	-	-	-	成功大學電子研究所	無	-	-	-
設計中心協理	中華民國	余國成	男	100/05/02	131,654	0.06%	29,839	0.01%	-	逢甲大學電子系	無	-	-	-
產品中心協理	中華民國	王鈺鈿	男	98/07/01	393	0.00%	-	-	-	成功大學電機所	無	-	-	-
產品中心協理	中華民國	王明坤	男	100/04/01	175,349	0.08%	-	-	-	臺灣技術學院電子系	BestComm RF Electronics Inc.、盛通科技、芯通電子科技(東莞)、派達科技、Bestway Electronics Inc.、新緯科技(深圳)、Fine Chip Electronics Inc.、健芳電子科技(上海)、Anchip Technology Corporation、安德普電子科技(東莞)、JXY Electronics Corporation、安禧普電子科技(東莞)、JXY Electronics Corporation、源電子、Best Health Electronics Corporation、悠健電子(東莞)、Best Power Electronics Corporation、Best Solution Electronic Inc.、優力科技等公司之法人董事代表	-	-	-
產品中心協理	中華民國	劉源河	男	106/01/01	50,422	0.02%	10,000	0.00%	-	臺北工業專科學校電子科	無	-	-	-
會計主管	中華民國	廖明通	男	107/06/01	12,000	0.01%	-	-	-	中興大學會計系	金料集成電路(蘇州)、合泰半導體中國、芯群集成電路(廈門)、芯通電子科技(東莞)、安德普電子科技(東莞)、悠健電子(東莞)、新禾(廈門)電子、諾華達電子(深圳)、信霖電子商貿(上海)、振揚電子(青島)、華榮匯電子科技(北京)、全鼎電子(蘇州)、健芳電子科技(上海)、深圳市集芯源電子、盛凌投資、盛通科技、倍創科技等公司之法人監察人代表	-	-	-
財務主管				108/02/01										

註：李佩榮副總經理於108年3月29日因個人規劃辦理退休。

三、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

(一)董事(含獨立董事)之酬金

		日期：107 年 12 月 31 日										單位：新台幣仟元						
職稱	姓名	董事酬金				A、B、C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例(註 10)		兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例(註 10)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註 11)				
		報酬(A)(註 2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註 3)		業務執行費用(D)(註 4)		薪資、獎金及特支費等(E)(註 5)		退職退休金(F)			員工酬勞(G)(註 6)		本公司	財務報告內所有公司(註 7)
		本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	現金金額	股票金額					
董事長	吳啟勇																	
董事	高國棟																	
董事	張 治																	
董事	林正鋒																	
董事	李佩榮	0	0	0	0	14,248	14,248	0	0	15,648	15,648	0	0	6,810	0	3.45%	0	
董事	王仁宗																	
獨立董事	呂正樂																	
獨立董事	邢智田																	
獨立董事	郭泰豪																	

*除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

*除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名				
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)		
	本公司(註8)	財務報告內所有公司(註9)	本公司(註8)	財務報告內所有公司(註9)	
低於 2,000,000 元	吳啟勇、高國棟、張治 林正鋒、李佩縈、王仁宗 呂正樂、邢智田、郭泰豪	吳啟勇、高國棟、張治 林正鋒、李佩縈、王仁宗 呂正樂、邢智田、郭泰豪	王仁宗、呂正樂、邢智田 郭泰豪	王仁宗、呂正樂、邢智田 郭泰豪	
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—	—	—	
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—	吳啟勇、高國棟、張治 林正鋒、李佩縈	吳啟勇、高國棟、張治 林正鋒、李佩縈	
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—	—	—	
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—	—	—	
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—	—	—	
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—	—	—	
100,000,000 元以上	—	—	—	—	
總計	9	9	9	9	9

註1：董事姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：係填列最近年度董事會通過分派之董事酬勞金額。

註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。

註5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者配車等實物提供等等。

註6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註11：揭露公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

(二)總經理及副總經理之酬金

日期：107 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註 2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等 等(C)(註 3)		員工酬勞金額(D) (註 4)				A、B、C 及 D 等 四項總額占稅後純 益之比例(%) (註 8)		有無領取來自 子公司以外轉 投資事業酬金 (註 9)
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公司		財務報告內所有 公司(註 5)		本公司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	
董事長	吳啟勇	13,173	13,173	0	0	5,683	5,683	8,399	0	8,399	0	2.56%	2.56%	0
總經理	高國棟													
副總經理	張 治													
副總經理	林正鋒													
副總經理	李佩榮													
副總經理	蔡榮宗													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註 6)	財務報告內所有公司(註 7)
低於 2,000,000 元	—	—
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	吳啟勇、高國棟、林正鋒 蔡榮宗	吳啟勇、高國棟、林正鋒 蔡榮宗
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	張 治、李佩縈	張 治、李佩縈
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	6	6

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。

註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：揭露公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

日期：107 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	董事長	吳啟勇	0	15,963	15,963	1.50%
	總經理	高國棟				
	設計及產品中心 執行副總經理	張治				
	總經理室 副總經理	林正鋒				
	資源管理中心 副總經理	李佩縈				
	業務行銷中心 副總經理	蔡榮宗				
	品質保證處協理	吳紹菡				
	設計中心協理	吳德傳				
	設計中心協理	余國成				
	產品中心協理	王鈺鈿				
	產品中心協理	王明坤				
	產品中心協理	劉源河				
	會計主管	廖明通				

註 1：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 2：經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

(四)比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析，並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

職 稱	支付酬金總額占個體財務報告稅後純益比例	
	106 年	107 年
董事	3.71%	3.45%
總經理及副總經理	2.65%	2.56%

1.董事酬金給付政策及訂定酬金之程序：

依本公司章程第二十四條規定：公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一．五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

由薪資報酬委員會討論依各董事執行業務程度於上述金額內分配董事酬金，再提交董事會決議。

2.總經理及副總經理酬金給付政策及訂定酬金之程序

(1)本公司訂有人事薪資制度，總經理及副總經理之薪資依公司制度由人事單位予以考核，並送交總經理室會議中予以評定，並呈送薪資報酬委員會討論通過提交董事會決議，人事薪資制度參考因素主要為執行業務內容、經歷與績效及貢獻度，其中尤以績效及貢獻度為著。

(2)本公司章程規定年度分派員工酬勞，由人事單位依據人事薪資制度、績效評估辦法、獎懲辦法及員工守則，參考因素主要為職務內容、績效及未來貢獻度，尤以績效及未來貢獻度比重最大，送交總經理室會議中予以評定。

(3)上述之總經理、副總經理及協理級經理人之薪資及員工酬勞於總經理室會議中予以核定後，呈薪資報酬委員會討論通過並提交董事會決議。

3.給付酬金與經營績效及未來風險之關聯性

(1)董事酬勞係依據在本公司擔任之職位及對本公司營運參與程度及貢獻之價值核發。

(2)總經理及副總經理之酬金，係依據職位、對公司的貢獻度及參考同業水準，依本公司人事規章辦理。

依據本公司訂定董事會績效評估辦法，將經營績效時所需考量未來風險發生之可能性及關聯性減至最低，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以落實風險與報酬之管理平衡。

四、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：107 年度董事會開會 6 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
董事長	吳啟勇	6	0	100%	
董事	高國棟	6	0	100%	
董事	張治	5	1	83%	
董事	林正鋒	6	0	100%	
董事	李佩縈	6	0	100%	
董事	王仁宗	5	1	83%	
獨立董事	呂正樂	6	0	100%	
獨立董事	邢智田	5	1	83%	
獨立董事	郭泰豪	6	0	100%	

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

董事會日期	議案內容	所有獨立董事意見及後續處理
107.01.29 第七屆第 11 次	1.本公司 106 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 2.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。	左列議案獨立董事未表示反對或保留意見，且議案均經全體董事同意通過。
107.03.01 第七屆第 12 次	1.討論解除董事競業禁止案。 2.本公司出具內部控制制度聲明書案。 3.本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案。	
107.04.30 第七屆第 13 次	1.MCU Holdings Ltd.轉投資 Best Power Electronics Corporation 案。 2.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。	
107.05.28 第七屆第 14 次	1.本公司會計主管委任案。 2.本公司內部稽核主管委任案。 3.永豐銀行新竹分行短期額度申請案。 4.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。	
107.07.30 第七屆第 15 次	1.本公司處分金佶科技股份有限公司投資案。 2.討論解除董事競業禁止案。 3.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。	
107.10.29 第七屆第 16 次	1.本公司擬購買董監事及經理人責任保險案。 2.本公司 108 年稽核作業風險評估報告及年度稽核計畫案。 3.改派轉投資公司法人董事代表人與總經理及討論解除董事競業禁止案。 4.改派轉投資公司法人董事代表人及討論解除經理人競業禁止案。 5.本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。	

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：本公司訂定「董事會議事規則」及「董事會績效評估辦法」，已於 100 年 10 月 25 日成立薪資報酬委員會，並於 105 年 5 月 27 日成立審計委員會，以提升董事會運作效能。

(二)審計委員會參與董事會運作情形：

本公司審計委員會由 3 位獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。

審計委員會審議的事項包括：內部控制制度、稽核及會計政策與程序、涉及董事自身利害關係事項、重大資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、簽證會

計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免、公司財務報表、公司併購事項等。
107 年度審計委員會開會 6 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備 註
獨立董事	呂正樂	6	0	100%	
獨立董事	邢智田	5	1	83%	
獨立董事	郭泰豪	6	0	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

董事會 日期	議案內容	所有獨立董事意 見及後續處理
107.01.29 第七屆第 11 次	1.本公司 106 年第 4 季稽核查核報告案。 2.本公司 106 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 3.本公司 106 年合併財務報告及個體財務報告案。	左列議案獨立 董事未表示反 對或保留意見，且議案均經 審計委員會全體委員及全體 董事同意通過。
107.03.01 第七屆第 12 次	1.本公司 107 年 1 月份稽核查核報告案。 2.本公司 106 年度營業報告書案。 3.本公司 106 年度盈餘分派案。 4.本公司法定盈餘公積配發股東現金案。 5.本公司出具內部控制制度聲明書案。 6.本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案。	
107.04.30 第七屆第 13 次	1.本公司 107 年 2 月至 3 月份稽核查核報告案。 2.本公司 107 年第 1 季合併財務報告案。 3.MCU Holdings Ltd.轉投資 Best Power Electronics Corporation 案。	
107.05.28 第七屆第 14 次	1.本公司 107 年 4 月份稽核查核報告案。 2.本公司會計主管委任案。 3.本公司內部稽核主管委任案。 4.永豐銀行新竹分行短期額度申請案。	
107.07.30 第七屆第 15 次	1.本公司 107 年 5 月至 6 月份稽核查核報告案。 2.本公司 107 年第 2 季合併財務報告案。 3.訂定本公司 106 年度盈餘分派之除息基準日及現金股利發放日案。 4.訂定本公司法定盈餘公積發放現金基準日案。 5.本公司處分金佶科技股份有限公司投資案。 6.討論解除董事競業禁止案。	
107.10.29 第七屆第 16 次	1.本公司 107 年第 3 季稽核查核報告案。 2.本公司 107 年第 3 季合併財務報告案。 3.本公司擬購買董監事及經理人責任保險案。 4.本公司 108 年稽核作業風險評估報告及年度稽核計畫案。 5.本公司 108 年營運計劃書案。 6.改派轉投資公司法人董事代表人與總經理及討論解除董事競業禁止案。 7.改派轉投資公司法人董事代表人及討論解除經理人競業禁止案。	

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

- 1.本公司每年定期召開審計委員會及董事會時，由稽核主管報告稽核業務，及每月將稽核報告呈獨立董事核閱，並將討論事項載明於會議記錄，獨立董事與稽核主管達到充分溝通。
- 2.本公司進行年度財務報表審閱時，由會計師列席審計委員會及董事會，說明財務報告查核情形、重大資產評價及會計估計等，會計師針對董事所提問題進行討論及溝通。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司訂定「公司治理守則」，並揭露於本公司網站與公開資訊觀測站。 無差異。
二、公司股權結構及股東權益			
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一)本公司訂定「股東會議事規則」，並設有發言人制度、投資人關係專責人員及法務單位處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事項，並於本公司網站揭露聯繫方式。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二)本公司掌握董事、經理人及持股百分之十以上股東之持股情形。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三)本公司訂定「對子公司之監理辦法」及「關係人、特定公司及集團企業交易處理辦法」，並建立健全之財務、業務及會計管理制度，且實施必要的控管機制，建立適當的防火牆機制。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四)本公司訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。
三、董事會之組成及職責			
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	V		(一)無差異。 1.本公司訂定之「公司治理守則」第二十條已訂定董事會成員組成之多元化政策。 2.本公司董事會設置九席董事，擔負公司營運及監督之責，其中一席為女性董事，三席為獨立董事，一席為外部個人董事，每位董事各自具備專業背景，包括經營管理、領導決策、產業知識、財務會計及法務等，符合本公司訂定董事會成員組成之多元化政策。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			摘要說明
			1.本公司每年定期審酌簽證會計師之專業資格及獨立性，連同會計師出具超然獨立聲明書，提報至107年3月審計委員會及董事會。 2.本公司經審計委員會及董事會評估簽證會計師無違反職業道德規範公報第十號所規定之情事，二位會計師除簽證相關費用外，未擔任本公司之董事、經理人或重大影響之職務，亦無其他財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，符合獨立性及適任性條件。
四、公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)?	V		本公司由資源管理中心負責公司治理相關事務，主要職責為提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有關於最新法規發展。 107年度業務執行情形如下： 1.辦理董事會及股東會之會議相關事項。 2.製作董事會及股東會議事錄。 3.協助董事持續進修。 4.提供董事執行業務所需之資料。 5.辦理公司登記及變更登記作業。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	V		本公司設有投資人關係專責單位，包括股東、客戶、供應商及投資人公司相關資訊及溝通管道，公司網站亦設置利害關係人專區與各專責人員連絡方式，以回應利害關係人關切之議題(請參閱本年報第23頁(註1))，且每年至少一次向董事會報告執行情形。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V		本公司委任永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理股東會相關事務。
七、資訊公開			
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊?	V		(一)本公司設有中/英文網站(www.holtek.com.tw)，定期揭露財務業務及公司治理資訊。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文	V		(二)無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?		1.本公司指定專人負責公司資訊的蒐集及揭露工作，並建立發言人制度，定期揭露財務業務及公司治理資訊。 2.本公司每季定期召開法人說明會，並將相關資料放置於公開資訊觀測站及本公司網站。	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等)?	V	1.員工權益、僱員關懷：本公司制定各項符合勞工法令規定，以保障員工權益，並定期召開勞資會議，進行有效溝通。本公司設有職工福利委員會定期舉辦活動，包括年節禮券、旅遊、社團活動、員工健康檢查及團體保險等。 2.投資者關係：本公司設有發言人制度及投資人關係專責人員處理股東權益之各項事務。 3.供應商關係：本公司注重供應商本身是否符合國際環保規定及勞工安全衛生規範，致力於綠色供應鏈之建立。 4.利害關係人之權利：本公司網站揭露利害關係人專區，以回應利害關係人關切之議題。 5.董事進修情形：本公司每年規劃董事進修課程，加強專業知識及實務運作，請參閱本年第32頁。 6.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂定內部控制制度並有效執行，以降低各項風險，請參閱本年第184頁~第186頁。 7.公司為董事購買責任保險之情形：本公司經107年10月審計委員會及董事會通過續保董監事責任保險案，107年度投保金額為美金伍佰萬元，並依規定申報於公開資訊觀測站。	無差異。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 本公司公司治理評鑑結果：第一屆、第二屆及第四屆為前20%之公司、第三屆為前5%之公司，未來將持續配合主管機關對於公司治理評鑑之推動及改善，以強化公司治理。			

註1、傾聽利害關係人關切議題及以溝通管道回應

本公司對利害關係人之權利，保持良好之溝通管道，並尊重維護其應有之合法權益，整合內部各組織之努力，有效地實踐企業社會責任的使命。

利害關係人	關切議題	溝通管道或形式
員工	1.員工福利 2.職涯規劃及發展 3.在職訓練	1.公司公告 2.行政部溝通管道 3.勞資會議 4.員工意見箱 5.職工福利委員會 6.醫護人員
客戶	連絡窗口：行政處主管李修銘經理 電話：(03)5631999 分機 1303 1.產品品質及交期 2.工程技術及應用方案能力 3.供應鍵管理 4.銷售服務及隱私	電子郵件：liman1103@holtek.com.tw 1.客戶滿意度調查 2.高階主管客戶拜訪 3.客戶稽核 4.代理商業務會議
股東/投資人	連絡窗口：本公司網站設有利害關係人專區，建立業務單位 1.公司營運概況 2.公司財務資訊 3.公司風險管理 4.公司獲利能力及股利發放 5.公司治理及企業社會責任	1.公司年報 2.股東常會 3.每季法人說明會及不定期受邀之投資論壇 4.公司官網設置利害關係人專區
供應商	連絡窗口：投資人關係暨新聞聯絡人：謝宜叡 電話：(03)5631999 分機 1612 1.無衝突礦產聲明 2.綠色產品落實 3.供應商服務及隱私 4.付款能力及財務風險	電子郵件：ir@holtek.com.tw 1.供應商會議 2.高階主管供應商拜訪 3.供應商滿意度調查 4.供應商稽核及品質檢驗 5.供應商ISO認證
政府機構	連絡窗口：採購李修銘經理 電話：(03)5631999 分機 1303 1.公司重大訊息 2.法令遵循 3.公司資訊揭露 4.公司治理相關議題 5.勞資關係及兩性平等 6.稅賦繳納 7.產業升級	電子郵件：liman1103@holtek.com.tw 1.公文 2.法規說明會 3.公開資訊觀測站 4.即時與主管機關溝通 5.會計師審計及稅務服務 6.法律顧問服務
社會大眾	連絡窗口：投資人關係暨新聞聯絡人：謝宜叡 電話：(03)5631999 分機 1612 1.社會參與及產學合作 2.社會公益及慈善捐款	電子郵件：ir@holtek.com.tw 1.產學合作 2.提供職訓及在學學生企業實習機會 3.年度盛群盃 4.弱勢團體捐款及產品採購
	連絡窗口：投資人關係暨新聞聯絡人：謝宜叡 電話：(03)5631999 分機 1612	電子郵件：ir@holtek.com.tw

(四)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會之職責：

- (1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

2.薪資報酬委員會成員資料

身份別 (註1)	姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形(註2)								兼任其他 公開發行公 司薪資報酬 委員會成員 家數	備註
		商務、法 務、財務、 會計或公 司業務所 需相關料 系之公私 立大專院 校講師以 上	法官、檢察 官、律師、 會計師或其 他與公司業 務所需之國 家考試及格 領有證書之 專門職業及 技術人員	具有商 務、法 務、財 務、會 計或公 司業務 所需之 工作經 驗	1	2	3	4	5	6	7	8		
獨立董事	邢智田			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	
獨立董事	呂正樂		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	
獨立董事	郭泰豪	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	

註：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
- (8)未有公司法第30條各款情事之一。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司薪資報酬委員會由3位獨立董事組成。

(2)第三屆委員任期：105年6月7日至108年5月26日，107年度薪資報酬委員會開會5次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%) (註)	備註
召集人	邢智田	4	1	80%	
委員	呂正樂	5	0	100%	
委員	郭泰豪	5	0	100%	

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

薪資報酬委員會 日期	議案內容	所有獨立董事意見及後續處理
107.01.26 第三屆第9次	1.本公司董事及經理人薪資報酬辦法案。 2.本公司經理人106年度第4季員工季獎金案。 3.本公司經理人106年度第4季年終獎金案。 4.本公司經理人107年度調薪案。 5.本公司經理人107年度第1季每月績效津貼案。 6.本公司經理人107年度每月職等及職位補助案。	左列議案獨立董事未表示反對或保留意見，且議案均經薪資報酬委員會全體委員及全體董事同意通過。
107.04.27 第三屆第10次	1.本公司經理人107年度第2季每月績效津貼案。	
107.05.25 第三屆第11次	1.本公司經理人107年度第1季員工季獎金案。	
107.07.27 第三屆第12次	1.本公司經理人107年度第2季員工季獎金案。 2.本公司經理人107年度第3季每月績效津貼案。 3.本公司106年度董事酬勞及經理人之員工酬勞案。	
107.10.26 第三屆第13次	1.本公司經理人107年度第3季員工季獎金案。 2.本公司經理人107年度第4季每月績效津貼案。	

(五)履行社會責任情形

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
一、落實公司治理 (一)公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效？	V	(一) 本公司訂定「企業社會責任實務守則」並成立企業社會責任委員會，每年定期召開會議設定目標並檢討實施成效。 107年度具體推動計畫及實施成效： 1.榮獲GSA頒發之107年最佳財務管理半導體公司獎。 2.社會公益活動： (1)107年三節禮盒採購弱勢團體禮盒及推廣臺灣自製農產品為主，並積極尋找合適且符合盛群捐助理念的社福團體，例如：創世社會福利基金會、財團法人心路社會福利基金會等。 (2)107年贊助華山基金會、財團法人伊甸社會福利基金會、社團法人台灣視障協會，為地球環境及社會盡一份心力。 (3)本公司員工自發性參與公益活動及捐助，如家扶基金會協助弱勢兒童、陽光基金會協助燒燙傷病人重建等社福團體，協助弱勢族群獲得妥善的照顧。 3.盛群大學計畫：107年捐贈微控制器設備予七所大學院校，市值約新台幣600萬元，至少約培育近3,000名學生至職場就業，透過競賽及教授推薦進入本公司任職共7名學生。。 4.盛群盃創意大賽：107年第十三屆盛群盃競賽免費提供參賽隊伍競賽元件(每套市值約新台幣2,500元)，及活動執行經費等支出共新台幣250餘萬元。	(一)無差異。
(二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？	V	(二)本公司利用內部教育訓練、公司的各項活動聚會來推廣及傳達社會責任。	(二)無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三)公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？	V		任理念。 (三)本公司由資源管理中心負責推動企業社會責任之運作，並由財務部、品質保證處及工安環保室、產學合作推廣部、生產企劃及工程處、行政部等單位協助，包括訂定及檢討企業社會責任政策、定期蒐集相關法令及社會環境發展議題，制定相關因應行動，且每年至少一次向董事會報告推動與執行成效。
(四)公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確有效之獎勵與懲戒制度？	V		(四)本公司訂定「員工守則」、「績效評估辦法」及「獎懲辦法」，適時將企業社會責任訓練與員工績效考核系統結合，建立明確有效之獎勵及懲戒制度。
二、發展永續環境			
(一)公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(一)本公司致力提升各項資源之利用效率(如運送包裝再使用)，以污染預防及持續改善為發展基本架構，研發節能省碳之綠色概念產品、改善製程技術降低環境衝擊、導入綠色供應鏈，落實環保教育，確實執行資源回收，珍惜水資源，維護美好地球。
(二)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(二)本公司已取得ISO14001認證，並設有專責單位負責及持續改善，秉持企業永續發展之經營理念。
(三)公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略？	V		(三)本公司因應全球氣候變遷並致力於環境保護，包括辦公室及電腦機房之節能措施、持續推動文件管理電子化系統、從產品開發至生產管理之電子產品皆以節能減碳為主要訴求。
三、維護社會公益			
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		(一)無差異。 1.本公司支持並遵循責任商業聯盟行為準則(RBA)、聯合國世界人權宣言及聯合國全球盟約等國際公認之人權規範與原則，並以完全遵守其經營

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
		所在國家/地區的法規為基本要求。 2.本公司極為重視勞工與商業道德政策推動，透過公司內部網站之宣導，確信每位員工都應該受到公平的對待與尊重，並訂定「性騷擾事件處理辦法」，維護本公司工作場所免於性騷擾之環境，藉此保障本公司所屬員工及求職人員之權益。	
(二)公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？	V	(二)本公司設有內部電子信箱、部門會議等管道供同仁與各級主管做雙向的意見表達及溝通，若發現或接獲檢舉時，由專責人員依據本公司訂定之「檢舉制度」處理。	(二)無差異。
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V	(三)本公司已取得OHSAS18001認證，並推動各項員工安全衛生業務的持續改善活動及安全衛生相關訓練，創造優良的工作環境，並保護員工身心健康與安全，請參閱本年報第62頁。	(三)無差異。
(四)公司是否建立員工定期溝通之機制，並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動？	V	(四)本公司定期每季召開勞資會議，進行有效溝通，若遇管理制度或營運模式有重大變動時，將召開說明會向員工說明。	(四)無差異。
(五)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V	(五)本公司對人才的培育不遺餘力，除編列預算供員工在外進修外，並由專責單位設計內部訓練課程，提供挑戰及學習的環境，請參閱本年第60頁~第61頁。	(五)無差異。
(六)公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	V	(六)本公司訂定「客戶滿意度作業規範」、「客戶抱怨處理規範」、「客戶退貨處理規範」及「檢舉制度」等相關保護消費者權益政策及申訴程序，維護客戶的權益。	(六)無差異。
(七)對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則？		(七)本公司產品符合相關法規及國際準則。	(七)無差異。
(八)公司與供應商來往前，是否評估供應商過去有	V	(八)本公司依據內部規章執行供應商評估作業，需符合本公司訂定之供應	(八)無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
無影響環境與社會之紀錄？ (九)公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？	V	商管理政策才得以成為合格供應商。 (九)本公司依據供應商管理辦法查核供應商業，若發現違反相關規定，將要求限期改善。	(九)無差異。
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊？	V	(一)本公司網站設有企業社會責任專區揭露企業社會責任相關資訊，請至本公司網站及公開資訊觀測站查詢。	(一)無差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司已訂定「企業社會責任實務守則」，其運作與「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」並無差異。			
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：			
請參閱本公司網站企業社會責任專區： http://www.holtek.com.tw/web/guest/responsibility			
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：無。			

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案			
(一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？	V	(一)本公司訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「同仁廉潔守則」，本公司董事及經理人需盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討成效及持續改善，確保誠信經營政策之落實。	(一)無差異。
(二)公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？	V	(二)本公司訂定「檢舉制度」、「員工守則」及「同仁廉潔守則」規範不得藉職務之便，行直接或間接圖利之行為，以獲取不當利益或其他舞弊情事，並將上述規範納入公司規章及新進人員訓練教材中，並透過內部稽核制度，建立嚴謹的防範制度，防止不誠信行為發生。	(二)無差異。
(三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？	V	(三)本公司訂定「誠信經營守則」，並分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，加強相關防範措施，提升公司誠信經營之成效。	(三)無差異。
二、落實誠信經營			
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	V	(一)本公司避免與不誠信經營之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。	(一)無差異。
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？	V	(二) 1.本公司由資源管理中心負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並由業務行銷中心、設計中心、產品中心及品質保證處等單位協助負責，且每年至少一次向董事會報告執行情形。 2.本公司定期舉辦誠信經營相關之教育訓練課程，課程內容涵蓋內部舞弊之防治制度、內線交易防制因應之道、會計制度、內部控制、著作權保護、有害物質管理等相關課程，計211人次，合計320時數。	(二)無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V	(三)本公司訂定「誠信經營守則」及「檢舉制度」，制定防止利益衝突政策，並有適當陳述管道，若發現或接獲檢舉涉有不誠信或違法行為時，由專責人員處理。	(三)無差異。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？	V	(四)本公司已建立完整的會計制度、內部控制制度，由內部稽核部門及外部專業單位(如會計師)持續稽查違反誠信經營之情事。	(四)無差異。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	(五)本公司訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「同仁廉潔守則」，提供所有董事、經理人及公司同仁遵循。	(五)無差異。
三、公司檢舉制度之運作情形			
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V	(一)本公司訂定「檢舉制度」及「同仁廉潔守則」，由專責單位負責處理，若檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管；若涉及董事或協理級(含)以上之高階主管，應呈報至獨立董事。	(一)無差異。
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？	V	(二)本公司依據「檢舉制度」進行調查及相關保密機制。	(二)無差異。
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V	(三)本公司提供正當且獨立之檢舉管道，並對檢舉人身分及檢舉內容確實保密，以維護檢舉人之人身安全。	(三)無差異。
四、加強資訊揭露			
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V	(一)已於本公司網站及公開資訊觀測站，揭露「誠信經營守則」及「道德行為準則」。	(一)無差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司已訂定「誠信經營守則」，其運作與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)截至目前為止，公司無發生重大違反誠信經營規定，影響公司營運之情事。			

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

請參閱本公司網站(<http://www.holtek.com.tw>)或公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

董事、會計主管及稽核主管之進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
董事長	吳啟勇	107/03/01	社團法人中華公司治理協會	企業內部舞弊之防治兼談吹哨者制度的建立	3
		107/11/07	社團法人中華公司治理協會	我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道	3
董事	高國棟	107/03/01	社團法人中華公司治理協會	企業內部舞弊之防治兼談吹哨者制度的建立	3
		107/11/07	社團法人中華公司治理協會	我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道	3
董事	張 治	107/03/01	社團法人中華公司治理協會	企業內部舞弊之防治兼談吹哨者制度的建立	3
		107/11/07	社團法人中華公司治理協會	我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道	3
董事	林正鋒	107/03/01	社團法人中華公司治理協會	企業內部舞弊之防治兼談吹哨者制度的建立	3
		107/11/07	社團法人中華公司治理協會	我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道	3
董事	李佩紫	107/03/01	社團法人中華公司治理協會	企業內部舞弊之防治兼談吹哨者制度的建立	3
		107/11/07	社團法人中華公司治理協會	我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道	3
董事	王仁宗	107/03/01	社團法人中華公司治理協會	企業內部舞弊之防治兼談吹哨者制度的建立	3
		107/11/07	社團法人中華公司治理協會	我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道	3
獨立董事	呂正樂	107/03/01	社團法人中華公司治理協會	企業內部舞弊之防治兼談吹哨者制度的建立	3
		107/11/07	社團法人中華公司治理協會	我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道	3
獨立董事	邢智田	107/03/01	社團法人中華公司治理協會	企業內部舞弊之防治兼談吹哨者制度的建立	3
		107/11/07	社團法人中華公司治理協會	我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道	3
獨立董事	郭泰豪	107/03/01	社團法人中華公司治理協會	企業內部舞弊之防治兼談吹哨者制度的建立	3
		107/04/19	社團法人中華公司治理協會	公司法最新修正趨勢與解析	3
		107/04/19	社團法人中華公司治理協會	企業社會責任與永續競爭力	3
會計主管	廖明通	107/10/01 ~ 107/10/09	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管初任進修班	30
稽核主管	李文德	107/07/09 ~ 107/07/10	內部稽核協會	公開發行公司內部稽核人員持續進修班	12

(九)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書

盛群半導體股份有限公司

內部控制制度聲明書



日期：一〇八年三月六日

本公司民國一〇七年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一〇七年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一〇八年三月六日董事會通過，出席董事九人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

盛群半導體股份有限公司

董事長：吳啟勇



總經理：高國棟



2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會、董事會及審計委員會之重要決議

1.107 年度股東會之重要決議

股東會重要決議	執行情形
承認事項 1.通過本公司民國 106 年度營業報告書及財務報告。 2.通過本公司民國 106 年度盈餘分派案。	1.決議通過。 2.決議通過每股配發現金股利 3.636 元，訂定 107 年 8 月 20 日為除息基準日，於 107 年 8 月 30 日發放現金股利，發放金額為 822,347,575 元。
討論事項 1.通過本公司法定盈餘公積配發股東現金案。 2.通過本公司董事競業禁止解除案。	1.決議通過每股配發現金 0.464 元，訂定 107 年 8 月 20 日為除息基準日，於 107 年 8 月 30 日發放現金股利，發放金額為 104,942,045 元。 2.決議通過，業於 107 年 5 月 28 日發布重大訊息。

2.107 年度及截至年報刊印日止之董事會：

日期	重要決議
107.01.29 第七屆第 11 次	1.通過本公司 106 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 2.通過本公司 106 年合併財務報告及個體財務報告案。 3.通過本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。
107.03.01 第七屆第 12 次	1.通過本公司 106 年度營業報告書案。 2.通過本公司 106 年度盈餘分派案。 3.通過本公司法定盈餘公積配發股東現金案。 4.通過討論解除董事競業禁止案。 5.通過本公司 107 年股東常會召開日期案。 6.通過本公司出具內部控制制度聲明書案。 7.通過本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案。
107.04.30 第七屆第 13 次	1.通過 MCU Holdings Ltd.轉投資 Best Power Electronics Corporation 案。 2.通過本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。
107.05.28 第七屆第 14 次	1.通過本公司會計主管委任案。 2.通過本公司內部稽核主管委任案。 3.通過永豐銀行新竹分行短期額度申請案。 4.通過本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。
107.07.30 第七屆第 15 次	1.通過訂定本公司 106 年度盈餘分派之除息基準日及現金股利發放日案。 2.通過訂定本公司法定盈餘公積發放現金基準日案。 3.通過本公司處分金佶科技股份有限公司投資案。 4.通過討論解除董事競業禁止案。 5.通過本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。
107.10.29 第七屆第 16 次	1.通過本公司擬購買董監事及經理人責任保險案。 2.通過本公司 108 年稽核作業風險評估報告及年度稽核計畫案。 3.通過本公司 108 年營運計畫案。 4.通過改派轉投資公司法人董事代表人與總經理及討論解除董事競業禁止案。 5.通過改派轉投資公司法人董事代表人及討論解除經理人競業禁止案。 6.通過本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。

日期	重要決議
108.01.28 第七屆第 17 次	1.通過本公司 107 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 2.通過本公司 107 年合併財務報告及個體財務報告案。 3.通過本公司「公司章程」修訂案。 4.通過本公司財務主管委任案。 5.通過本公司發言人及代理發言人派任案。 6.通過本公司之香港分公司總經理派任案。 7.通過本公司之香港分公司變更銀行帳戶簽署案。 8.通過 MCU Holdings Ltd.增加投資 JXY Electronics Corporation 案。 9.通過本公司「董事會績效評估辦法」修訂案暨 107 年度董事會、薪資報酬委員會及審計委員會之績效評估報告。 10.通過本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。
108.03.06 第七屆第 18 次	1.通過本公司 107 年度營業報告書案。 2.通過本公司 107 年度盈餘分派案。 3.通過本公司法定盈餘公積配發股東現金案。 4.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 5.通過本公司第七屆董事任期將屆，依公司章程規定擬於 108 年股東常會中辦理全面改選第八屆董事(含獨立董事)事宜。 6.通過討論解除董事競業禁止案。 7.通過本公司 108 年股東常會召開日期案。 8.通過本公司出具內部控制制度聲明書案。 9.通過本公司評估簽證會計師獨立性及適任性。
108.04.15 第七屆第 19 次	1.通過審查本公司第八屆董事(含獨立董事)候選人提名案。 2.通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 3.通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 4.通過本公司 108 年股東常會召集事由修訂案。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者：無。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士(包括公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等)辭職解任情形：除會計主管、財務主管、內部稽核主管因職務調整外，其他有關人士並未有異動。

公司有關人士辭職解任情形彙總表

108 年 4 月 15 日

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
會計主管	李文德	101/08/01	107/06/01	內部職務調整
會計主管	廖明通	107/06/01	-	內部職務調整
內部稽核主管	廖明通	103/02/01	107/06/01	內部職務調整
內部稽核主管	李文德	107/06/01	-	內部職務調整
財務主管	李佩縈	93/05/11	108/02/01	因個人規劃辦理退休
財務主管	廖明通	108/02/01	-	內部職務調整

五、會計師公費資訊

(一) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：

單位：新台幣仟元

會計師事務所 名稱	會計師 姓 名	審計公費	非審計公費					會計師查核期間	備 註
			制度 設計	工商 登記	人力 資源	其他	小 計		
安侯建業聯合 會計師事務所	曾漢鈺	3,320	0	0	0	970	970	107/01/01~107/12/31	稅務 服務
	游萬淵								

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

(三) 審計公費較前一年度減少百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

六、更換會計師資訊：無。

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	107 年度		當年度截至 108 年 3 月 31 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	吳啟勇	—	—	—	—
董事兼總經理	高國棟	—	—	—	—
董事兼副總經理	張 治	—	—	—	—
董事兼副總經理	林正鋒	—	—	—	—
董事兼副總經理	李佩縈	—	—	—	—
董事	王仁宗	—	—	—	—
獨立董事	呂正樂	—	—	—	—
獨立董事	邢智田	—	—	9,000	—
獨立董事	郭泰豪	—	—	—	—
副總經理	蔡榮宗	30,000	—	—	—
協 理	吳紹藩	—	—	—	—
協 理	吳德傳	—	—	—	—
協 理	余國成	—	—	—	—
協 理	王鈺鈿	—	—	—	—
協 理	王明坤	—	—	—	—
協 理	劉源河	—	—	—	—
會計主管	廖明通	—	—	—	—
財務主管(註)	廖明通	—	—	—	—
大股東	聯華電子(股)公司	—	—	—	—

註：廖明通經理於 108 年 2 月 1 日擔任財務主管職務。

(二)股權移轉之相對人為關係人者：無。

(三)股權質押之相對人為關係人者：無。

九、持股比例占前十名之股東，其相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

108 年 3 月 31 日；單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
聯華電子(股)公司 代表人：洪嘉聰	24,644,257	10.90%	—	—	—	—	無	無	
渣打託管 i S h a r e s I V 有限公 司	8,272,000	3.66%	—	—	—	—	無	無	
吳啟勇	7,665,809	3.39%	2,745,598	1.21%	—	—	章安華	配偶	
德銀託管奎特外國 價值小型資本基金 專戶	7,435,500	3.29%	—	—	—	—	無	無	
高國棟	6,701,176	2.96%	—	—	—	—	無	無	
啟盛投資(股)公司 代表人：陳佳宏	5,423,703	2.40%	—	—	—	—	無	無	
匯豐銀行託管摩根 士丹利國際有限公 司專戶	5,045,782	2.23%	—	—	—	—	無	無	
新光人壽保險(股) 公司代表人：吳東進	4,625,000	2.04%	—	—	—	—	無	無	
財團法人國家文化 藝術基金會 代表人：林曼麗	4,538,000	2.01%	—	—	—	—	無	無	
柏鼎投資有限公司 代表人：章安華	4,484,841	1.98%	—	—	—	—	吳啟勇	配偶	

十、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

日期：107 年 12 月 31 日

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數 (仟股)	持股比例	股數 (仟股)	持股比例	股數 (仟股)	持股比例
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	15,253	100%	—	—	15,253	100%
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	2,000	100%	—	—	2,000	100%
Sigmos Holdings Ltd.	200	100%	—	—	200	100%
MCU Holdings Ltd.	500	100%	—	—	500	100%
Holtek Semiconductor (India) Private Limited	6	0.10%	6,479	99.90%	6,485	100%
盛凌投資股份有限公司	42,983	100%	—	—	42,983	100%

註：係公司採用權益法之投資。

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他
87/10	10	100,000	1,000,000	40,000	400,000	公司發起設立現金增資 340,000 仟元	技術股作價 60,000 仟元	--
88/04	10	100,000	1,000,000	100,000	1,000,000	現金增資 600,000 仟元	無	--
89/05	10	180,000	1,800,000	122,000	1,220,000	盈餘轉增資 220,000 仟元	無	註 1
90/04	10	180,000	1,800,000	153,380	1,533,800	盈餘轉增資 313,800 仟元	無	註 2
91/06	10	180,000	1,800,000	175,118.7	1,751,187	盈餘轉增資 217,387 仟元	無	註 3
92/06	10	260,000	2,600,000	183,400	1,834,000	盈餘轉增資 82,813 仟元	無	註 4
93/07	10	270,000	2,700,000	194,100	1,941,000	盈餘轉增資 107,000 仟元	無	註 5
94/06	10	290,000	2,900,000	205,409.5	2,054,095	盈餘轉增資 113,095 仟元	無	註 6
94/08	10	290,000	2,900,000	206,614.5	2,066,145	認股權憑證轉換 12,050 仟元	無	註 7
94/10	10	290,000	2,900,000	206,695	2,066,950	認股權憑證轉換 805 仟元	無	註 7
95/01	10	290,000	2,900,000	207,244.5	2,072,445	認股權憑證轉換 5,495 仟元	無	註 7、8
95/04	10	290,000	2,900,000	207,451.5	2,074,515	認股權憑證轉換 2,070 仟元	無	註 7、8
95/08	10	290,000	2,900,000	211,126.1	2,111,261	盈餘轉增資 36,746 仟元	無	註 9
95/08	10	290,000	2,900,000	212,100.1	2,121,001	認股權憑證轉換 9,740 仟元	無	註 7、8、10
95/10	10	290,000	2,900,000	212,210.35	2,122,103.5	認股權憑證轉換 1,102.5 仟元	無	註 7、8、10
96/01	10	290,000	2,900,000	212,470.1	2,124,701	認股權憑證轉換 2,597.5 仟元	無	註 7、8、10
96/04	10	290,000	2,900,000	212,759.35	2,127,593.5	認股權憑證轉換 2,892.5 仟元	無	註 7、8、10
96/08	10	290,000	2,900,000	216,487.05	2,164,870.5	盈餘轉增資 37,277 仟元	無	註 11
96/08	10	290,000	2,900,000	217,550.8	2,175,508	認股權憑證轉換 10,637.5 仟元	無	註 7、8、10
96/11	10	290,000	2,900,000	217,843.3	2,178,433	認股權憑證轉換 2,925 仟元	無	註 7、8、10
97/02	10	290,000	2,900,000	218,005.3	2,180,053	認股權憑證轉換 1,620 仟元	無	註 7、8、10
97/04	10	290,000	2,900,000	218,297.3	2,182,973	認股權憑證轉換 2,920 仟元	無	註 7、8、10
97/09	10	300,000	3,000,000	220,470.4	2,204,704	盈餘轉增資 21,731 仟元	無	註 12
97/09	10	300,000	3,000,000	220,910.4	2,209,104	認股權憑證轉換 4,400 仟元	無	註 7、8、10
97/11	10	300,000	3,000,000	220,955.15	2,209,551.5	認股權憑證轉換 447.5 仟元	無	註 7、8、10
98/03	10	300,000	3,000,000	220,997.4	2,209,974	認股權憑證轉換 422.5 仟元	無	註 7、8、10
98/04	10	300,000	3,000,000	221,180.9	2,211,809	認股權憑證轉換 1,835 仟元	無	註 7、8、10
98/08	10	300,000	3,000,000	222,087.7	2,220,877	盈餘轉增資 9,068 仟元	無	註 13
98/08	10	300,000	3,000,000	222,217.45	2,222,174.5	認股權憑證轉換 1,297.5 仟元	無	註 8
98/11	10	300,000	3,000,000	222,301.45	2,223,014.5	認股權憑證轉換 840 仟元	無	註 8

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他
99/02	10	300,000	3,000,000	222,347.45	2,223,474.5	認股權憑證轉換 460 仟元	無	註 8
99/04	10	300,000	3,000,000	222,556.2	2,225,562	認股權憑證轉換 2,087.5 仟元	無	註 8、14
99/08	10	300,000	3,000,000	222,666.2	2,226,662	認股權憑證轉換 1,100 仟元	無	註 14、15
99/11	10	300,000	3,000,000	222,798.7	2,227,987	認股權憑證轉換 1,325 仟元	無	註 14、15
100/02	10	300,000	3,000,000	223,044.2	2,230,442	認股權憑證轉換 2,455 仟元	無	註 14、15
100/05	10	300,000	3,000,000	223,339.7	2,233,397	認股權憑證轉換 2,955 仟元	無	註 14、15
100/08	10	300,000	3,000,000	223,598.45	2,235,984.5	認股權憑證轉換 2,587.5 仟元	無	註 14、15
102/08	10	300,000	3,000,000	223,680.45	2,236,804.5	認股權憑證轉換 820 仟元	無	註 15
102/11	10	300,000	3,000,000	224,941.2	2,249,412	認股權憑證轉換 12,607.5 仟元	無	註 15
103/01	10	300,000	3,000,000	226,168.2	2,261,682	認股權憑證轉換 12,270 仟元	無	註 15

註 1：89 年 5 月 15 日台財證(一)第 36989 號函核准。

註 2：90 年 4 月 3 日台財證(一)第 116941 號函核准。

註 3：91 年 5 月 17 日台財證(一)第 126989 號函核准。

註 4：92 年 6 月 27 日台財證(一)第 0920128586 號函核准。

註 5：93 年 6 月 25 日台財證(一)第 0930128187 號函核准。

註 6：94 年 6 月 24 日金管證(一)第 0940125322 號函核准。

註 7：92 年 4 月 1 日台財證(一)第 0920110590 號函核准。

註 8：92 年 8 月 22 日台財證(一)第 0920138382 號函核准。

註 9：95 年 6 月 29 日金管證(一)第 0950127323 號函核准。

註 10：93 年 6 月 25 日台財證(一)第 0930128187 號函核准。

註 11：96 年 6 月 25 日金管證(一)第 0960031838 號函核准。

註 12：97 年 7 月 9 日金管證(一)第 0970034273 號函核准。

註 13：98 年 6 月 23 日金管證發字第 0980031086 號函核准。

註 14：94 年 8 月 26 日金管證一字第 0940135791 號函核准。

註 15：96 年 12 月 31 日金管證一字第 0960073308 號函核准。

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
普 通 股	226,168,200 股	73,831,800 股	300,000,000 股	上市公司股票

總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)股東結構

108 年 3 月 31 日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個 人	外國機構 及外國人	合計
人 數	1	7	81	14,004	215	14,308
持有股數	289,000	5,536,000	45,746,106	93,426,567	81,170,527	226,168,200
持股比率(%)	0.13%	2.45%	20.22%	41.31%	35.89%	100%

(三)股權分散情形

1.普通股

108年3月31日

持股分級	股東人數	持有股數	持股比率%
1 至 999	4,504	268,271	0.12
1,000 至 5,000	7,633	14,582,037	6.45
5,001 至 10,000	974	7,440,556	3.29
10,001 至 15,000	327	4,049,329	1.79
15,001 至 20,000	199	3,652,041	1.61
20,001 至 30,000	182	4,503,602	1.99
30,001 至 50,000	149	5,935,556	2.62
50,001 至 100,000	141	10,313,497	4.56
100,001 至 200,000	81	11,785,032	5.21
200,001 至 400,000	46	12,758,941	5.64
400,001 至 600,000	20	9,726,618	4.30
600,001 至 800,000	7	4,631,900	2.05
800,001 至 1,000,000	5	4,426,762	1.96
1,000,001 股以上	40	132,094,058	58.41
合 計	14,308	226,168,200	100.00

2.特別股：無。

(四)主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱，
持股數額及比例

108年3月31日；單位：股

主要股東名稱	股 份	持有股數	持股比率%
聯華電子股份有限公司		24,644,257	10.90%
渣打託管 i S h a r e s I V 有限公司		8,272,000	3.66%
吳啟勇		7,665,809	3.39%
德銀託管奎特外國價值小型資本基金專戶		7,435,500	3.29%
高國棟		6,701,176	2.96%
啟盛投資股份有限公司		5,423,703	2.40%
匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶		5,045,782	2.23%
新光人壽保險股份有限公司		4,625,000	2.04%
財團法人國家文化藝術基金會		4,538,000	2.01%
柏鼎投資有限公司		4,484,841	1.98%

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元

年 度		106 年	107 年	當年度截至 108 年 3 月 31 日
每 股 市 價	最 高	84.50	88.00	75.00
	最 低	49.20	55.50	56.20
	平 均	59.11	72.45	70.09
每 股 淨 值	分配前	18.12	18.68	—
	分配後	14.02	註 5	—
每 股 盈 餘	加權平均股數(仟股)	226,168	226,168	226,168
	每股盈餘	4.10	4.70	—
每 股 股 利	現金股利	4.10	註 5	—
	無 償 配 股	盈餘配股	—	—
		資本公積配股	—	—
	累積未付股利(註 1)		—	—
投 資 報 酬 分 析	本益比(註 2)		14.42	15.41
	本利比(註 3)		14.42	註 5
	現金股利殖利率(註 4)		6.94%	註 5

註 1：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。

註 2：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。註 3：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

註 4：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

註 5：107 年度盈餘分派案尚未經股東常會決議，故相關比率暫不列示。

(六)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一．五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派不低於稅後淨利之百分之五十。

上述股東股利部份，其中現金股利不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股利合計數之百分之五十。

2.本次股東會擬議股利分配之情形

本公司擬自 107 年度盈餘分配中，以未分配盈餘分配，股東紅利新台幣 951,715,786 元全數以現金發放，按配息基準日之股東名簿所記載之股東持股數，每股擬配發現金股利新台幣 4.208 元，另以法定盈餘公積分配，法定盈餘公積新台幣 111,274,754 元，按配息基準日之股東名簿所記載之股東持股數，每股擬配發現金新台幣 0.492 元，前述以未分配盈餘及法定盈餘公積分配予股東，以現金發放合計新台幣 1,062,990,540 元，合計每股擬配發現金新台幣 4.70 元。

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。

(八)員工及董事酬勞：

1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一．五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

2.本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司依上述公司章程規定比例提供員工及董事酬勞，帳列當期費用項下，若董事會或股東會決議與估列金額有差異時，於決議年度將差異金額帳列當期費用項下調整之。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)經董事會通過分派 107 年度員工及董事酬勞，分別為員工酬勞新台幣 129,225,211 元及董事酬勞新台幣 14,248,357 元，與認列費用年度估列金額並無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

4.前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

106 年度員工酬勞提列金額為新台幣 111,567,218 元、董事酬勞提列金額為新台幣 12,286,360 元，皆係以現金發放，其中 106 年度以董事酬勞科目發放金額為新台幣 12,176,360 元，差異係估列計算之差異。

(九)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

伍、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容

本公司為國內專業微控制器 IC 設計領導廠商，營業範圍主要包括微控制器 IC 及其週邊 IC 之設計、研發與銷售，其整體產品開發與相關設計服務皆以客戶及市場需求為導向。

2. 主要產品之營業比重

產品別 \ 年度	107 年度
微控制器 IC	76%
週邊 IC	24%
合 計	100%

3. 目前產品及服務項目

本公司自有開發重心係以微控制器(MCU)暨其週邊 IC 為技術核心，主要應用範圍包含各式標準型及嵌入式 MCU、螢幕顯示 IC 產品、電源管理 IC 產品、電腦週邊 IC 產品、通訊 IC 產品、RF IC 產品、記憶體 IC 產品、類比 IC 產品、觸控開關 IC 產品、語音 IC 產品、健康量測產品、安防產品、馬達控制產品、物聯網及金融相關產品等，其產品走向不但要求符合全球性的應用領域，亦十分重視區域性特殊需求的滿足。

另外，本公司也針對個別客戶之需求，提供專屬 ASIC MCU 之委託設計服務，以及針對特殊應用領域開發 ASSP MCU，以充分滿足各類之市場需求。

4. 計劃開發之新產品及服務

為了提供客戶完整的產品及技術服務，本公司將產品之應用範圍擴大到 4C+MG(Medical & Green)領域，同時提供包含多種設計形式之專業服務，以滿足客戶對產品功能、成本、推出時效或產品保護等多樣要求。茲分述主要產品內容如下：

- (1) AEC-Q100 高溫 105°C 車規 Flash MCU 認證規劃，正式向車用電子領域邁進。
- (2) 24 位元 Delta Sigma A/D with LCD 型 Flash MCU。
- (3) 4.0 代 Touch Key Flash MCU，增強 MCU 抗干擾能力達到 CS 動態 3V Pass 要求。
- (4) 針對穿戴式裝置開發極低功耗之觸控 Flash MCU。
- (5) 各種醫療量測 MCU 及解決方案。
- (6) 半橋電磁爐/微波爐專用 MCU 及解決方案。
- (7) 快速充電與識別專用 MCU 及解決方案。
- (8) 中功率無線充電器專用 MCU 及解決方案。
- (9) 鋰電池充放電與太陽能電池管理及解決方案。
- (10) 動力型電池充電器專用 MCU 及解決方案。
- (11) AC 電源穩壓 AVR 專用 MCU 及解決方案。

- (12) 安防及消防產品專用 MCU 及解決方案(例：CO 偵測器、煙感火災報警器)。
- (13) 超低 RTC 耗電流的標準型 Flash MCU。
- (14) 高資源、大程序空間的標準型 8 位元 Flash MCU。
- (15) CAN Bus Flash MCU 及解決方案。
- (16) TDC 超聲波流量計 ASSP MCU。
- (17) 超音波測距/倒車雷達專用 MCU。
- (18) RF Sub-1GHz 及 OOK+FSK 無線發射 Flash MCU SoC 方案。
- (19) 5.x 版低功耗藍牙(BLE) Arm® Cortex™-M0+ Flash MCU。
- (20) 32 位元 MCU 之物聯網應用開發平台及解決方案。
- (21) 32 位元 MCU 之低功耗藍牙應用開發平台及解決方案。
- (22) 32 位元 MCU 產品推出以 Arm® Cortex™-M0+及 M3 核心之 Flash 微控制器。
- (23) 金融機具之高速貨幣序號(冠字碼)讀出暨影像辨識處理器及其解決方案。
- (24) 高精度生物檢測前置類比處理器(AFE)暨可編程數位濾波器(DF)及快速傅立葉轉換(FFT)。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

(1) 全球半導體產業市場：

根據全球半導體貿易統計協會(WSTS)統計 2018 年全球半導體銷售額達 4,779 億美元(YoY +15.9%)，其中，積體電路於 2018 年全球銷售額達 3,432 億美元(YoY +24%)，寫下 2010 年以來第二次的兩位數增長紀錄，隨著 4C+MG(Medical & Green) 領域之產品蓬勃發展，產品智慧化及低功耗的需求，預估 2019 年全球各類半導體產品銷售額仍會繼續成長。

另外，市場研究機構 IC Insights 研究報告，2018 年 MCU 單位量達到 291 億，年成長率達 13%；2018 年 MCU 營收達到 178 億美元，年成長率達 6%，其中，32 位元 MCU 已佔 57%，並預估在 2023 年，因處理高性能運算應用的設計要求越來越高，感測器和各式智慧型裝置連接到互聯網，32 位元 MCU 將更快速地擴張至各應用領域，預估 CAGR 將達 8.9%。

(2) 臺灣半導體產業市場：

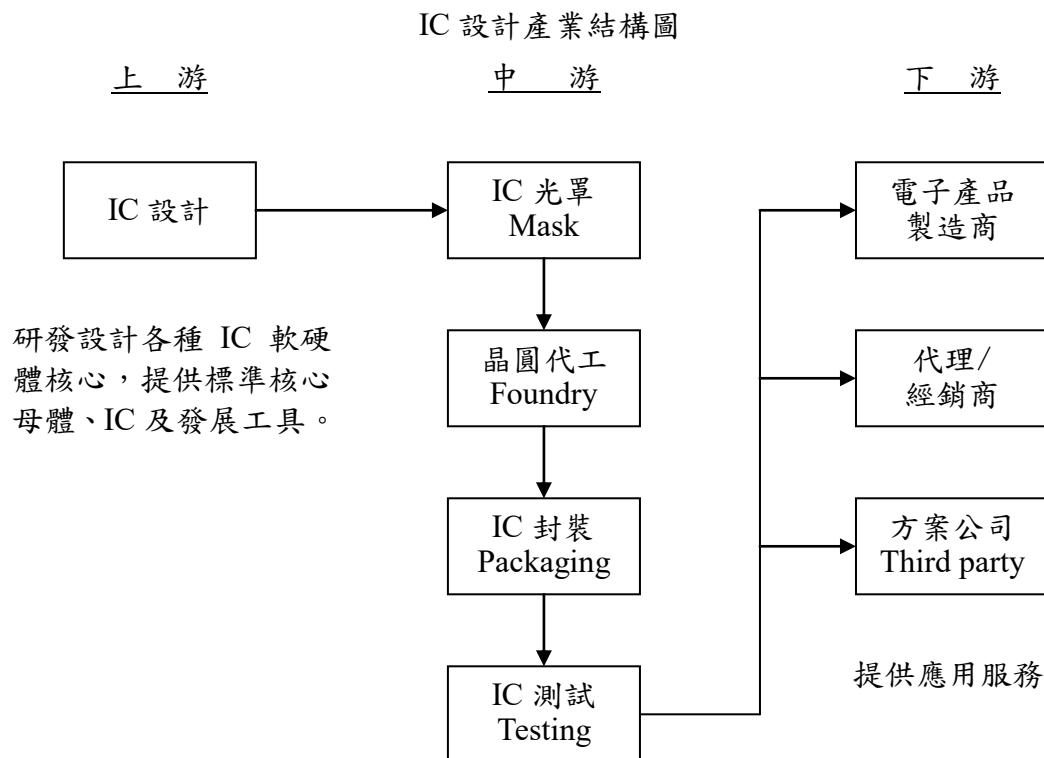
依據臺灣半導體協會委託工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)，於臺灣半導體產業回顧與展望報告中敘述：2018 年台灣 IC 產業產值達新台幣 26,199 億元，較 2017 年成長 6.4%。其中，IC 設計業產值為新台幣 6,413 億元，較 2017 年成長 3.9%；IC 製造業為新台幣 14,856 億元，較 2017 年成長 8.6%，其中晶圓代工為新台幣 12,851 億元，較 2017 年成長 6.6%，記憶體與其他製造為新台幣 2,005 億元，較 2017 年成長 23.7%；IC 封裝業為新台幣 3,445 元，較 2017 年成長 3.5%；IC 測試業為新台幣 1,485 億元，較 2017 年成長 3.1%。

展望 2019 年，雖智慧型手機需求持續走弱，所幸記憶體、車載、智慧家庭、安全防護及物聯網等應用領域蓬勃發展，加上預估 2019 年顯示驅動 IC 晶片出貨量仍會成長，SEMI 預測台灣 IC 設計業 2019 年的產值預計將達新台幣 6,675 億元，較 2018 全年成長 4.1%。

(3) 中國半導體產業市場：

根據中國半導體行業協會統計，受中美經貿關係和市場增長乏力影響，2018 年中國積體電路設計業銷售額為人民幣 2,519 億元，較去年增長 21.5%。另外，根據海關統計，2018 年中國累計進口積體電路 4,175.7 億顆，較 2017 年增長 10.8%，進口金額達到 3,120.6 億美元，較 2017 年增長 19.8%；出口方面，2018 年累計出口積體電路 2,171 億個，較 2017 年增長 6.2%；出口金額增長 26.6%，達到 846.46 億美元。2018 年中國積體電路貿易逆差進一步擴大到 2,274 億美元，比 2017 年的 1,932.6 億增加了 17.7%，未來因中國內需強勁及國內積體電路產業生產偏重於中低階產品，於此，高階產品仍存在需由海外進口之態勢。

2. 產業上、中、下游之關聯性



3. 產品之各種發展趨勢

本公司設計之 IC 產品系列齊全，所涵蓋的應用領域非常廣泛，包括電腦、通訊、消費、智能家電、工業設備、健康量測及物聯網產品等領域使用：

主要產品	用 途
微控制器(MCU)產品	1. Arm [®] Cortex [®] -M 為核心之系列 32 位元 Flash MCU。 2. HT8 為核心之系列 8 位元 Flash MCU。 3. BS 系列 8 位元觸控 Flash MCU。
RF SoC 微控制器(MCU)產品	1. 無線對講機、電動機車報警、電動腳踏車防盜、智能家居無線遙控、無線門鈴、和安全防盜等。 2. 低功耗藍牙(BLE)透傳控制的健康量測產品、家電產品及智能設備資訊探詢等應用。 3. Sub-1GHz 展頻無線通信 LoRa 模塊產品、智能四錶等 IoT 產品及應用。
家電產品類	各式小家電微控制器、家電面板顯示控制 MCU 及各類家電觸控按鈕 MCU。

主要產品	用 途
電腦產品類	鍵盤、滑鼠、電競鍵盤、USB Bridge、PDF Data Logger 等。
顯示器產品類	電錶顯示器、影音&家電顯示器、車用顯示器、電子貨架標籤顯示器、穿戴式產品顯示器及定電流 LED 顯示器等。
電源管理產品類	家電電源板卡、充電器、煙感器、行動電源、無線充電、智能電錶、鋰電池個人護理產品(刮鬍刀、鼻毛刀、潔面儀、電動剪髮器)及手電筒等 ASSP MCU。
金融產品類	動態密碼產生器、挑戰應答動態密碼產生器、智能卡讀卡器、基於貨幣、信用卡、身分證等有掃描辨識需求之相關金融機具，例：點驗鈔機、清分機、ATM 機、EPD Flash MCU、Ultra-Low Power Flash MCU、及身分證鑑別儀等。
物聯網產品類	基於 Wi-Fi 及 BLE(低功耗藍牙)的物聯網技術，以 32 位元 Flash MCU 提供小家電、健康監控、醫療照護、智慧手環及其他物聯網相關產品完整的解決方案。並輔以 AI 圖像辨識處理器，提供鈔票辨識、人臉辨識、物件辨識、手勢辨識等系統方案。
安防產品類	感煙/感溫火災探測報警器、PM2.5 感測器、CO/GAS 探測報警器及 PIR/uWave 感測器等。
健康量測產品類	血壓計、血糖儀、血氧儀、體溫計、電子體重秤、計價秤、體脂秤、紅外線測溫、霧化器、接近感應器等。

4. 競爭情形

由於中國成立公司的門檻低，加上中國政府發布《國家積體電路產業發展推進綱要》和《中國製造 2025》，為中國 IC 產業實現跨越式發展注入了強大動力，截至 2018 年，中國已有約 1,698 家設計企業 IC 設計公司(較去年增加 318 家)，台灣面對的同業競爭壓力隨之升高。

根據 HIS 研究報告，因 8 位元 MCU 在 IoT 及可穿戴設備等提供穩定、可靠、及易維護之特性，全球 MCU 廠商仍持續加大 8 位元 MCU 之拓展力度，2018 年 8 位元 MCU 的市場規模達 78 億美元，市場機構 Mordor Intelligence 並預估，至 2023 年，MCU 市場將增長至接近百億美元，年複合增長率為 5.11%，主要應用於汽車、消費品、家用電器、醫療保健、工業電子、資料處理及通信等產業，因需要越來越多 8 位元 MCU 執行簡易資料處理工作。

(三)技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度	107 年度
研發費用	783,088
營業收入	4,862,807
研發費用佔營業收入比率(%)	16%

2. 開發成功之技術或產品

本公司以每年約營業額的 15%~20%投入新產品與新技術研發，藉由新產品的持續導入來創造公司營業額的穩定成長與利潤的提升。

2018 年度主要的研發成果以微控制器為核心，搭配週邊 IC 系列，提供完整解決方案暨滿意之整體服務。依應用分類概述於下：

(1) 新一代 8 位元 MCU

- A. 1.8V~5.5V 低工作電壓 Flash 型系列：支援更低的工作電壓，內建 AD 及 LCD 功能，適用電池類產品。
- B. 內建多級運算放大器、比較器及穩壓器 MCU：節省 PCB 板的空間並簡化電路架構，縮小應用產品體積，具有節省成本及生產方便等優勢，適合各種需要信號放大的產品應用，例如遙控器、倒車雷達、測距儀、玩具、機器人、量測儀器、自動感應水龍頭、感煙報警器、CO/GAS 偵測器、PIR/微波感測器等。
- C. 觸控按鍵微控制器系列：觸控按鍵微控制器系列，搭上觸控產品熱潮，適合各式觸控產品使用，Flash Touch MCU 系列可多次 ICP(In Circuit Programming)燒寫，並內建 EEPROM，便於修改程序、參數調整與設定更改，提供客戶最方便的開發平台與最具競爭力產品。
- D. 低功耗標準型系列(TinyPower™ MCU)：本系列產品具備與國際大廠同等級之低功耗能力，符合環保潮流，適合於各種採用電池電源之可攜式產品。
- E. 健康量測產品：鎖定血壓、血糖、血氧、體溫、體重與體脂肪、保健與照護等相關產品，陸續開發出專用 MCU，除高度集成現有外部元器件外，並提供更高解析度的 24 位元 ADC 與先進 USB 與語音介面，簡化對於遠距照護產品的設計，提高老年人口使用方便性。
- F. 完成伺服馬達(Servo Motor，或稱為舵機)專用 MCU 之開發，從控制方式可分成 PWM 舵機與 UART 舵機，皆已完成調參平台開發，用戶可使用該平台輕易達成舵機產品開發。在機器人之 UART 舵機的通訊協定也已開發完成，已被智能機器人大廠評估。
- G. 無刷直流馬達(Brushless DC, BLDC) Motor 控制專用 MCU：除一般 MCU 外，新增 12V SoC MCU 整合外部高壓驅動元件，可直推外部 P/N MOSFET 或直推 3W 以下 BLDC。本系列產品鎖定節能風扇、空氣淨化器、園林工具、吸塵器、電動工具、冰箱散熱風扇，皆達各產品所需之功能及效果並成功導入客戶量產。
- H. 無線充電產品系列：除已開發完成 5W 無線充電低功率產品外，新增符合 WPC 中功率無線充電 ASSP MCU，可完全符合 Qi 15W 中功率需求。
- I. 多路 RGB LED 彩燈 MCU 之開發：可恆流驅動 RGB LED，實現數百萬種 RGB 顏色變化，很適合應用在智能音箱、滑鼠墊、電競耳機、電競滑鼠等產品上，增加產品流光溢彩的絢麗效果。

以上各系列 MCU 最低均達工業等級規格(寬溫運作範圍達到-40℃~+85℃)，抗雜訊能力與歐美日領導廠商之產品品質同級，產品品質已獲得廣泛客戶的認可。

(2) Arm® Cortex®M series 32 位元 MCU

- A. Arm® Cortex®- M0+為核心寬工作電壓 2.5V~5.5V 之 Flash MCU。
- B. Arm® Cortex®- M3 為核心操作速度可達 96MHz 之 Flash MCU。
- C. Arm® Cortex®- M0+為核心操作速度可達 60MHz 之 Flash MCU。

(3) 消費性產品

- A. Flash Type Voice MCU: 整合 16 位元 ADC/DAC 等類比 IP 並提供 SPI 介面，內建硬體語音壓縮等相關技術，減化客戶應用技術門檻，提高產品的便利性。
- B. Touch + Voice Flash MCU：整合 16 位元 ADC/DAC 等類比 IP 並提供 SPI 介面，軟體語音解壓縮技術，並內置 HOLTEK 電容式觸控按鍵使用，及軟體 LCD 功能，減化客戶應用技術門檻及整合多項分離 IC 器件應用，提高產品的便利性及完整性。
- C. Touch + LCD/LED Flash MCU：結合電容式觸控按鍵，直接驅動 LCD 及大電流 LED，內置 UART 串列式通信界面、RTC 實時時鐘功能與高精度 12-bit 的模數轉換，除一般消費性產品使用外，並適用於工業用溫控器等工業產品。
- D. 超聲波霧化器 Flash MCU：內建自動追頻、無水上電、缺水檢測等功能，能配合各種不同頻率之霧化片（100KHz、1.7MHz、2.4MHz、3MHz 等），完整支援霧化器所需，有效降低客戶成本。
- E. 完成 2.0 代動力型充電器控制 Flash MCU：內建二組 OPA、DAC，經由軟體改變 DAC，MCU 透過 OPA 控制一次側 PWMIC，進行電池恆壓(CV)/恆流(CC)硬體控制，適用於 e-bike 或電動工具鉛酸/鋰電池充電器產品。
- F. 電源管理暨驅動產品：
 - (A) 高耐壓/高精準度/低功耗/大電流驅動線性穩壓器：工作電壓高達 40V，超高 $\pm 1\%$ 精準度，低於 1uA 工作電流及最高達 500mA 相關線性穩壓產品，可廣泛使用於消防安全、工業控制、金融商品、車用電子等應用領域，可延長電池壽命及達到綠色節能效果。
 - (B) 低功耗/大電流驅動升壓型轉換器：超低 0.7V 工作電壓，最高達 3A 輸出電流，適用於乾電池及鋰電池相關應用產品，如電動刮鬍刀、健康醫療檢測、行動電源、無線聯網的水/電能/燃氣/熱能錶應用等，可延長電池壽命及提供系統穩定可靠電源。
 - (C) 高耐壓/大電流驅動降壓型轉換器：工作電壓高達 52V，最大 3A 輸出電流，可廣泛使用於智能電錶、電動機車、無線路由器等應用領域，提供系統穩定可靠電源。
 - (D) 低功耗/低成本交流-直流電壓轉換器：最大耐壓達 700V，精簡外圍線路提供具成本競爭力方案，廣泛使用於小家電領域產品，如電磁爐、電陶爐、咖啡機、電飯煲等。
 - (E) 高功因/大電流驅動 AC-DC LED 照明驅動器：內建 QR 模式操作，最高達 0.98 功率因素，最高可驅動 200 瓦 LED 燈具負載，廣泛應用在球燈泡、筒燈、平板燈、智能 LED 燈具等應用。
 - (F) LED 照明驅動 IC：使用於一般 LED 照明，可應用在 T8 燈管、E27 球泡燈等。
 - (G) 直流馬達驅動 IC：可使用在水表、燃氣表、熱量錶的閥門控制以及電子門鎖等直流馬達驅動應用產品。達到馬達電壓最高 24V，驅動峰值電流最大 2.5A 能力，並提供完整 IC 自我保護功能。

- (H) 多節鋰電池保護模擬前端 IC：應用於手持電動工具、吸塵器、噴水器
等裝置，搭配 Holtek MCU 可提供低成本、高整合完整鋰電池保護方案。
- G. Real Time Clock IC：可使用在各種需要計數時間的產品，例如：電錶、水
錶、煤氣錶、考勤及門禁設備、計費電話、收銀機、MP3、數位相框、辦
公室自動化產品、家電產品、電腦產品等。
- H. Remote Control Encoder IC：可使用在汽車防盜、機車/電動車防盜、家庭
防盜及大門、窗簾、門鈴、家電之遙控。
- I. 超聲波流量計 ASSP MCU：整合 TDC 等類比 IP 並提供通訊介面(SPI/UART
/I²C)，內建流量演算法及溫度量測等相關技術，降低客戶應用技術門檻，
提高產品之便利性。
- J. 完成 USB PD 32 位元 MCU 開發，應用於 30W~45W 車充產品，整合同步
式升降壓管理與安全保護機制，達到高轉換效率、電路精簡等效果。
- K. 完成快速無線充電 ASIC MCU 開發，針對無線充電特殊規格設計，可應
用於多線圈與 10W 無線充電方案。
- L. 完成 400mA 線性充電 IP 開發，此 IP 與 8-bit MCU SoC 整合後，可應用於
鋰電池各項產品。
- M. 高壓總線資料傳輸 IC：整合電壓調變資料輸入及電流調變資料輸出等類比
IP，提供解調變資料輸入及調變資料輸出功能；符合總線資料傳輸應用，
以提高產品的便利性及完整性。
- N. 雙核 32 位元 DSP IC：整合雙核 DSP、影像處理加速器、類神經網路及 DDR
控制器等，提供影像辨識如鈔票、證件、人臉、車牌等相關辨識應用方案。
- (4) 電腦週邊產品
- A. USB 2.0 Full Speed MCU 系列。
- B. USB Bridge 系列 IC。
- C. 高速 CIS/CCD 類比前置處理器(AFE)系列。
- D. USB 2.0 Low Speed MCU 系列。
- E. PDF Data Logger MCU。
- F. 電競鍵盤及滑鼠 RGB LED ASSP Flash MCU。
- (5) 無線產品
- A. 無線對講機控制器及射頻整合芯片：內建無線電射頻、DSP、與音頻類比
電路之 SoC Flash MCU，適用於類比式專用及 FRS 對講機。
- B. 無線遙控器：整合 315M/433M/868M/915MHz ISM 頻段之 RF 發射電路與
編碼器，ASK/OOK/FSK/GFSK 調制方式之遙控器，並內置高性能 Flash
MCU，結合 RF 及 MCU 控制為一體的 SoC IC。
- C. 無線控制器：315M/433M/868M/915MHz RF 接收超再生及超外差模式電
路，解調 OOK/FSK 接收及 Flash MCU 應用合一，適合搭配無線發射遙控
器產品，作為整合性單向、雙向控制應用。
- D. 2.4GHz 無線 MCU：整合 2.4G RF 電路之 Flash MCU，適用於具備抗干擾
能力、雙向傳輸等應用。
- E. 低功耗藍牙(BLE) MCU：整合高性能的射頻、調製解調器及 32 位元

M0+Flash MCU，並內建 DC/DC 及 LDO，支援寬廣範圍的單電源供電，適用於低功耗的健康醫療產品、家電產品及智能設備資訊探詢等應用。

F. NFC Tag Flash MCU & NFC Reader controller。

(四)長短期業務發展計畫

1. 短期發展計畫

(1)行銷與營運策略

本公司經營團隊擁有超過 30 年豐富的 IC 設計產業經驗，熟知客戶及市場需求，並擁有數家前段晶圓廠及後段封裝測試廠的全力支援，同時在臺灣/中國/美國/印度建立當地銷售及技術服務據點。因此，本公司擁有高產品競爭力在於提供客戶：

- A. 最好的產品品質(高品質靜電破壞保護及抗雜訊能力)。
- B. 最短的產品交期。
- C. 最佳性價比產品。
- D. 提供一次寫入式(OTP)與多次寫入式(Flash)微控制器產品。
- E. 最快速的在地化技術服務。
- F. 彈性的 ASSP & ASIC 微控制器開發服務。
- G. 專業開發工具與高效 C 語言編譯器。

(2)生產策略：

- A. 維繫與主要晶圓代工廠、封裝廠、測試廠等外包廠商之合作關係，以爭取充足之產能及成本之競爭力。
- B. 建立與合作廠商之生產相關資訊，以便即時掌控生產的進度及數量，達到降低庫存與有效備貨的目標。

(3)產品策略：

- A. 本公司產品發展定位在以 8/32 位元微控制器 IC 為主，加上微控制器週邊 IC 為輔的架構上，提供客戶多元化的彈性選擇。一次購足的便利性以及優異的性能與價格比，使客戶的產品具有強大之市場競爭力。
- B. 以策略性產品作為消費市場發展主軸，導入利基型產品，提供差異化服務。
- C. 本公司以整體系統成本的角度出發，協助客戶降低整體成本以達到雙贏的目的。

(4)研發策略：

本公司將 MCU 核心架構在不同製程平台，並搭配特殊 IP 技術及重要關鍵技術，達到小型化 SoC，在整合過程加強抗雜訊能力與靜電防護能力，達到美、日、歐 MCU 供應商相同工規的技術水準，已進行 105°C 高溫 AEC-Q100 認證，並朝車用電子規範產品延伸，另外針對較特定應用之產品，或直接進行功能的改良，提高產品之良率，進入更大的潛在市場。

2. 長期發展計畫

(1)行銷與營運策略

公司發展策略鎖定以智慧家電、健康量測、PC 相關周邊、安防、馬達控制與金融領域為發展市場，並經由專注研發高品質微控制器開拓國際市場，優異的產品品質及快速的在地服務，不但滿足全球客戶的需求，亦已成功地將

HOLTEK 微控制器順利導入全球著名家電大廠，建立起 HOLTEK 全球化的專業品牌形象。公司在 8 位元 MCU 已獲得大廠的認同並導入量產，並另積極布局 32 位元 MCU 以擴大全球市佔率，2018 年 32 位元 MCU 出貨量已達到 1,600 萬顆以上，成長高達 42%，未來 32 位元 MCU 應用範圍涵蓋的功能面將會更廣泛，並在各種不同的領域，搭配不同的專業合作方案夥伴，擴展生態系統，透過引入創新的設計方案，加速開發該應用之終端客戶所需產品。

(2)生產策略：

- A. 針對產業淡旺季循環做及早的因應，降低其衝擊。
- B. 持續使用先進製程，降低成本，建立成本優勢，提升良率及市場競爭力。

(3)產品策略：

- A. 鎖定國內外大廠與具有潛力的市場，進行產品推廣及服務。
- B. 切入更高階或高附加價值之應用領域，如高階大小家電、工業設備、安全防護、車用電子及物聯網等設備領域。

(4)研發策略：

提升產品設計能力，並因應市場應用需求，建立規格化與模組化之開發技術，大幅提高產品的良率，減少開發時程與開發成本，加速新產品上市之時間並提高價格競爭力。

(5)產品發展項目：

- A. 開發 32 位元 Arm 核心 MCU 標準系列，搭配周邊包括 LCD 驅動、/USB UART /SPI/I2C/I2S 通訊介面、PWM 驅動、CMOS 感測器、高速高精度 A/D 和 D/A 轉換器、比較器、運算放大器等功能。
- B. 開發 32 位 Arm 核心 MCU 專用範圍，用於圖像識別、電機控制、指紋識別、健康測量、音樂合成。整合 AES 加解密功能、CRC 運算功能、24 位元高解析度 Delta-Sigma A /D 轉換器、多通道音樂合成器等周邊，適合多種應用領域如：物聯網終端裝置、可穿戴設備、多媒體產品及無線應用、音樂合成器等領域。
- C. 開發全系列標準的 8 位元 Flash MCU，包括 A/D 和 D/A 轉換器、LCD 和 LED 驅動程式、24 位元高解析度 Delta-Sigma A /D 轉換器等語音應用
- D. 增加 8 位 Flash 專用 MCU 的範圍，用於健康測量、個人護理、電機驅動、觸控開關、安防產品、物聯網產品、有線和無線充電器產品、家用電器、電腦週邊設備、超聲波應用等領域。
- E. 開發低功耗藍牙(BLE)射頻、2.4GHz 雙向傳輸、Sub 1GHz 射頻 SoC 快閃記憶體 MCUs、編碼器/解碼器等無線設備。
- F. 擴大電源管理設備的範圍，包括高電流 LDOs、高輸出電流之 DC/DC 同步升壓轉換器、高效率 AC-DC 轉換器等。
- G. 開發交流/直流照明驅動、LCD、LED 控制器、驅動等照明產品。
- H. 開發 AI 圖像辨識 IC：提供鈔票、人臉、物件及手勢等相關辨識的應用。
- I. MCU 整合 AFE 電路，結合各類傳感器應用，開發 Smart Sensor 產品，擴展產品應用領域。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1. 主要產品之銷售地區

本公司銷售地區分佈如下表所示：

單位：新台幣仟元

區域 \ 年度	106 年度		107 年度	
	銷售額	比率(%)	銷售額	比率(%)
臺灣地區	557,865	12	484,264	10
中國地區	3,331,746	72	3,716,948	76
其他海外地區	725,306	16	661,595	14
合計	4,614,917	100	4,862,807	100

2. 市場佔有率

本公司專注於微控制器(MCU)與週邊半導體器件產品之開發，相關產品之應用涵蓋範圍廣大，除了消費(Consumer)、通訊(Communication)、電腦(Computer)及汽車(Car)等 4C 相關領域之外，尚包含非揮發性記憶體 IC、顯示驅動 IC、電源管理 IC、類比 IC、ASSP/ASIC MCU 等，每一類型均已佔有市場一席之地。

根據 IC Insights 預測，2018 年 MCU 營收將達 186 億美元，依本公司 2018 年度 MCU 總銷貨金額為新台幣 37.12 億元，約 1.23 億美金(新台幣對美元匯率以 30.136 計算)，於 MCU 市場的營收占有率約 0.7%，另外，2018 年本公司 MCU 總出貨量 6.73 億顆，相對 2017 年成長 8%，相對 IC Insights 預測 2018 年全球 MCU 出貨量 306 億顆，已達 2%之 MCU 市場的出貨量占有率，預估 2019 年，隨著應用面廣度的拓展，推升 MCU 需求面，將持續提升既有的市佔率。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

(1)供需狀況

由於 MCU 的易用性、即時運行和低功耗特性，可為智慧、安全且不斷發展的 IoT 市場提供最高性能且經濟高效的嵌入式解決方案。由於市場需求不斷擴展，造成全球 MCU 市場供不應求、廠商交期不斷延長，自 2017 年起全球已有多家 MCU 廠商產品出貨交期延長，加上晶圓代工廠漲價，致生產成本不斷攀升，使整體半導體市場自 2018 年下旬開始轉弱，成長幅度趨緩，僅仰賴全球汽車電子及物聯網等應用需求，2019 年全球 MCU 市場預計屬於先緩後攀升的一年。

(2)未來成長性

根據 IC Insights 研究報告，從 2017 年到 2022 年 MCU 在 IoT 裡每年的複合增長率是 17%，且預估到 2020 年，將有超過 30 億個物體連接在一起，大量的電子產品急需智能化升級，本公司以 MCU 和 RF 以及 Sensor 集成，並提供低功耗藍牙(BLE)模組、LoRa 模組以及 Sub-1GHz 等無線通訊模組因應，未來

進一步若人工智慧透過物聯網滲透到生活中，面對所謂「AIoT」時代來臨，全球 MCU 廠商更是需要全新的技術需求才能迎接如此龐大的市場挑戰，以迎向更多元之市場需求。

4. 競爭利基

IC 設計業為高度智慧型、腦力密集且技術層次高的行業，充足的研發人才、電腦輔助設計和測試設備成為 IC 設計業的基本重要條件。

本公司歷經多年的經營，累積豐富的人才、技術研發和產品應用經驗，具體掌握核心技術，產品系列完整且多樣化且不斷推出新創意，新產品均擁有更強功能、更高品質、更低價格、符合客戶的需求和具備市場競爭力為整體發展目標。

(1)研發能力強，產品領先群倫：

長期積極開發人力資源，延攬國內外優秀設計人員，並透過教育訓練，傳授技巧累積經驗，分工合作建立有效率的研發團隊，延續並發揚技術之優勢，開發更新更有競爭力的 IC。

(2)更新輔助設計器材與測試設備：

藉由精密的儀器設備，提升人員的工作效率，產品的穩定性和可靠性，並藉由客戶和市場之互動，開發出符合市場之高技術的應用 IC。

(3)完整的全球行銷網路：

擁有臺灣、香港、深圳、東莞、廈門、上海、蘇州、杭州、南京、北京、成都、青島、美國和東北亞、東南亞、南美洲、歐洲、中東等世界各地的代理或經銷網，可迅速的蒐集市場訊息，掌握先機，並透過國內外銷售據點，做到快速的銷售和售後服務與技術支援。

(4)上游工廠關係穩固：

與上游晶圓代工、封裝、測試工廠關係良好，除了確保貨源穩定供應不缺外，更能以長期合作、大量生產獲得較低的價格優勢，提高本公司之長期競爭力。

(5)管理制度良好：

本公司取得 ISO9001 及 ISO14001 品質認證，所有作業系統流程都有標準化和規格化的管理，產品品質穩定深受客戶滿意。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

大部份 IC 設計業均以特定產業或專業產品來經營市場，由於資源集中且經驗累積迅速，在專業產品上較具優勢，但是面對強力競爭者挑戰或市場大變動時，其穩健度與反應能力就遠不及能提供不同應用及不同客戶需求的設計公司。因此，本公司即以提供各項產品應用與全方位服務為發展目標，目前掌握之競爭優勢如下：

A. 領先且完整的產品系列

(A) 由於自有 IP 日益豐富與設計能力提升，可按客戶需求快速提供 ASSP/ASIC MCU 等集成度高的 IC，並提供參考設計的完整解決方案，增加 IC 功能與客戶產品的競爭力，提高對手競爭障礙。

(B) 產品橫跨多種產業，可有效降低市場風險。

(C) 公司的營業成長目標較具空間與彈性。

B. 全球行銷網的建立

(A) 有效建立區域行銷據點，以提供及時且在地化的產品技術服務，更能正確反應市場需求；在地化服務包含發展工具、FAE、安規驗證、軟體服務等。

(B) 長期建立的經銷體系已遍佈全球，順暢的行銷管道有助於整體產品的推展與營業額的擴張，並已獲美/歐/日/韓等國際大廠認證並採用。

(C) 持續重視客戶的開發與維護，以奠定穩健的市場基石。

(D) 產銷的結合，積極與客戶培養長期性互惠支援關係。

(E) 與上下游產業結盟以強化依存性及競爭力。

(F) 藉電腦化支援系統，使預估銷售需求、生產下線排程、庫存、委外加工等作業皆能充分發揮產銷協調之功能，有效的產品速動管制作業使達到成本最低化、產值最大化、服務最佳化成果。

C. 產品開發能力

(A) 多年經驗累積之優良研發技術。

(B) 強大的研發團隊。

(C) 藉由策略性合作、產學合作等方式引進新技術，加速產品及技術升級。

(D) 發展產品多元化，減少景氣波動度影響。

D. 整體環境支援

(A) 產業支援集中，可增強經營效益。

(B) 產業專業分工，可增高合作及依存性。

(C) 產業整合度高且競爭性強，可提升產品優勢。

(2) 不利因素及因應之道

A. 國內外產品相似性太高，造成惡性競爭而獲利降低，必須提升產品技術層次及產品品質以避開衝突，並開發系列性產品及 ASSP 產品以滿足各種客戶需求，以取得獨特優勢。

B. 歐美大廠產品壓低售價的競爭，將以優勢的性價比，並配合以更好更迅速的服務及提供完整的設計方案，取得客戶的認同與採用。

C. 產品生命週期縮短，開發費用增高，所以開發環境的改善及市場資訊的蒐集務求又快又準，以取得先機。

D. 面對整合元件廠的強力競爭，必須與晶圓代工廠及封裝測試廠商策略聯盟以取得必要之競爭能力。

E. 在智慧財產權保護聲浪高漲下，IC 設計業生存空間縮小，必須持續增加智財權實力，努力提升產品之主導性。

F. 面臨大陸設計業的蓬勃發展，加上蓄意對智財權的忽視，臺灣 IC 設計同業均已受到威脅與影響，本公司除更積極於產品的發展動作，以產品轉型、多樣化及提升更高品質來鞏固市場外，更透過法律途徑保障本公司權益。

G. IC 設計人才普遍缺乏，且培訓時間較長，加上市場產品汰換迅速，經由與大專院校合作延攬優秀人才，並定期舉辦教育訓練培訓研發人才，提供良好的工作環境及晉升管道，維持低人才流動率。

H. 部份客戶對臺灣品牌初期採用的信心度可能較低，本公司選擇合適之客戶進行長期合作，達到量產階段，以提升本公司在此產業之知名度。另外，產品組合不足部份，短期作法為積極尋求產品有互補性之廠商進行策略聯盟，共同推廣市場；長期則將透過技術引進等作法，來增加產品範圍之完整性與廣度。

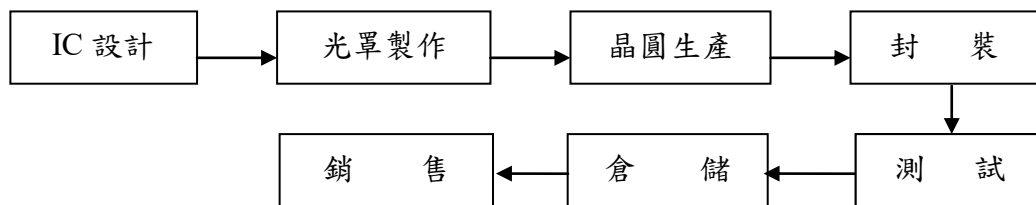
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

主要產品	用 途
微控制器 MCU 產品	應用於家電產品、健康護理產品、汽機車、工業儀表控制、量測、消費性電子、觸控產品、通訊產品及電腦產品。
顯示驅動產品	應用於家電產品、教育、育樂產品、儀器、居家安全、防盜器、健康醫療器材及汽車應用等顯示驅動產品，含 LCD、VFD 及 LED。
電源管理產品	應用在各式電腦及消費性產品電源管理應用，含穩壓、偵壓、DC-DC 及 AC-DC 轉換應用。
記憶體產品	使用於電腦、通訊、消費電子、教育娛樂產品及智慧型金融卡等。

2. 產品產製過程

(1)本公司以設計及行銷為主，產品之前後段製造皆以委外生產為輔。



(2)晶圓代工資源

本公司產品之晶圓代工資源，均為國內外知名大廠如聯電、台積電、漢磊、旺宏等，並建立長久之產品開發與生產合作關係。

(3)封裝

與多家廠商以產能分工之長期合作模式進行如超豐、華泰、日月光等，確保封裝產能無虞。

(4)測試

與多家測試廠合作，如超豐、久元等提供本公司需要之測試技術與設備，並可提供充份之產能。

(5)倉儲作業

A. 主要儲存物品：

(A) 種類分為：晶圓/晶粒/封裝 IC/半成品/物料。

(B) 測試狀態分為：已測/未測。

(C) 依可用性分為：良品/不良品/報廢品。

B. 良好的倉儲規劃及管理與品質保證：

(A) 自動倉儲作業。

- (B) 儲存物品之品質維護。
- (C) 貨物進出的管理與正確性。
- (D) 主動追蹤貨品週轉效率。

(三)主要原料之供應狀況

本公司產品為高精密度積體電路，主要原材料為矽晶圓，主要原料供應廠商均為國內外之世界知名大廠，品質佳且來源穩定，其中更與聯電、台積電、漢磊、旺宏建立長期及良好之生產合作關係，保持晶圓代工資源之優勢，並更積極尋求其他國內外之晶圓代工廠之支援，以支應公司成長之需求。

(四)最近二年度任一年度中占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例：

1.最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	106 年度				107 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A	896,544	35	無	A	878,732	34	無
2	B	334,669	13	無	B	354,956	14	無
3	C	207,043	8	無	C	283,560	11	無
	其他	1,095,148	44	無	其他	1,033,549	41	無
	進貨淨額	2,533,404	100		進貨淨額	2,550,797	100	

註 1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

2.最近二年度銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	106 年度				107 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	欣宏	571,681	12	(註 2)	欣宏	635,592	13	(註 2)
2	CROWN RICH	465,727	10	(註 2)	CROWN RICH	544,069	11	(註 2)
3	NEW WAVE	464,762	10	(註 2)	NEW WAVE	440,018	9	(註 2)
	其他	3,112,747	68		其他	3,243,128	67	
	銷貨淨額	4,614,917	100		銷貨淨額	4,862,807	100	

註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 2：本公司子公司採權益法評價之被投資公司。

(五) 最近二年度生產量值表

單位：仟粒/新台幣仟元

生產 量值 主要商品	年 度	106 年度			107 年度		
		產能	產量	產值	產能	產量	產值
微控制器 IC		--	643,207	1,866,492	--	667,826	1,867,614
週邊 IC		--	447,958	583,140	--	405,805	536,009
開發工具及設計收入		--	259	4,661	--	136	6,110
總 計		--	1,091,424	2,454,293	--	1,073,767	2,409,733

註：本公司所研發設計之產品，主要係委託晶圓代工廠製造，再委外測試、封裝，並無自有產能限制，生產量的多寡係依據當年度之銷售預估。

(六) 最近二年度銷售量值表

單位：仟粒/新台幣仟元

銷售 量值 主要商品	年 度	106 年度				107 年度			
		內 銷		外 銷		內 銷		外 銷	
		量	值	量	值	量	值	量	值
微控制器 IC		54,364	409,523	570,759	2,989,269	42,333	346,059	630,511	3,365,495
週邊 IC		48,641	145,321	394,261	1,053,398	44,603	126,566	355,294	999,633
開發工具及設計收入		235	3,021	38	14,385	35	11,639	788	13,415
總 計		103,240	557,865	965,058	4,057,052	86,971	484,264	986,593	4,378,543

三、從業員工

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

日期：108 年 3 月 31 日

年 度		106 年底	107 年底	當年度截至 108 年 3 月 31 日
員工 人數	工 程 人 員	500	566	566
	管 理 人 員	140	145	142
	生產測試人員	34	41	44
	合 計	674	752	752
平 均 年 歲		36.31	35.78	35.98
平 均 服 務 年 資		7.08 年	7.01	7.16
學歷 分布 比率	博 士	0.5%	0.7%	0.7%
	碩 士	28.6%	27.9%	27.8%
	大 專	62.6%	64.2%	64.0%
	高中(含以下)	8.3%	7.2%	7.5%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失及處分之總額，其未來因應對策及可能之支出：無。

五、勞資關係

(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1.員工福利措施

(1)公司福利

本公司設有餐廳、員工休閒活動區、運動健身器材區、韻律教室、醫務休息室等設施，並舉辦團體保險、定期員工健康檢查等活動，且設有專業醫護人員，提供員工健康管理及健保服務。

(2)職工福利

福委會每年定期舉辦員工旅遊，各項遊戲競賽、年終聚餐、尾牙晚會摸彩等活動，除此之外，還包括生日禮金、年節禮券、旅遊、婚喪、生育、住院等皆有補助。

為促進各種康樂社團，以增進員工團結及情誼，成立各類型之社團活動，並提供社團經費補助，例：桌球社、羽球社、瑜珈社、桌遊社、游泳社等，鼓勵同仁利用工作之餘也能平衡生活，藉以養成運動風氣、提高生活樂趣。

2.進修與教育訓練

本公司對人才的培育一直不遺餘力，除編列預算供員工在外進修外，並由教育訓練委員會、行政部及部門主管針對公司發展目標及各部門需求設計內部訓練課程

，讓每位員工在完整的工作生涯培訓體系下成長：

(1)職前訓練(新人訓練)：

- A.公司文化融入與陶冶：公司統一有新進人員訓練，讓新人了解熟悉本公司組織概況、人事規章、品質政策、工業安全與衛生、人物與環境而實施之訓練。
- B.工作上專業訓練：新進人員有資深工程師擔任指導員，針對相關工作職務規劃完整的培訓課程，幫助基礎設計技術建立及設計環境熟練。

(2)在職訓練：

- A.部門自辦訓練：各部門會針對其專業需求，要求工程師參與部門自辦專長訓練。
- B.公司內部訓練：內部設有教育訓練委員會依據各部門專業需求，聘請專業講師至公司進行長期的專業訓練課程，包括專業技術培訓課程、管理技能培訓課程、品質培訓課程、工安衛生培訓課程、法務智權培訓課程及電腦培訓等多元而充實的訓練課程。
- C.線上學習課程：建立教育訓練平台，整合所有課程訊息、訓練系統及資料查詢，發展 e-learning 及知識管理系統，建立網路教學滿意度調查機制。
- D.公司外部訓練：每人每年固定提供培訓課程經費，可依個人計劃需求安排參與其他外部專業訓練。

E.107 年員工內、外教育訓練實際執行情形：

	總時數	總人數
一般管理	320.5	211
專業技術	452.5	92
新人訓練	380	38

(3)在職進修：

資深工程師可申請國內大學在職進修計劃，增進其專業研究發展技術與管理能力以配合公司未來發展與永續經營的需要。

(4)自我發展：

除培養員工之專業能力，使其能在技術上建立自信心，進而訓練成計劃主持人，在計劃管理上感受團隊合作經驗及建立；另外培養資深員工為公司中堅幹部，依職級需求參與基層、中階、高階主管管理訓練，以提升經營管理能力及績效。

3.退休制度與其實施情形

(1)退休金提繳：

- A.本公司訂有退休辦法並設置勞工之退休準備金監督委員會，依勞動基準法暨勞工退休準備金提撥及管理辦法規定，每月以實際職工薪資總額之 2 %提撥退休基金，並以專戶存於臺灣銀行。
- B.本公司另依勞工退休金條例之規定，對適用勞工退休金條例之員工以每月工資 6%-之提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。

(2)實施情形

本公司勞資雙方依法組織「退休準備金監督委員會」，每季定期由勞資雙方召開勞工退休準備金監督委員會會議，負責管理監督及審核退休準備金之提撥、存

儲、支用等事宜。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司每季定期召開勞資會議，需要討論議案均經勞資雙方充分溝通，達成共識後執行，迄今勞資間關係良好，雇主與員工之間互動密切。

本公司設有行政人事專責單位制定各項符合相關勞基法令規定之制度及措施，保障員工之各項權益，若員工有任何意見，均可透過各種溝通管道向各級主管及行政單位反應及爭取權益。

5.員工行為與倫理守則

本公司訂定「道德行為準則」、「員工守則」及「同仁廉潔守則」規範全體同仁對於經管或監督之業務，不得利用職務之便，行直接或間接圖利之行為，以獲取不當利益或其他舞弊情事，並將上述規範納入公司規章及新進人員訓練教材中，定期對全體新進人員作宣導。

6.工作環境與員工安全保護措施

本公司於 2006 年取得國際 OHSAS18001 職業安全衛生管理認證，每季定期召開職業安全衛生委員會議，推動各項員工安全衛生業務的持續改善活動，包括安全衛生相關訓練，創造優良的工作環境，並保護員工身心健康與安全。

(1)門禁安全：除大樓之保全人員 24 小時守衛外，各出入口及角落地區設有監視攝影器，並加強夜間、假日保安全管理，以保障員工人身安全。

(2)消防安全：

A.定期委請廠商進行保養及維修消防設備(例：消防警報器、滅火器)，並設有專責人員定期檢視後做成記錄。

B.每年定期舉辦消防演習及緊急避難措施，推行全員預防認知責任。

(3)環境安全：為維護員工飲用水衛生品質及健康，每季委請廠商進行抽樣檢測飲用水機之大腸桿菌群，定期實施辦公室清潔與消毒作業，並於坐式廁所提供 75% 酒精，以確保工作環境安全與舒適。

(4)員工健康檢查：本公司每年定期委託醫療機構特別至公司安排員工各項身體健康檢查，並設有專門之醫護人員提供醫護服務，以及每二個月安排專業醫師至公司看診及舉辦健康講座，注重員工身心健康。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

六、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
土地租賃	新竹科學工業園區管理局	90/03/15~109/12/31	租賃自建廠房用土地	限自建廠房用
技術授權	Arm Limited	96/06/25~永久	Arm® Cortex™-M3 技術授權	不得違反相關法令之規定
技術授權	Arm Limited	102/09/24~永久	Arm® Cortex™-M0+ 技術授權	不得違反相關法令之規定
技術授權	晶心科技	104/04/01~107/03/31	Andestech D10 CPU Softcore 技術授權	不得違反相關法令之規定

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

(一) 國際財務報導準則-合併資訊

1. 簡明資產負債表

單位：新台幣仟
元

年 度 項 目		最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)				
		103 年	104 年	105 年	106 年	107 年
流 動 資 產		3,830,158	3,824,522	3,928,641	4,179,054	4,322,111
不 動 產、廠 房 及 設 備		487,863	463,561	442,570	414,729	398,515
無 形 資 產		—	—	—	—	—
其 他 資 產		741,545	775,954	763,556	770,487	834,874
資 產 總 額		5,059,566	5,064,037	5,134,767	5,364,270	5,555,500
流 動 負 債	分 配 前	858,093	854,700	977,382	1,068,788	1,079,483
	分 配 後	1,649,682	1,662,120	1,768,971	1,996,078	(註 2)
非 流 動 負 債		143,866	163,141	173,262	196,636	251,918
負 債 總 額	分 配 前	1,001,959	1,017,841	1,150,644	1,265,424	1,331,401
	分 配 後	1,793,548	1,825,261	1,942,233	2,192,714	(註 2)
歸屬於母公司業主之 權 益		4,038,632	4,027,963	3,965,330	4,071,239	4,199,170
股 本		2,261,682	2,261,682	2,261,682	2,261,682	2,261,682
資 本 公 積		142,309	142,309	159,281	142,309	142,309
保 留 盈 餘	分 配 前	1,588,979	1,591,692	1,568,678	1,699,004	1,832,565
	分 配 後	797,390	784,272	777,089	771,714	(註 2)
其 他 權 益		45,662	32,280	(24,311)	(31,756)	(37,386)
庫 藏 股 票		—	—	—	—	—
非 控 制 權 益		18,975	18,233	18,793	27,607	24,929
權 益 總 額	分 配 前	4,057,607	4,046,196	3,984,123	4,098,846	4,224,099
	分 配 後	3,266,018	3,238,776	3,192,534	3,171,556	(註 2)

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：俟股東常會決議後定案。

2.簡明綜合損益表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)				
	103 年	104 年	105 年	106 年	107 年
營 業 收 入	3,930,519	3,967,840	4,157,788	4,614,917	4,862,807
營 業 毛 利	1,888,747	1,948,478	2,018,145	2,189,460	2,406,974
營 業 損 益	817,495	846,550	833,690	943,311	1,110,730
營 業 外 收 入 及 支 出	121,024	100,153	84,273	126,479	134,859
稅 前 淨 利	938,519	946,703	917,963	1,069,790	1,245,589
繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利	798,584	818,321	792,722	935,987	1,070,366
停 業 單 位 損 失	—	—	—	—	—
本 期 淨 利 (損)	798,584	818,321	792,722	935,987	1,070,366
本 期 其 他 綜 合 損 益 (稅 後 淨 額)	30,596	(25,886)	(56,403)	(11,703)	(76,197)
本 期 綜 合 損 益 總 額	829,180	792,435	736,319	924,284	994,169
淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主	791,556	806,806	784,218	926,188	1,063,990
淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益	7,028	11,515	8,504	9,799	6,376
綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 公 司 業 主	822,225	780,920	727,815	914,470	987,931
綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 制 權 益	6,955	11,515	8,504	9,814	6,238
每 股 盈 餘	3.50	3.57	3.47	4.10	4.70

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

(二) 國際財務報導準則-個體資訊

1.簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目		最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)				
		103 年	104 年	105 年	106 年	107 年
流 動 資 產		3,314,680	3,238,852	3,299,082	3,470,083	3,546,143
不動產、廠房及設備		192,841	185,281	177,908	165,050	151,248
無 形 資 產		—	—	—	—	—
其 他 資 產		1,468,756	1,541,722	1,540,790	1,595,737	1,749,444
資 產 總 額		4,976,277	4,965,855	5,017,780	5,230,870	5,446,835
流 動 負 債	分 配 前	796,996	778,756	883,701	968,014	1,002,792
	分 配 後	1,588,585	1,586,176	1,675,290	1,895,304	(註 2)
非 流 動 負 債		140,649	159,136	168,749	191,617	244,873
負 債 總 額	分 配 前	937,645	937,892	1,052,450	1,159,631	1,247,665
	分 配 後	1,729,234	1,745,312	1,844,039	2,086,921	(註 2)
歸屬於母公司業主之權益		4,038,632	4,027,963	3,965,330	4,071,239	4,199,170
股 本		2,261,682	2,261,682	2,261,682	2,261,682	2,261,682
資 本 公 積		142,309	142,309	159,281	142,309	142,309
保 留 盈 餘	分 配 前	1,588,979	1,591,692	1,568,678	1,699,004	1,832,565
	分 配 後	797,390	784,272	777,089	771,714	(註 2)
其 他 權 益		45,662	32,280	(24,311)	(31,756)	(37,386)
庫 藏 股 票		—	—	—	—	—
非 控 制 權 益		—	—	—	—	—
權 益 總 額	分 配 前	4,038,632	4,027,963	3,965,330	4,071,239	4,199,170
	分 配 後	3,247,043	3,220,543	3,173,741	3,143,949	(註 2)

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：俟股東常會決議後定案。

2.簡明綜合損益表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)				
	103 年	104 年	105 年	106 年	107 年
營 業 收 入	3,605,717	3,601,285	3,695,728	4,130,794	4,358,758
營 業 毛 利	1,685,380	1,719,836	1,734,684	1,895,447	2,084,309
營 業 損 益	794,650	810,424	786,319	880,236	1,051,333
營 業 外 收 入 及 支 出	132,769	119,254	115,062	171,629	181,577
稅 前 淨 利	927,419	929,678	901,381	1,051,865	1,232,910
繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利	791,556	806,806	784,218	926,188	1,063,990
停 業 單 位 損 失	—	—	—	—	—
本 期 淨 利 (損)	791,556	806,806	784,218	926,188	1,063,990
本 期 其 他 綜 合 損 益 (稅 後 淨 額)	30,669	(25,886)	(56,403)	(11,718)	(76,059)
本 期 綜 合 損 益 總 額	822,225	780,920	727,815	914,470	987,931
淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主	791,556	806,806	784,218	926,188	1,063,990
淨利歸屬於非控制權益	—	—	—	—	—
綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 公 司 業 主	822,225	780,920	727,815	914,470	987,931
綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 制 權 益	—	—	—	—	—
每 股 盈 餘	3.50	3.57	3.47	4.10	4.70

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

(三) 最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見

年度	簽證會計師	所屬單位名稱	查核意見
103	魏興海、曾漢鈺	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
104	曾漢鈺、游萬淵	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
105	曾漢鈺、游萬淵	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
106	曾漢鈺、游萬淵	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
107	曾漢鈺、游萬淵	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見

二、最近五年度財務分析

(一) 國際財務報導準則—合併資訊

年 度 分析項目（註2）		最近五年度財務分析（註1）				
		103 年	104 年	105 年	106 年	107 年
財務結構 (%)	負債占資產比率	20	20	22	23	24
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	832	873	900	988	1,060
償債能力 (%)	流動比率	446	447	402	391	400
	速動比率	387	378	349	335	339
	利息保障倍數	—	—	—	—	—
經營能力	應收款項週轉率(次)	6.07	5.85	5.91	5.78	5.66
	平均收現日數	60	62	62	63	64
	存貨週轉率(次)	4.02	3.71	3.90	4.39	3.93
	應付款項週轉率(次)	4.40	4.29	4.12	4.15	4.04
	平均銷貨日數	91	98	94	83	93
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	7.96	8.34	9.18	10.77	11.96
	總資產週轉率(次)	0.78	0.78	0.81	0.86	0.88
獲利能力	資產報酬率(%)	16	16	15	18	19
	權益報酬率(%)	20	20	20	23	26
	稅前純益占實收資本額比率(%)	41	42	41	47	55
	純益率(%)	20	20	19	20	22
	每股盈餘（元）	3.50	3.57	3.47	4.10	4.70
現金流量	現金流量比率(%)	114	90	95	65	114
	現金流量允當比率(%)	124	110	111	111	104
	現金再投資比率(%)	5	(1)	2	(2)	6
槓桿度	營運槓桿度	1.86	1.90	1.99	1.97	1.85
	財務槓桿度	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
請說明最近二年度各項財務比率變動原因(若增減變動未達 20%者可免分析)						
1、現金流量比率較 106 年度上升，主要係 107 年度營業活動之淨現金流入增加所致。						
2、現金再投資比率較106年度上升，主要係107年度營業活動之淨現金流入增加所致。						

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：分析項目之計算公式如後。

(二) 國際財務報導準則—個體資訊

年 度 分析項目 (註 2)		最 近 五 年 度 財 務 分 析 (註 1)				
		103 年	104 年	105 年	106 年	107 年
財務結構 (%)	負債占資產比率	19	19	21	22	23
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	2,094	2,174	2,229	2,467	2,776
償債能力 %	流動比率	416	416	373	358	354
	速動比率	362	352	325	308	300
	利息保障倍數	—	—	—	—	—
經營能力	應收款項週轉率(次)	5.99	5.66	5.92	5.87	5.68
	平均收現日數	61	64	62	62	64
	存貨週轉率(次)	4.38	4.09	4.30	4.93	4.46
	應付款項週轉率(次)	4.45	4.35	4.11	4.13	4.02
	平均銷貨日數	83	89	85	74	82
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	17.99	19.05	20.35	24.09	27.56
	總資產週轉率(次)	0.72	0.73	0.74	0.79	0.80
獲利能力	資產報酬率(%)	16	16	16	18	20
	權益報酬率(%)	20	20	20	23	26
	稅前純益占實收資本額比率(%)	41	41	40	47	55
	純益率(%)	22	22	21	22	24
	每股盈餘 (元)	3.50	3.57	3.47	4.10	4.70
現金流量	現金流量比率(%)	108	88	95	59	116
	現金流量允當比率(%)	118	103	102	103	97
	現金再投資比率(%)	3	(2)	1	(5)	5
槓桿度	營運槓桿度	1.73	1.76	1.83	1.85	1.72
	財務槓桿度	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
請說明最近二年度各項財務比率變動原因(若增減變動未達 20%者可免分析)						
1、現金流量比率較 106 年度上升，主要係 107 年度營業活動之淨現金流入增加所致。						
2、現金再投資比率較 106 年度上升，主要係 107 年度營業活動之淨現金流入增加所致。						

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：分析項目之計算公式如後。

財務分析計算公式

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告：詳見第 70 頁。

四、最近年度財務報告：詳見第 71 頁~第 130 頁。

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告：詳見第 131 頁~第 180 頁。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響：無。

三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告

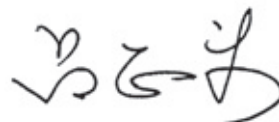
盛群半導體股份有限公司 審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一〇七年度營業報告書、財務報告及盈餘分配議案等，其中財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺及游萬淵會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配議案經本審計委員會查核竣事，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

盛群半導體股份有限公司一〇八年股東常會

審計委員會召集人：呂正樂



中 華 民 國 一 〇 八 年 三 月 六 日

會計師查核報告

盛群半導體股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

盛群半導體股份有限公司及其子公司(盛群集團)民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達盛群集團民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與盛群集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對盛群集團民國一〇七年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、銷貨收入－關係人及未實現銷貨毛利

有關收入認列之評估會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)收入認列。與關係人間之重大交易事項請詳合併財務報告附註七(二)。

關鍵查核事項之說明：

收入為企業永續經營之基本營運活動，攸關企業營運績效，因主要交易對象為關係人，其先天存在較高舞弊風險，故收入認列－關係人及未實現銷貨毛利之測試為本會計師執行盛群集團合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之相關控制並評估商業交易之合理性；評估收入趨勢分析；瞭解關係人交易及對帳執行情形；執行關係人函証發函詢証；評估銷貨毛利率及未實現銷貨毛利之正確性及合理性；並評估盛群集團是否已適當揭露關係人銷貨收入及未實現銷貨毛利之相關資訊。

二、存貨備抵跌價損失之評估

有關存貨備抵跌價損失之評估會計政策請詳合併財務報告附註四(九)存貨；存貨備抵跌價損失之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五。相關說明請詳合併財務報告附註六(六)(重要會計項目說明—存貨)。

關鍵查核事項之說明：

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低衡量，盛群集團評估報導日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎，故可能因產業快速變遷而產生重大變動，因此，存貨備抵跌價損失之評估測試為本會計師執行盛群集團合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視存貨庫齡報表分析各期存貨庫齡變化情形；執行電腦審計程序以檢查存貨庫齡報表之正確性；檢視管銷會議評估存貨去化情形；評估存貨之評價是否已按盛群集團既訂之會計政策；執行存貨備抵跌價提列之回溯性測試，以驗證提列呆滯損失之合理性。

其他事項

盛群半導體股份有限公司已編製民國一〇七年度及一〇六年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估盛群集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算盛群半導體股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

盛群集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對盛群集團內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使盛群集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致盛群集團不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對盛群集團民國一〇七年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

曾漢鈺



游萬齡



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號
民國一〇八年一月二十八日



盛群半導體股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		107.12.31		106.12.31	
		金額	%	金額	%
資 產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,517,632	27	1,391,728	26
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動				
	(附註六(二))	486,555	9	582,902	11
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(五))	97,604	2	115,164	2
1180	應收帳款－關係人淨額(附註六(五)及七)	749,789	13	755,407	14
130X	存貨(附註六(六))	654,866	12	594,589	11
1476	其他金融資產－流動(附註六(七)及八)	784,175	14	711,632	13
1470	其他流動資產	31,490	1	27,632	1
		4,322,111	78	4,179,054	78
非流動資產：					
1518	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資				
	－非流動(附註六(三))	265,161	5	-	-
1543	以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(四))	-	-	259,446	5
1550	採用權益法之投資(附註六(八)及七)	449,015	8	419,129	8
1600	不動產、廠房及設備(附註六(九))	398,515	7	414,729	8
1840	遞延所得稅資產(附註六(十二))	69,706	1	49,503	1
1900	其他非流動資產	50,992	1	42,409	-
		1,233,389	22	1,185,216	22
		\$ 5,555,500	100	5,364,270	100
資產總計					
負債及權益					
流動負債：					
	應付票據	\$ 125,021	2	146,854	3
	應付帳款	489,388	9	454,078	8
	應付薪資	281,788	5	276,046	5
	本期所得稅負債	97,904	2	85,271	2
	其他流動負債	85,382	2	106,539	2
		1,079,483	20	1,068,788	20
非流動負債：					
	遞延所得稅負債(附註六(十二))	166,610	3	114,988	2
	淨確定福利負債－非流動(附註六(十一))	76,602	1	72,938	1
	存入保證金	8,706	-	8,710	-
		251,918	4	196,636	3
		1,331,401	24	1,265,424	23
負債總計					
權益(附註六(十三))：					
歸屬母公司業主之權益：					
	普通股股本	2,261,682	41	2,261,682	42
	資本公積	142,309	3	142,309	3
	保留盈餘	1,832,565	33	1,699,004	32
	其他權益	(37,386)	(1)	(31,756)	(1)
	歸屬母公司業主之權益總計	4,199,170	76	4,071,239	76
	非控制權益	24,929	-	27,607	1
		4,224,099	76	4,098,846	77
		\$ 5,555,500	100	5,364,270	100
負債及權益總計					



董事長：吳啟勇



經理人：高國棟

(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：廖明通



盛群半導體股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		107年度		106年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十六)及七)	\$ 4,862,807	100	4,614,917	100
5000	營業成本(附註六(六)、(十一)、(十五)、七及十二)	2,455,833	51	2,425,457	53
	營業毛利	2,406,974	49	2,189,460	47
5910	未實現銷貨利益之變動	12,624	-	27,374	1
	已實現營業毛利	2,394,350	49	2,162,086	46
	營業費用(附註六(十一)、(十五)及十二)：				
6100	推銷費用	115,839	2	108,576	2
6200	管理費用	381,627	8	367,250	8
6300	研究發展費用	783,088	16	742,949	16
6450	預期信用減損損失(附註六(五))	3,066	-	-	-
		1,283,620	26	1,218,775	26
	營業淨利	1,110,730	23	943,311	20
	營業外收入及支出：				
7020	其他利益及損失(附註六(十七))	15,471	1	33,956	1
7070	採用權益法認列之關聯企業利益之份額(附註六(八))	97,105	2	81,967	2
7100	利息收入	14,568	-	10,556	-
7130	股利收入	7,715	-	-	-
		134,859	3	126,479	3
	稅前淨利	1,245,589	26	1,069,790	23
7950	所得稅費用(附註六(十二))	175,223	4	133,803	3
	本期淨利	1,070,366	22	935,987	20
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註六(十一))	(5,618)	-	(5,148)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(58,603)	(1)	-	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十二))	1,124	-	875	-
		(63,097)	(1)	(4,273)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(16,569)	-	(9,411)	-
8371	採用權益法認列關聯企業之國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(521)	-	456	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十二))	3,990	-	1,525	-
		(13,100)	-	(7,430)	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(76,197)	(1)	(11,703)	-
	本期綜合損益總額	\$ 994,169	21	924,284	20
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	1,063,990	22	926,188	20
8620	非控制權益	6,376	-	9,799	-
		1,070,366	22	935,987	20
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	987,931	21	914,470	20
8720	非控制權益	6,238	-	9,814	-
		994,169	21	924,284	20
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))				
9750	基本每股盈餘	\$ 4.70		\$ 4.10	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 4.66		\$ 4.06	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：吳啟勇



經理人：高國棟



會計主管：廖明通



盛群半導體股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	保留盈餘		國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	其他權益 透過其他綜 合損益按公 允價值衡量 之金融資產 未實現損益	合 計	歸屬於母 公司業主之 權益總計	非控制 權益	權益總計
					未分配 盈餘	合 計						
民國一〇六年一月一日餘額	\$ 2,261,682	159,281	781,525	2,642	784,511	1,568,678	(24,311)	-	(24,311)	3,965,330	18,793	3,984,123
本期淨利	-	-	-	-	926,188	926,188	-	-	-	926,188	9,799	935,987
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,273)	(4,273)	(7,445)	-	(7,445)	(11,718)	15	(11,703)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	921,915	921,915	(7,445)	-	(7,445)	914,470	9,814	924,284
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	78,422	-	(78,422)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	24,312	(24,312)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(109,918)	-	(681,671)	(791,589)	-	-	-	(791,589)	-	(791,589)
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	(16,972)	-	-	-	-	-	-	-	(16,972)	-	(16,972)
子公司發放現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,653)	(7,653)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,653	6,653
民國一〇六年十二月三十一日餘額	2,261,682	142,309	750,029	26,954	922,021	1,699,004	(31,756)	-	(31,756)	4,071,239	27,607	4,098,846
追溯適用新準則之調整數	-	-	-	-	-	-	-	67,290	67,290	67,290	-	67,290
民國一〇七年一月一日重編後餘額	2,261,682	142,309	750,029	26,954	922,021	1,699,004	(31,756)	67,290	35,534	4,138,529	27,607	4,166,136
本期淨利	-	-	-	-	1,063,990	1,063,990	-	-	-	1,063,990	6,376	1,070,366
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,494)	(4,494)	(12,962)	(58,603)	(71,565)	(76,059)	(138)	(76,197)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,059,496	1,059,496	(12,962)	(58,603)	(71,565)	987,931	6,238	994,169
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	92,202	-	(92,202)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	7,445	(7,445)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(104,942)	-	(822,348)	(927,290)	-	-	-	(927,290)	-	(927,290)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	1,355	1,355	-	(1,355)	(1,355)	-	-	-
子公司發放現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,916)	(8,916)
民國一〇七年十二月三十一日餘額	\$ 2,261,682	142,309	737,289	34,399	1,060,877	1,832,565	(44,718)	7,332	(37,386)	4,199,170	24,979	4,224,099

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：吳啟勇

經理人：高國棟

會計主管：廖明通

盛群半導體股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	107年度	106年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,245,589	1,069,790
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	57,598	57,019
攤銷費用	55,025	69,914
預期信用減損損失	3,066	-
利息收入	(14,568)	(10,556)
股利收入	(7,715)	-
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(97,105)	(81,967)
處分採用權益法之投資利益	-	(17,215)
聯屬公司間未實現銷貨利益變動	12,624	27,374
其他不影響現金流量之損費淨額	6,893	3,558
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	97,382	(222,513)
應收票據及帳款(含應收關係人帳款)增加	(4,751)	(148,039)
存貨增加	(71,144)	(90,600)
其他營業資產增加	(18,577)	(2,164)
應付票據及帳款增加	19,821	34,597
淨確定福利負債減少	(1,953)	(1,784)
其他營業負債增加	8,904	37,824
營運產生之現金流入	1,291,089	725,238
收取之利息	14,576	10,108
收取之股利	51,763	63,626
支付之所得稅	(126,976)	(99,701)
營業活動之淨現金流入	1,230,452	699,271
投資活動之現金流量：		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	2,972	-
取得以成本衡量之金融資產	-	(14,717)
取得採用權益法之投資	-	(12,106)
取得不動產、廠房及設備	(47,892)	(34,301)
處分不動產、廠房及設備	797	1,544
存出保證金增加	(3,320)	(222)
取得子公司之淨現金流入數	-	371
其他金融資產(增加)減少	(57,110)	448,994
其他非流動資產增加	(66,068)	(49,271)
收取之股利	7,715	-
投資活動之淨現金(流出)流入	(162,906)	340,292
籌資活動之現金流量：		
發放股東現金股利	(927,290)	(791,589)
非控制權益變動	(11,823)	(4,703)
籌資活動之淨現金流出	(939,113)	(796,292)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,529)	(850)
本期現金及約當現金增加數	125,904	242,421
期初現金及約當現金餘額	1,391,728	1,149,307
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,517,632	1,391,728

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：吳啟勇



經理人：高國棟



會計主管：廖明通



盛群半導體股份有限公司及子公司
合併財務報告附註
民國一〇七年度及一〇六年度
(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

盛群半導體股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國八十七年十月一日依中華民國公司法及科學園區設置管理條例之規定成立，自民國八十七年十二月十一日開始營業，民國八十九年四月於香港設立分公司。本公司股票自民國九十一年十一月四日起於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌買賣，自民國九十三年九月二十七日起改於台灣證券交易所股份有限公司掛牌買賣。

本公司及子公司(以下併稱「合併公司」)主要營業項目為各種積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告已於民國一〇八年一月二十八日經提報董事會後發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會認可之新發布及修訂後準則及解釋之影響

合併公司自民國一〇七年起全面採用經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)認可並於民國一〇七年生效之國際財務報導準則編製合併財務報告。相關新發布、修正及修訂之準則及解釋彙列如下：

新發布／修正／修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第2號之修正「股份基礎給付交易之分類及衡量」	2018年1月1日
國際財務報導準則第4號之修正「於國際財務報導準則第4號『保險合約』下國際財務報導準則第9號『金融工具』之適用」	2018年1月1日
國際財務報導準則第9號「金融工具」	2018年1月1日
國際財務報導準則第15號「客戶合約之收入」	2018年1月1日
國際會計準則第7號之修正「揭露倡議」	2017年1月1日
國際會計準則第12號之修正「未實現損失之遞延所得稅資產之認列」	2017年1月1日
國際會計準則第40號之修正「投資性不動產之轉列」	2018年1月1日

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

新發布／修正／修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則2014-2016週期之年度改善：	
國際財務報導準則第12號之修正	2017年1月1日
國際財務報導準則第1號之修正及國際會計準則第28號之修正	2018年1月1日
國際財務報導解釋第22號「外幣交易與預收(付)對價」	2018年1月1日

除下列項目外，適用上述新認可之國際財務報導準則對合併財務報告未造成重大變動。造成重大變動者之性質及影響說明如下：

1. 國際財務報導準則第十五號「客戶合約之收入」

該準則取代國際會計準則第十八號「收入」、國際會計準則第十一號「建造合約」及相關解釋，以單一分析模型按五個步驟決定企業認列收入之方法、時點及金額。合併公司採累積影響數法適用國際財務報導準則第十五號，因此，以前期間之比較資訊無須重編而係繼續適用國際會計準則第十八號、國際會計準則第十一號及相關解釋，初次適用國際財務報導準則第十五號之累積影響數係調整民國一〇七年一月一日之保留盈餘。

此項會計政策變動之性質及影響說明如下：

銷售商品

針對產品之銷售，過去係於商品交付至客戶場址時認列收入，於該時點客戶已接受該產品，且相關所有權之重大風險及報酬已移轉予客戶。於該時點認列收入，係因該時點收入及成本能可靠衡量、對價很有可能收回，且不再繼續參與對商品之管理。國際財務報導準則第十五號下，係於客戶取得對產品之控制時認列收入。

首次適用國際財務報導準則第十五號之規定編製之合併綜合損益表與適用國際會計準則第十八號「收入」及相關解釋所編製者，並無重大差異。

2. 國際財務報導準則第九號「金融工具」

國際財務報導準則第九號「金融工具」(以下稱國際財務報導準則第九號或IFRS 9)取代國際會計準則第三十九號「金融工具：認列與衡量」(以下稱國際會計準則第三十九號或IAS 39)，修正金融工具之分類與衡量、減損及避險會計。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

由於採用國際財務報導準則第九號，合併公司採用修正後之國際會計準則第一號「財務報表之表達」，該準則規定於綜合損益表將金融資產之減損列報為單行項目，先前合併公司係將應收帳款之減損列報於管理費用。此外，合併公司採用修正後之國際財務報導準則第七號「金融工具：揭露」揭露民國一〇七年資訊，該等規定通常不適用於比較期資訊。

合併公司適用國際財務報導準則第九號導致之會計政策重大變動說明如下：

(1) 金融資產及負債之分類

該準則主要將金融資產分類為按攤銷後成本衡量、透過其他綜合損益按公允價值衡量及透過損益按公允價值衡量三類，國際財務報導準則第九號下金融資產之分類係以持有該金融資產之經營模式及其合約現金流量特性為基礎，並刪除原準則下持有至到期日、放款及應收款及備供出售金融資產之分類。依該準則，混合合約包含之主契約若屬該準則範圍內之金融資產，則不拆分嵌入之衍生工具，而係評估整體混合金融工具之分類。合併公司於國際財務報導準則第九號下金融資產之分類、衡量及相關利益及損失認列之會計政策說明請詳附註四(七)。

採用國際財務報導準則第九號對合併公司之金融負債會計政策無重大影響。

(2) 金融資產之減損

該準則以前瞻性之預期信用損失模式取代現行國際會計準則第三十九號已發生減損損失模式，新減損模式適用於按攤銷後成本衡量之金融資產、合約資產及透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資，但不適用於權益工具投資。國際財務報導準則第九號下，信用損失之認列時點早於國際會計準則第三十九號下之認列時點，請詳附註四(七)。

(3) 過渡處理

除下列項目外，通常係追溯適用國際財務報導準則第九號：

- 適用國際財務報導準則第九號所產生之金融資產帳面金額差異數，係認列於民國一〇七年一月一日之保留盈餘及其他權益項目，據此，民國一〇六年表達之資訊通常不會反映國際財務報導準則第九號之規定，因此，與民國一〇七年適用國際財務報導準則第九號所揭露之資訊不具可比性。
- 下列事項係以初次適用日存在之事實及情況為基礎評估：
 - 判定金融資產係以何種經營模式持有。
 - 先前指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產及金融負債之指定及撤銷。
 - 部分非持有供交易之權益工具投資作透過其他綜合損益按公允價值衡量之指定。
- 若債務證券投資於國際財務報導準則第九號初始適用日之信用風險低，則合併公司假定該資產自原始認列日信用風險未顯著增加。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(4)國際財務報導準則第九號初次適用日之金融資產分類

適用國際會計準則第三十九號衡量種類之金融資產轉換至國際財務報導準則第九號衡量種類之金融資產，該金融資產民國一〇七年一月一日之新衡量種類、帳面金額及說明如下(金融負債之衡量種類及帳面金額未改變)：

金融資產	IAS39		IFRS9	
	衡量種類	帳面金額	衡量種類	帳面金額
現金及約當現金	放款及應收款	1,391,728	攤銷後成本	1,391,728
權益工具投資	備供出售(註1)	259,446	透過其他綜合損益按公允價值衡量	326,736
應收款項淨額	放款及應收款	870,571	攤銷後成本	870,571
其他金融資產(三個月以上定存)	放款及應收款(無活絡市場之債務工具投資)	711,632	攤銷後成本	711,632
存出保證金	放款及應收款	7,972	攤銷後成本	7,972

註1：該等權益工具(以成本衡量之金融資產)代表合併公司意圖長期持有策略之投資，按照國際財務報導準則第九號之規定，合併公司於初始適用日指定該投資分類為透過其他綜合損益按公允價值衡量，因此，民國一〇七年一月一日該等資產之帳面金額及其他權益項目皆增加67,290千元。

民國一〇七年一月一日金融資產帳面金額自國際會計準則第三十九號之調節至國際財務報導準則第九號之調節表如下：

	106.12.31 IAS 39			107.1.1 IFRS 9		107.1.1 保留盈餘	107.1.1 其他權益
	帳面金額	重分類	再衡量	帳面金額	調整數	調整數	調整數
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							
備供出售(包括以成本衡量)IAS 39期初數	\$ -	259,446	-	259,446	-	-	-
備供出售重分類至透過其他綜合損益按公允價值衡量	-	-	67,290	67,290	-	-	67,290
	<u>\$ -</u>	<u>259,446</u>	<u>67,290</u>	<u>326,736</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>67,290</u>

3.國際會計準則第十二號之修正「未實現損失之遞延所得稅資產之認列」

修正條文闡明符合特定條件之情況下，將對未實現損失認列遞延所得稅資產，並釐清「未來課稅所得」之計算方式。

適用國際會計準則第十二號對合併公司並無重大影響。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(二)尚未採用金管會認可之國際財務報導準則之影響

依據金管會民國一〇七年七月十七日金管證審字第1070324857號令，公開發行以上公司應自民國一〇八年起全面採用經金管會認可並於民國一〇八年生效之國際財務報導準則。相關新發布、修正及修訂之準則及解釋彙列如下：

新發布／修正／修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第16號「租賃」	2019年1月1日
國際財務報導解釋第23號「所得稅務處理之不確定性」	2019年1月1日
國際財務報導準則第9號之修正「具有負補償之提前還款特性」	2019年1月1日
國際會計準則第19號之修正「計畫修正、縮減或清償」	2019年1月1日
國際會計準則第28號之修正「對關聯企業及合資之長期權益」	2019年1月1日
國際財務報導準則2015-2017週期之年度改善	2019年1月1日

除下列項目外，適用上述新認可之國際財務報導準則將不致對合併財務報告造成重大變動。造成重大變動者之性質及影響說明如下：

1.國際財務報導準則第十六號「租賃」

該準則將取代現行國際會計準則第十七號「租賃」、國際財務報導解釋第四號「決定一項安排是否包含租賃」、解釋公告第十五號「營業租賃：誘因」及解釋公告第二十七號「評估涉及租賃之法律形式之交易實質」。

新準則針對承租人採用單一會計處理模式將租賃交易認列於資產負債表，並以使用權資產表達其使用標的資產之權利，以租賃負債表達支付租賃給付之義務。此外，該等租賃相關之費用將以折舊及利息取代現行營業租賃下以直線基礎認列租金之方式表達。另對於短期租賃及低價值標的資產租賃提供認列豁免規定。出租人之會計處理則維持與現行準則類似，亦即，出租人仍應將租賃分類為營業租賃或融資租賃。

(1)判斷合約是否包含租賃

於過渡至新準則時，合併公司得選擇：

- 針對所有合約適用新準則規定之租賃定義；或
- 採用實務權宜作法而不重新評估合約是否為或包含租賃。

合併公司預計於過渡時採用實務權宜作法豁免租賃定義之重評估，亦即，合併公司係將民國一〇八年一月一日前所簽訂之所有合約適用現行規定之租賃定義。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(2)過渡處理

合併公司為承租人之合約，得就所有合約選擇：

- 完全追溯；或
- 修正式追溯及一個或多個實務權宜作法

合併公司預計採用修正式追溯過渡至新準則，因此不重編比較期資訊。

於採用修正式追溯時，現行準則分類為營業租賃之合約得以個別合約為基礎，於過渡時選擇是否採用一個或多個實務權宜作法。合併公司評估將採用以下實務權宜作法：

- 針對具有類似特性之租賃組合採用單一折現率；
- 依其於初次適用日前刻依據IAS37虧損性合約之評估結果，作為對使用權資產減損評估之替代方法；
- 針對租賃期間於初次適用日後12個月內結束之租賃，適用豁免而不認列使用權資產及租賃負債；
- 不將原始直接成本計入初次適用日之使用權資產衡量中；
- 於租賃合約包含租賃延長或終止選擇權下，決定租賃期間時，採用後見之明。

(3)截至目前為止，合併公司評估適用新準則最重大的影響係針對現行以營業租賃承租辦公處所認列使用權資產及租賃負債，預估上述差異可能使民國一〇八年一月一日使用權資產及租賃負債均增加108,335千元。

2.國際財務報導解釋第23號「所得稅務處理之不確定性」

新解釋闡明於評估具不確定性之租稅處理對課稅所得(損失)、課稅基礎、未使用課稅損失、未使用投資抵減及稅率之影響時，應假設租稅主管機關將依法審查相關金額，並且於審查時已取得所有相關資訊。

若評估後認為租稅主管機關很有可能接受一項具不確定性之租稅處理，則應以與租稅申報時所使用之處理一致之方式決定課稅所得(損失)、課稅基礎、未使用課稅損失、未使用投資抵減及稅率；反之，若並非很有可能，則得以最有可能金額或期望值兩者較適用者，反映每一項具不確定性之租稅處理之影響。

截至目前為止，合併公司評估適用新解釋並無重大影響。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(三)金管會尚未認可之新發布及修訂準則及解釋

下表彙列國際會計準則理事會(以下簡稱理事會)已發布及修訂但尚未經金管會認可之準則及解釋：

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布之生效日
國際財務報導準則第3號之修正「業務之定義」	2020年1月1日
國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	尚待理事會決定
國際財務報導準則第17號「保險合約」	2021年1月1日
國際會計準則第1號及國際會計準則第8號之修正「重大性之定義」	2020年1月1日

合併公司現正持續評估上述準則及解釋對合併公司財務狀況與經營結果之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

本合併財務報告所採用之重大會計政策彙總說明如下，下列會計政策已一致適用於本合併財務報告之所有表達期間。

(一)遵循聲明

本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則」)編製。

(二)編製基礎

1.衡量基礎

除下列資產負債表之重要項目外，本合併財務報告係依歷史成本為基礎編製：

- (1)依公允價值衡量之透過損益按公允價值衡量金融資產；
- (2)依公允價值衡量之透過其他綜合損益按公允價值金融資產；及
- (3)淨確定福利負債，係依退休基金資產之公允價值減除確定福利義務現值。

2.功能性貨幣及表達貨幣

合併公司以營運所處主要經濟環境之貨幣為功能性貨幣。本合併財務報告係以本公司之功能性貨幣，新台幣表達。所有以新台幣表達之財務資訊均以新台幣千元為單位。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(三)合併基礎

1.合併財務報告編製原則

合併財務報告之編製主體包含本公司及本公司之子公司。

自取得子公司控制力之日起，開始將其財務報告納入合併財務報告，直至不再具有控制力之日為止。歸屬於子公司非控制權益之損益歸屬於非控制權益，即使非控制權益因而成為虧損餘額亦然。

合併公司間之重大交易、餘額及未實現收益與費用，於編製合併財務報告時均已消除。

2.列入合併財務報告之子公司

列入本合併財務報告之子公司包含：

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比	
			107.12.31	106.12.31
本公司	MCU Holdings Ltd. (MCU)	投資控股公司	100 %	100 %
本公司	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Holtek BVI)	投資控股公司	100 %	100 %
本公司	Sigmos Holdings Ltd. (Sigmos)	投資控股公司	100 %	100 %
本公司	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Kingtek BVI)	投資控股公司	100 %	100 %
本公司	盛凌投資股份有限公司(盛凌投資)	專業投資公司	100 %	100 %
MCU	Best Health Electronics Corp. (Best Health)	製造及銷售與技術服務	80 % (註1)	80 % (註1)
Best Health	悠健電子(東莞)有限公司(悠健)	製造及銷售與技術服務	100 % (註2)	100 % (註2)
MCU	Anchip Technology Corporation (Anchip)	製造及銷售與技術服務	60 % (註3)	60 % (註3)
Anchip	安禧普電子科技(東莞)有限公司(安禧普)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
MCU	Best Power Electronics Corp. (Best Power)	製造及銷售與技術服務	100 % (註4)	- % (註4)
Holtek BVI	芯群集成電路(廈門)有限公司(芯群)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
Holtek BVI	合泰半導體(中國)有限公司(合泰)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
Sigmos	Holtek Semiconductor (USA) Inc. (Holtek USA))	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
Kingtek BVI	金科集成電路(蘇州)有限公司(金科)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
盛凌投資	Holtek Semiconductor (INDIA) Private Ltd. (Holtek INDIA)	製造及銷售與技術服務	100 % (註5)	- % (註5)
盛凌投資	優方科技股份有限公司(優方)	製造及銷售與技術服務	54.75 % (註6)	54.75 % (註6)
優方	Best Solution Electronics Inc. (Best Solution)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比	
			107.12.31	106.12.31
盛凌投資	倍創科技股份有限公司(倍創)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
盛凌投資	盛通科技股份有限公司(盛通)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
盛通	BestComm RF Electronics Inc. (BestComm)	製造及銷售與技術服務	100 %	100 %
BestComm	芯通電子科技(東莞)有限公司	製造及銷售與技術服務	100 % (註7)	- % (註7)

註1：合併公司於民國一〇六年第二季設立之100%子公司，並於民國一〇六年九月出售20%股權。

註2：合併公司於民國一〇六年第三季設立之100%子公司。

註3：合併公司於民國一〇六年九月增加取得該公司20%股權，故於民國一〇六年九月列入合併個體。

註4：合併公司於民國一〇七年第三季設立之100%子公司。

註5：合併公司於民國一〇七年第二季設立之100%子公司，係盛凌投資持有99.9%股權及盛群持有0.1%股權。

註6：係盛凌直接持有40%股權及透過關聯企業持有36.875%股權所計算之綜合持股比例。

註7：合併公司於民國一〇七年第一季設立之100%子公司。

2. 未列入合併財務報告之子公司：無。

(四) 外幣

1. 外幣交易

外幣交易依交易日之匯率換算為功能性貨幣。報導期間結束日(以下稱報導日)之外幣貨幣性項目依當日之匯率換算為功能性貨幣，其兌換損益係指期初以功能性貨幣計價之攤銷後成本，調整當期之有效利息及付款後之金額，與依外幣計價之攤銷後成本按報導日匯率換算金額間之差異。以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目依衡量公允價值當日之匯率重新換算為功能性貨幣，以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目則依交易日之匯率換算。

2. 國外營運機構

國外營運機構之資產及負債，係依報導日之匯率換算為新台幣；股東權益項目除期初保留盈餘以上期期末換算後之餘額結轉外，其餘依歷史匯率換算為新台幣；收益及費損項目係依當期平均匯率換算為新台幣，所產生之兌換差額均認列為其他綜合損益。

當處分國外營運機構致喪失控制、共同控制或重大影響時，與該國外營運機構相關之累計兌換差額係全數重分類為損益。部分處分含有國外營運機構之子公司時，相關累計兌換差額係按比例重新歸屬至非控制權益。部分處分含有國外營運機構之關聯企業之投資時，相關累計兌換差額則按比例重分類至損益。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(五)資產與負債區分流動與非流動之分類標準

符合下列條件之一之資產列為流動資產，非屬流動資產之所有其他資產則列為非流動資產：

- 1.預期於其正常營業週期中實現，或意圖將其出售或消耗；
- 2.主要為交易目的而持有該資產；
- 3.預期於報導期間後十二個月內實現該資產；或
- 4.該資產為現金或約當現金，但於報導期間後至少十二個月將該資產交換或用以清償負債受到其他限制者除外。

符合下列條件之一之負債列為流動負債，非屬流動負債之所有其他負債則列為非流動負債：

- 1.預期將於正常營業週期中清償該負債；
- 2.主要為交易目的而持有該負債；
- 3.預期將於報導期間後十二個月內到期清償該負債；或
- 4.未具無條件將清償期限遞延至報導期間後至少十二個月之權利之負債。

(六)現金及約當現金

現金包括庫存現金及活期存款。約當現金係指可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之短期並具高度流動性之投資。定期存款符合前述定義且持有目的係滿足短期現金承諾而非投資或其他目的者，列報於約當現金。

(七)金融工具(民國一〇七年一月一日(含)以後適用)

1.金融資產

合併公司之金融資產分類為：按攤銷後成本衡量之金融資產、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及透過損益按公允價值衡量之金融資產。

合併公司僅於改變管理金融資產之經營模式時，始依規定重分類所有受影響之金融資產。

(1)按攤銷後成本衡量之金融資產

金融資產同時符合下列條件，且未指定為透過損益按公允價值衡量時，係按攤銷後成本衡量：

- 係在以收取合約現金流量為目的之經營模式下持有該金融資產。
- 該金融資產之合約條款產生特定日期之現金流量，完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

原始認列時係按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量；後續採有效利率法以攤銷後成本衡量，該攤銷後成本已減除減損損失。利息收入、外幣兌換損益及減損損失係認列於損益。除列時，將利益或損失列入損益。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交易日會計處理。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(2)透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

合併公司於原始認列時，可作一不可撤銷之選擇，將非持有供交易之權益工具投資後續公允價值變動列報於其他綜合損益。前述選擇係按逐項工具基礎所作成。

原始認列時係按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量；後續按公允價值衡量，除權益工具投資之股利收入(除非明顯代表部分投資成本之回收)認列於損益外，其餘帳面金額之變動係認列為其他綜合損益，並累積於權益項下之透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益。於除列時，屬權益工具投資者，將權益項下之利益或損失累計金額重分類至保留盈餘，不重分類至損益。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交易日會計處理。

權益投資之股利收入於合併公司有權利收取股利之日認列(通常係除息日)。

(3)透過損益按公允價值衡量之金融資產

非屬上述按攤銷後成本衡量或透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，係透過損益按公允價值衡量。合併公司於原始認列時，為消除或重大減少會計配比不當，得不可撤銷地將符合按攤銷後成本衡量或透過其他綜合損益按公允價值衡量條件之金融資產，指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產。

原始認列時係按公允價值衡量，交易成本於發生時認列為損益；後續按公允價值衡量，再衡量產生之利益或損失(包含利息收入)認列為損益。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交易日會計處理。

(4)金融資產減損

合併公司針對按攤銷後成本衡量之金融資產(包括現金及約當現金、應收票據及應收帳款、存出保證金及其他金融資產等)之預期信用損失認列備抵損失。

下列金融資產係按十二個月預期信用損失金額衡量備抵損失，其餘係按存續期間預期信用損失金額衡量：

- 判定債務證券於報導日之信用風險低；及
- 其他債務證券及銀行存款之信用風險(即金融工具之預期存續期間發生違約之風險)自原始認列後未顯著增加。

應收帳款之備抵損失係按存續期間預期信用損失金額衡量。

存續期間預期信用損失係指金融工具預期存續期間所有可能違約事項產生之預期信用損失。

十二個月預期信用損失係指金融工具於報導日後十二個月內可能違約事項所產生之預期信用損失(或較短期間，若金融工具之預期存續期間短於十二個月時)。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

衡量預期信用損失之最長期間為合併公司暴露於信用風險之最長合約期間。

於判定自原始認列後信用風險是否已顯著增加時，合併公司考量合理且可佐證之資訊(無需過度成本或投入即可取得)，包括質性及量化資訊，及根據合併公司之歷史經驗、信用評估及前瞻性資訊所作之分析。

若金融工具之信用風險評等相當於全球所定義之「投資等級」(為標準普爾之投資等級BBB-、穆迪之投資等級Baa3或中華信評之投資等級twA，或高於該等級者)，合併公司視為該債務證券之信用風險低。

若合約款項逾期超過九十天，合併公司假設金融資產之信用風險已顯著增加。

若合約款項逾期超過一百八十天，或借款人不太可能履行其信用義務支付全額款項予合併公司時，合併公司視為該金融資產發生違約。

預期信用損失為金融工具預期存續期間信用損失之機率加權估計值。信用損失係按所有現金短收之現值衡量，亦即合併公司依據合約可收取之現金流量與合併公司預期收取之現金流量之差額。預期信用損失係按金融資產之有效利率折現。

按攤銷後成本衡量之金融資產之備抵損失係自資產之帳面金額中扣除，備抵損失之提列或迴轉金額係認列於損益中。

當合併公司對回收金融資產整體或部分無法合理預期時，係直接減少其金融資產總帳面金額。通常係指合併公司判定債務人之資產或收益來源不能產生足夠之現金流量以償還沖銷之金額，然而，已沖銷之金融資產仍可強制執行，以符合合併公司回收逾期金額之程序。

(5)金融資產之除列

合併公司僅於對來自該資產現金流量之合約權利終止，或已移轉金融資產且該資產所有權幾乎所有之風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

(八)金融工具(民國一〇七年一月一日以前適用)

1.金融資產

(1)透過損益按公允價值衡量之金融資產

此類金融資產係指持有供交易之金融資產，其取得或發生之主要目的為短期內出售或再買回。此類金融資產於原始認列時係按公允價值衡量，交易成本於發生時認列為損益；後續評價按公允價值衡量，再衡量產生之利益或損失認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交易日會計處理。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(2)應收款

應收款係無活絡市場公開報價，且具固定或可決定付款金額之金融資產，包括應收款項及其他應收款。原始認列時係按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量；續後評價採有效利率法以攤銷後成本減除減損損失衡量，惟短期應收款項之利息認列不具重大性之情況除外。

(3)以成本衡量之金融資產

無活絡市場公開報價且公允價值無法可靠衡量之權益投資，原始認列時係按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量；續後以成本減除減損損失後之金額衡量。

(4)金融資產減損

非透過損益按公允價值衡量之金融資產，於每個報導日評估減損。當有客觀證據顯示，因金融資產原始認列後發生之單一或多項事件，致使該資產之估計未來現金流量受損失者，該金融資產即已發生減損。

針對應收款個別評估未有減損後，另再以組合基礎評估減損。應收款組合之客觀減損證據可能包含合併公司過去收款經驗、該組合超過平均授信期間之延遲付款增加情況，以及與應收款拖欠有關之全國性或區域性經濟情勢變化。

所有金融資產之減損損失係直接自金融資產之帳面金額中扣除，惟應收款之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額，當判斷應收款無法收回時，則沖銷備抵帳戶，原先已沖銷而後續收回之款項則貸記備抵帳戶。備抵帳戶帳面金額之變動認列於損益。

當金融資產以攤銷後成本衡量時，若後續期間減損損失金額減少，且該減少客觀地連結至認列減損後發生之事項，則先前認列之減損損失予以迴轉認列於損益，惟該投資於減損迴轉日之帳面金額不得大於若未認列減損情況下應有之攤銷後成本。

(5)金融資產之除列

合併公司僅於對來自該資產現金流量之合約權利終止，或已移轉金融資產且該資產幾乎所有之風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

2.金融負債

(1)應付款

金融負債非屬持有供交易且未指定為透過損益按公允價值衡量者，包括應付帳款及其他應付款，原始認列時係按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量；續後評價採有效利率法以攤銷後成本衡量。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(2)金融負債之除列

合併公司係於合約義務已履行、取消或到期時，除列金融負債。

除列金融負債時，其帳面金額與所支付或應支付對價總額間之差額認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。

(3)金融資產及負債之互抵

金融資產及金融負債僅於合併公司有法定權利進行互抵及有意圖以淨額交割或同時變現資產及清償負債時，方予以互抵並以淨額表達於資產負債表。

(九)存貨

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。成本包括使其達可供使用之地點及狀態所發生之必要支出，並採加權平均法計算。淨變現價值係正常營業下之估計售價減除至完工尚需投入之成本及銷售費用為計算基礎。

(十)投資關聯企業

關聯企業係指合併公司對其財務及營運政策具有重大影響力但未達控制能力者。合併公司持有被投資公司百分之二十至百分之五十之表決權時，即假設具有重大影響力，並採權益法評價。

在權益法下，原始取得時係依成本認列，投資成本包含交易之成本。投資關聯企業之帳面金額包括原始投資時所辨認之商譽，減除任何累計減損損失。

合併財務報告包括自具有重大影響力之日起至喪失重大影響力之日止，於進行與合併公司會計政策一致性之調整後，合併公司依權益比例認列各該投資關聯企業之損益及其他綜合損益之金額。

合併公司與關聯企業間之交易所產生之未實現損益，已在合併公司對該被投資公司之權益範圍內予以消除。

當合併公司依比例應認列關聯企業之損失份額等於或超過其在關聯企業之權益時，即停止認列其損失，而僅於發生法定義務、推定義務或已代該被投資公司支付款項之範圍內，認列額外之損失及相關負債。

合併公司自其投資不再為關聯企業之日起停止採用權益法，並按公允價值衡量保留權益，保留權益之公允價值及處分價款與停止採用權益法當日之投資帳面金額之差額，認列於當期損益。

(十一)不動產、廠房及設備

1.認列與衡量

不動產、廠房及設備之認列及衡量係採成本模式，依成本減除累計折舊與累計減損後之金額衡量。成本包含可直接歸屬於取得資產之支出、任何其他使資產達預計用途之可使用狀態的直接可歸屬成本、拆卸與移除該項目及復原所在地點之成本。此外，為整合相關設備功能而購入之軟體亦資本化為該設備之一部分。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

當不動產、廠房及設備包含不同組成部分，且相對於該項目之總成本若屬重大而採用不同之折舊方法較為合宜時，則視為不動產、廠房及設備之單獨項目(主要組成部分)處理。

不動產、廠房及設備之處分損益，以淨額認列於營業外收入及支出項下。

2.後續成本

若不動產、廠房及設備項目後續支出所預期產生之未來經濟效益很有可能流入本公司，且其金額能可靠衡量，則該支出認列為該項目帳面金額之一部分，被重置部分之帳面金額則予以除列。不動產、廠房及設備之日常維修成本於發生時認列為損益。

3.折舊

折舊係依資產成本減除殘值後按估計耐用年限採直線法計提，並依資產之各別重大組成部分評估，若一組成部分之耐用年限不同於資產之其他部分，則此組成部分應單獨提列折舊。折舊之提列認列為損益。

當期及比較期間之估計耐用年限如下：

- (1)房屋及建築物：20~40年
- (2)機器設備：3~5年
- (3)其他設備：2~8年

每年至少於年度報導日檢視不動產、廠房及設備之折舊方法、耐用年限及殘值，若有變動，視為會計估計變動。

(十二)租賃

營業租賃之租金給付依直線法於租賃期間認列為費用。

(十三)無形資產

1.研究與發展

研究階段係指預期為獲取及瞭解嶄新的科學或技術知識而進行之活動，相關支出於發生時認列於損益。

發展階段之支出於同時符合下列所有條件時，認列為無形資產；未同時符合者，於發生時即認列於損益：

- (1)完成無形資產之技術可行性已達成，使該無形資產將可供使用或出售。
- (2)意圖完成該無形資產，並加以使用或出售。
- (3)有能力使用或出售該無形資產。
- (4)無形資產將很有可能產生未來經濟效益。
- (5)具充足之技術、財務及其他資源，以完成此項發展，並使用或出售該無形資產。
- (6)歸屬於該無形資產發展階段之支出能可靠衡量。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2.其他無形資產

合併公司取得其他無形資產係以成本減除累計攤銷與累計減損衡量之。

3.後續支出

後續支出僅於可增加相關特定資產的未來經濟效益時，方將其資本化。

4.攤銷

攤銷時係以資產成本減除殘值後金額為可攤銷金額，自達可供使用狀態起，按估計耐用年限採直線法攤銷，攤銷數認列於損益。

合併公司於每一年度報導日檢視無形資產之殘值、攤銷期間及攤銷方法，若有變動，視為會計估計變動。

(十四)非金融資產減損

針對存貨及遞延所得稅資產以外之非金融資產，合併公司於每一報導日評估是否發生減損，就有減損跡象之資產(個別資產或現金產生單位)估計其可回收金額，並就可回收金額低於帳面價值之資產，認列減損損失。於以前年度所認列除商譽以外之累計減損損失，嗣後若已不存在或減少，則迴轉增加帳面價值至可回收金額，惟不超過資產在未認列減損損失下，減除應提列折舊或攤銷之數。

(十五)客戶合約之收入(民國一〇七年一月一日(含)以後適用)

收入係按移轉商品或勞務而預期有權取得之對價衡量。合併公司係於對商品或勞務之控制移轉予客戶而滿足履約義務時認列收入。合併公司依主要收入項目說明如下：

1.銷售商品

合併公司研究、開發、生產、製造及銷售各種積體電路。合併公司係於對產品之控制移轉時認列收入。該產品之控制移轉係指產品已交付給客戶，客戶能完全裁決產品之銷售通路及價格，且已無會影響客戶接受該產品之未履行義務。交付係發生於產品運送至特定地點，其陳舊過時及損失風險已移轉予客戶，及客戶已依據銷售訂單接受產品，驗收條款已失效，或合併公司有客觀證據認為已滿足所有驗收條件時。

合併公司於交付商品時認列應收帳款，因合併公司在該時點具無條件收取對價之權利。

2.財務組成部分

合併公司預期所有客戶合約移轉商品或勞務予客戶之時間與客戶為該商品或勞務付款之時間間隔皆不超過一年，因此，合併公司不調整交易價格之貨幣時間價值。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十六)收入認列(民國一〇七年一月一日以前適用)

正常活動中銷售商品所產生之收入，係考量退回、商業折扣及數量折扣後，按已收或應收對價之公允價值衡量。收入係俟具說服力之證據存在、所有權之重大風險及報酬已移轉予買方、價款很有可能收回及相關成本與可能之商品退回能可靠估計、不持續參與商品之管理及收入金額能可靠衡量時加以認列。若折扣很有可能發生且金額能可靠衡量時，則於銷售認列時予以認列作為收入之減項。

風險及報酬移轉之時點係視銷售訂單個別條款而定。

(十七)員工福利

1.確定提撥計畫

確定提撥退休金計畫之提撥義務係於員工提供勞務期間內認列為損益項下之員工福利費用。

2.確定福利計畫

合併公司在確定福利退休金計畫下之淨義務係針對福利計畫以員工當期或過去服務所賺得之未來福利金額折算為現值計算。任何計畫資產之公允價值均予以減除。折現率係以到期日與合併公司淨義務期限接近，且計價幣別與預期支付福利金相同之政府公債之市場殖利率於財務報導日之利率為主。

企業淨義務每年由精算師以預計單位福利法精算。當計算結果對合併公司有利時，認列資產係以未來得以從該計畫退還之資金或減少未來對該計畫之提撥等方式所可獲得經濟效益現值之總額為限。計算經濟效益現值時應考量任何適用於合併公司任何計畫之最低資金提撥需求。一項效益若能在計畫期間內或計畫負債清償時實現，對合併公司而言，即具有經濟效益。

淨確定福利負債之再衡量數包含(1)精算損益；(2)計畫資產報酬，但不包括包含於淨確定福利負債淨利息之金額；及(3)資產上限影響數之任何變動，但不包括包含於淨確定福利負債淨利息之金額。淨確定福利負債再衡量數認列於其他綜合損益項目下。

3.短期員工福利

短期員工福利義務係以未折現之基礎衡量，且於提供相關服務時認列為費用。

有關短期現金紅利或分紅計畫下預期支付之金額，若係因員工過去提供服務而使合併公司負有現時之法定或推定支付義務，且該義務能可靠估計時，將該金額認列為負債。

(十八)所得稅

所得稅費用包括當期及遞延所得稅。除與企業合併、直接認列於權益或其他綜合損益之項目相關者外，當期所得稅及遞延所得稅應認列於損益。

當期所得稅包括當年度課稅所得(損失)按報導日之法定稅率或實質性立法稅率計算之預計應付所得稅或應收退稅款，及任何對以前年度應付所得稅的調整。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

遞延所得稅係就資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異予以衡量認列。

遞延所得稅係以預期資產實現或負債清償當期之稅率衡量，並以報導日之法定稅率或實質性立法稅率為基礎。

合併公司僅於同時符合下列條件時，始將遞延所得稅資產及遞延所得稅負債互抵：

- 1.有法定執行權將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵；且
- 2.遞延所得稅資產及遞延所得稅負債與下列由同一稅捐機關課徵所得稅之納稅主體之一有關；
 - (1)同一納稅主體；或
 - (2)不同納稅主體，惟各主體意圖在重大金額之遞延所得稅資產預期回收及遞延所得稅負債預期清償之每一未來期間，將當期所得稅負債及資產以淨額基礎清償，或同時實現資產及清償負債。

對於可遞轉後期之未使用所得稅抵減及可減除暫時性差異，在很有可能有未來課稅所得可供使用之範圍內，認列為遞延所得稅資產。並於每一報導日予以重評估，就相關所得稅利益非屬很有可能實現之範圍內予以調減。

(十九)每股盈餘

合併公司列示歸屬於本公司普通股權益持有人之基本及稀釋每股盈餘。基本每股盈餘係以歸屬於本公司普通股權益持有人之損益，除以當期加權平均流通在外普通股股數計算之。稀釋每股盈餘則係將歸屬於本公司普通股權益持有人之損益及加權平均流通在外普通股股數，分別調整所有潛在稀釋普通股之影響後計算之。本公司之潛在稀釋普通股包括本公司尚未經董事會決議且得採股票發放之員工酬勞。因盈餘或資本公積轉增資而新增之股份，採追溯調整計算。

(二十)部門資訊

營運部門係合併公司之組成部分，從事可能賺得收入並發生費用(包括與合併公司內其他組成部分間交易相關之收入及費用)之經營活動。所有營運部門之營運結果均定期由合併公司主要營運決策者複核，以制定分配資源予該部門之決策並評量其績效。各營運部門均具單獨之財務資訊。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層依編製準則及金管會認可之國際財務報導準則編製本合併財務報告時，必須作出判斷、估計及假設，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費用之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

管理階層持續檢視估計及基本假設，會計估計變動於變動期間及受影響之未來期間予以認列。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

對於假設及估計之不確定性中，存有重大風險將於未來次一年度造成重大調整之相關資訊，請詳下列附註：

存貨之評價

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低衡量，合併公司評估報導日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎，故可能因產業快速變遷而產生重大變動。存貨評價估列情形請詳附註六(六)。

合併公司之會計政策及揭露包含採用公允價值衡量其金融、非金融資產及負債。合併公司之財務部門負責進行公允價值驗證，藉獨立、可靠、且能代表可執行價格之資料使評價結果貼近市場狀態，並定期校準評價模型、進行回溯測試、更新評價模型所需輸入值及資料及其他任何必要之公允價值調整，以確保評價結果係屬合理。

合併公司在衡量其資產和負債時，盡可能使用市場可觀察之輸入值。公允價值之等級係以評價技術使用之輸入值為依據，歸類如下：

第一級：相同資產或負債於活絡市場之公開報價(未經調整)。

第二級：除包含於第一級之公開報價外，資產或負債之輸入參數係直接(即價格)或間接(即由價格推導而得)可觀察。

第三級：資產或負債之輸入參數非基於可觀察之市場資料(非可觀察參數)。

若發生公允價值各等級間之移轉事項或情況，合併公司係於報導日認列該移轉。衡量公允價值所採用假設之相關資訊請詳附註六(十八)金融工具。

六、重要會計項目之說明

(一)現金及約當現金

	107.12.31	106.12.31
現金及活期存款	\$ 355,036	295,513
定期存款	1,162,596	1,096,215
	<u>\$ 1,517,632</u>	<u>1,391,728</u>

(二)透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動

	107.12.31	106.12.31
受益憑證	<u>\$ 486,555</u>	<u>582,902</u>

民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日當權益價格上漲或下跌1%，而其他所有因素維持不變的情況下，民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日之稅後淨利將分別增加或減少3,892千元及4,838千元。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(三)透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資-非流動

	<u>107.12.31</u>
未上市(櫃)公司股票	
Unitech Capital Inc. (Unitech)	\$ 60,848
諧永投資股份有限公司(諧永投資)	161,110
金佶科技股份有限公司(金佶科技)	<u>43,203</u>
	<u>\$ 265,161</u>

合併公司持有該等權益工具投資為長期策略性投資且非為交易目的所持有，故已指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量。民國一〇六年十二月三十一日係列報於以成本衡量之金融資產—非流動。

合併公司於民國一〇七年出售部分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，處分價款2,972千元，處分時累計評價利益為1,355千元，已自其他權益轉至保留盈餘。

合併公司於民國一〇七年度收取之股利收入為7,715千元。

信用風險及市場風險資訊請詳附註六(十八)。

(四)以成本衡量之金融資產—非流動

	<u>106.12.31</u>
未上市(櫃)公司股票：	
Unitech Capital Inc. (Unitech)	\$ 86,750
諧永投資股份有限公司(諧永投資)	143,000
金佶科技股份有限公司(金佶科技)	<u>29,696</u>
	<u>\$ 259,446</u>

合併公司所持有之上述股票投資，於民國一〇六年十二月三十一日係按成本減除減損衡量，因其公允價值合理估計數之區間重大且無法合理評估各種估計數之機率，致合併公司管理階層認為其公允價值無法可靠衡量。於民國一〇七年十二月三十一日該等資產係分類為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動。

信用風險及市場風險資訊請詳附註六(十八)。

(五)應收票據及帳款淨額(含關係人)

	<u>107.12.31</u>	<u>106.12.31</u>
應收票據	\$ 278	827
應收帳款	107,785	121,730
應收關係人款	<u>749,789</u>	<u>755,407</u>
	857,852	877,964
減：備抵損失	<u>(10,459)</u>	<u>(7,393)</u>
	<u>\$ 847,393</u>	<u>870,571</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司民國一〇七年十二月三十一日針對所有應收款項採用簡化作法估計預期信用損失，亦即使用存續期間預期信用損失衡量，為此衡量目的，該等應收款項係按代表客戶依據合約條款支付所有到期金額能力之共同信用風險特性予以分組，並已納入前瞻性之資訊。合併公司民國一〇七年十二月三十一日應收款項之預期信用損失分析如下：

	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 840,254	0.5%~1.5%	7,232
逾期90天以下	3,215	5%	161
合計	<u>\$ 843,469</u>		<u>7,393</u>

個別客戶應收帳款14,383千元，經評估有違約風險，故針對該客戶提列3,066千元預期信用損失。

民國一〇六年十二月三十一日係採用已發生信用損失模式考量應收票據及應收帳款(含關係人)之備抵呆帳。合併公司民國一〇六年十二月三十一日無已逾期但未減損之應收票據及應收帳款(含關係人)。

合併公司民國一〇七年度及一〇六年度之應收票據及帳款之備抵損失變動表如下：

	107年度	106年度 群組評估 之減損損失
期初餘額(依IAS39)	\$ 7,393	<u>7,393</u>
初次適用IFRS 9之調整	-	
期初餘額(依IFRS 9)	7,393	
認列之減損損失	3,066	
期末餘額	<u>\$ 10,459</u>	

註：民國一〇六年度期末餘額與期初餘額相同。

(六)存貨

	107.12.31	106.12.31
原料及物料	\$ 179,234	116,727
在製品	285,285	244,516
製成品及商品	190,347	233,346
	<u>\$ 654,866</u>	<u>594,589</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

營業成本組成明細如下：

	107年度	106年度
銷貨成本	\$ 2,448,406	2,421,179
報廢成本	7,427	4,278
	<u>\$ 2,455,833</u>	<u>2,425,457</u>

(七)其他金融資產－流動

	107.12.31	106.12.31
定期存款(三個月以上)	\$ 760,610	703,579
受限制銀行存款	3,712	3,820
其他	19,853	4,233
	<u>\$ 784,175</u>	<u>711,632</u>

合併公司於民國一〇七年度及一〇六年度，針對其他金融資產並無提列減損損失情形。

其餘信用風險資訊請詳附註六(十八)。

(八)採用權益法之投資

合併公司於報導日採用權益法之投資列示如下：

	107.12.31	106.12.31
關聯企業其權益之彙總金額	\$ 550,555	508,045
減：聯屬公司間未實現交易利得	(101,540)	(88,916)
	<u>\$ 449,015</u>	<u>419,129</u>

合併公司採用權益法之關聯企業屬個別不重大者，其彙總財務資訊如下，該等財務資訊係於合併公司之合併財務報告中所包含之金額：

	107年度	106年度
本期綜合損益總額歸屬於合併公司之份額：		
繼續營業單位本期淨利	\$ 97,105	81,967
其他綜合損益	(521)	456
綜合損益總額	<u>\$ 96,584</u>	<u>82,423</u>

合併公司於民國一〇六年第一季採用權益法之關聯企業屬個別不重大者，因喪失影響力，故轉列至以成本衡量之金融資產，並認列處分利益。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(九)不動產、廠房及設備

合併公司不動產、廠房及設備之成本及累計折舊變動明細如下：

	土 地	房 屋 及 建 築	機器設備	其他設備	總 計
成本：					
民國107年1月1日餘額	\$ 26,676	517,847	355,953	84,913	985,389
增添	-	3,319	39,941	4,632	47,892
處分	-	-	(10,811)	(1,374)	(12,185)
匯率變動之影響	-	(5,194)	(2,466)	(956)	(8,616)
民國107年12月31日餘額	<u>\$ 26,676</u>	<u>515,972</u>	<u>382,617</u>	<u>87,215</u>	<u>1,012,480</u>
民國106年1月1日餘額	\$ 26,676	519,709	348,181	95,431	989,997
增添	-	1,311	24,540	8,450	34,301
處分	-	-	(15,600)	(18,349)	(33,949)
匯率變動之影響	-	(3,173)	(1,168)	(619)	(4,960)
民國106年12月31日餘額	<u>\$ 26,676</u>	<u>517,847</u>	<u>355,953</u>	<u>84,913</u>	<u>985,389</u>
累計折舊：					
民國107年1月1日餘額	\$ -	221,227	293,422	56,011	570,660
本期折舊	-	22,669	24,115	10,814	57,598
處分	-	-	(9,658)	(1,157)	(10,815)
匯率變動之影響	-	(1,230)	(1,572)	(676)	(3,478)
民國107年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>242,666</u>	<u>306,307</u>	<u>64,992</u>	<u>613,965</u>
民國106年1月1日餘額	\$ -	199,772	285,254	62,401	547,427
本期折舊	-	21,891	22,937	12,191	57,019
處分	-	-	(13,896)	(18,274)	(32,170)
匯率變動之影響	-	(436)	(873)	(307)	(1,616)
民國106年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>221,227</u>	<u>293,422</u>	<u>56,011</u>	<u>570,660</u>
帳面價值：					
民國107年12月31日	<u>\$ 26,676</u>	<u>273,306</u>	<u>76,310</u>	<u>22,223</u>	<u>398,515</u>
民國106年12月31日	<u>\$ 26,676</u>	<u>296,620</u>	<u>62,531</u>	<u>28,902</u>	<u>414,729</u>
民國106年1月1日	<u>\$ 26,676</u>	<u>319,937</u>	<u>62,927</u>	<u>33,030</u>	<u>442,570</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十)營業租賃

- 1.合併公司依已簽訂之辦公室、停車位及員工宿舍租賃合約，預估未來最低租金給付額彙列如下：

	<u>107.12.31</u>	<u>106.12.31</u>
一年內	\$ 22,581	10,894
一年至二年	18,640	3,989
二年以上	<u>8,649</u>	<u>6,967</u>
	<u>\$ 49,870</u>	<u>21,850</u>

- 2.本公司廠房之土地係向科學工業園區管理局承租，租賃期間自民國九十年三月十五日起至民國一〇九年十二月三十一日止，且租賃期間屆滿時得另訂新約。自民國一〇七年二月起租金每年約為3,558千元，如遇政府調整地價時，租金亦隨同調整。

(十一)員工福利

1.確定福利計畫

合併公司確定福利義務現值與計畫資產公允價值之調節如下：

	<u>107.12.31</u>	<u>106.12.31</u>
確定福利義務現值	\$ 127,611	123,354
計畫資產之公允價值	<u>(51,009)</u>	<u>(50,416)</u>
淨確定福利負債	<u>\$ 76,602</u>	<u>72,938</u>

合併公司之確定福利計畫係提撥至台灣銀行之勞工退休準備金專戶。適用勞動基準法之每位員工之退休支付，係依據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算。

(1)計畫資產組成

合併公司依勞動基準法提撥之退休基金係由勞動部勞動基金運用局(以下簡稱勞動基金局)統籌管理，依「勞工退休基金收支保管及運用辦法」規定，基金之運用，其每年決算分配之最低收益，不得低於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益。

截至報導日，合併公司之台灣銀行勞工退休準備金專戶餘額計51,009千元。勞工退休基金資產運用之資料包括基金收益率以及基金資產配置，請詳勞動基金局網站公布之資訊。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(2)確定福利義務現值之變動

合併公司民國一〇七年度及一〇六年度確定福利義務現值變動如下：

	107年度	106年度
1月1日確定福利義務	\$ 123,354	118,013
計畫支付之福利	(4,234)	(1,310)
當期服務成本及利息	1,480	1,770
淨確定福利負債再衡量數		
— 因財務假設變動所產生之精算損(益)	3,225	4,941
— 因經驗變動所產生之精算(益)損	3,786	(60)
12月31日確定福利義務	<u>\$ 127,611</u>	<u>123,354</u>

(3)計畫資產公允價值之變動

合併公司民國一〇七年度及一〇六年度確定福利計畫資產公允價值之變動如下：

	107年度	106年度
1月1日計畫資產之公允價值	\$ 50,416	48,439
計畫支付之福利	(4,234)	(1,310)
利息收入	622	748
已提撥至計畫之金額	2,812	2,806
淨確定福利負債之再衡量數		
— 計畫資產報酬(不含當期利息)	1,393	(267)
12月31日計畫資產之公允價值	<u>\$ 51,009</u>	<u>50,416</u>

(4)認列為損益之費用

合併公司民國一〇七年度及一〇六年度認列為損益之費用如下：

	107年度	106年度
淨確定福利負債之淨利息	<u>\$ 858</u>	<u>1,022</u>
營業成本	\$ 57	70
推銷費用	65	79
管理費用	152	185
研究發展費用	584	688
	<u>\$ 858</u>	<u>1,022</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(5)認列為其他綜合損益之淨確定福利負債之再衡量數

合併公司民國一〇七年度及一〇六年度累計認列於其他綜合損益之淨確定福利負債之再衡量數如下：

	107年度	106年度
1月1日累積餘額	\$ 15,885	10,737
本期認列	5,618	5,148
12月31日累積餘額	<u>\$ 21,503</u>	<u>15,885</u>

(6)精算假設

合併公司於年度財務報導期間結束日用以決定確定福利義務現值之重大精算假設如下：

	107.12.31	106.12.31
折現率	1.00 %	1.20 %
未來薪資成長率	2.00 %	2.00 %

合併公司預計於民國一〇七年度報導日後之一年內支付予確定福利計畫之提撥金額為2,880千元。

確定福利計畫之加權平均存續期間為12.6年。

(7)敏感度分析

民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日，當採用之主要精算假設變動對確定福利義務現值之影響如下：

精算假設	淨確定福利負債	
	增加1%	減少1%
107年12月31日		
折現率	\$ <u>(15,127)</u>	<u>17,814</u>
未來薪資成長率	\$ <u>16,056</u>	<u>(14,039)</u>
106年12月31日		
折現率	\$ <u>(15,542)</u>	<u>18,433</u>
未來薪資成長率	\$ <u>16,710</u>	<u>(14,503)</u>

上述之敏感度分析係基於其他假設不變的情況下分析單一假設變動之影響。實務上許多假設的變動則可能是連動的。敏感度分析係與計算資產負債表之淨確定福利負債所採用的方法一致。

本期編製敏感度分析所使用之方法與假設與前期相同。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2.確定提撥計畫

合併公司之確定提撥計畫係依勞工退休金條例之規定，依勞工每月工資6%之提繳率，提撥至勞動部勞工保險局(以下簡稱勞工保險局)之勞工退休金個人專戶。在此計畫下合併公司提撥固定金額至勞工保險局後，即無支付額外金額之法定或推定義務。合併公司民國一〇七年度及一〇六年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為21,702千元及20,523千元，已提撥至勞工保險局。

除上，民國一〇七年度及一〇六年度國外分公司及合併子公司依當地相關法令認列之退休金費用分別為22,704千元及19,089千元。

(十二)所得稅

1.所得稅費用

總統府於民國一〇七年二月七日頒布所得稅法修正案將營利事業所得稅率自民國一〇七年度起由現行17%調高至20%。

合併公司民國一〇七年度及一〇六年度之所得稅費用明細如下：

	107年度	106年度
當期所得稅費用		
當期產生	\$ 142,444	119,475
調整前期之當期所得稅	<u>(3,754)</u>	<u>509</u>
	<u>138,690</u>	<u>119,984</u>
遞延所得稅費用		
暫時性差異之發生及迴轉	24,376	13,819
所得稅稅率變動影響數	<u>12,157</u>	<u>-</u>
	<u>36,533</u>	<u>13,819</u>
	<u>\$ 175,223</u>	<u>133,803</u>

合併公司民國一〇七年度及一〇六年度認列於其他綜合損益項下之所得稅費用(利益)明細如下：

	107年度	106年度
不重分類至損益之項目：		
確定福利計畫之再衡量數	<u>\$ (1,124)</u>	<u>(875)</u>
後續可能重分類至損益之項目：		
國外營運機構財務報告換算之兌換差額	\$ (3,870)	(1,602)
採用權益法認列關聯企業之國外營運機構財務報表換算之兌換差額	<u>\$ (120)</u>	<u>77</u>
	<u>\$ (3,990)</u>	<u>(1,525)</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司所得稅費用與稅前淨利之關係調節如下：

	107年度	106年度
稅前淨利	\$ 1,245,589	1,069,790
依本公司所在地國內稅率計算之所得稅	249,118	181,864
外國轄區稅率差異影響數	1,976	2,687
永久性差異調整	(8,244)	(11,358)
免稅所得	(77,572)	(55,078)
投資抵減預期新增數	(2,498)	-
所得基本稅額	-	8,619
稅率變動影響數	12,157	-
其他	286	7,069
	<u>\$ 175,223</u>	<u>133,803</u>

2.遞延所得稅資產及負債變動明細表

遞延所得稅資產

	106.1.1	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	106.12.31	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	107.12.31
存貨跌價損失	\$ 10,200	-	-	10,200	(1,800)	-	12,000
未實現聯屬公司間利益	16,976	(6,525)	-	23,501	(10,920)	-	34,421
淨確定福利負債	11,827	303	(875)	12,399	(1,797)	(1,124)	15,320
國外營運機構財務報表 換算之兌換損失	1,878	-	(1,525)	3,403	-	(3,990)	7,393
其他	199	199	-	-	(572)	-	572
	<u>\$ 41,080</u>	<u>(6,023)</u>	<u>(2,400)</u>	<u>49,503</u>	<u>(15,089)</u>	<u>(5,114)</u>	<u>69,706</u>

遞延所得稅負債

	106.1.1	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	106.12.31	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	107.12.31
採權益法認列之國外投 資利益	\$ (94,217)	19,719	-	(113,936)	51,556	-	(165,492)
其他	(929)	123	-	(1,052)	66	-	(1,118)
	<u>\$ (95,146)</u>	<u>19,842</u>	<u>-</u>	<u>(114,988)</u>	<u>51,622</u>	<u>-</u>	<u>(166,610)</u>

3.本公司營利事業所得稅結算申報已奉稅捐稽徵機關核定至民國一〇四年度。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十三)資本及其他權益

1.股本

民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日本公司額定股本均為3,000,000千元(均含保留供發行員工認股權憑證200,000千元及可轉換公司債500,000千元之額度),實收股本均為2,261,682千元,每股面額10元。

2.資本公積

本公司資本公積餘額如下：

	107.12.31	106.12.31
普通股股本溢價	\$ <u>142,309</u>	<u>142,309</u>

依公司法規定,資本公積需優先填補虧損後,始得以已實現資本公積之全部或一部轉作資本或發放現金。前項所稱之已實現資本公積,包括超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得。依發行人募集與發行有價證券處理準則規定,得撥充資本之資本公積,每年撥充之合計金額,不得超過實收資本額百分之十。

3.保留盈餘

依本公司章程規定,公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補虧損,次提百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限;另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘,由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案,提請股東會決議分派不低於稅後淨利之百分之五十。

上述股東股利部份,其中現金股利不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股利合計數之百分之五十。

(1)法定盈餘公積

依公司法規定,公司應就稅後純益提撥百分之十為法定盈餘公積,直至與資本總額相等為止。公司無虧損時,得經股東會決議,以法定盈餘公積發給新股或現金,惟以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(2)特別盈餘公積

本公司於首次採用金管會認可之國際財務報導準則時，因選擇適用國際財務報導準則第一號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目，調整帳列股東權益項下之累積換算調整數而增加保留盈餘之金額為18,008千元；另就轉換日之精算損益調整減列保留盈餘13,410千元。依金管會民國一〇一年四月六日金管證發字第1010012865號令規定，應就因轉換採用金管會認可之國際財務報導準則產生之保留盈餘淨增加數4,598千元提列特別盈餘公積，並於使用、處分或重分類相關資產時，得就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉分派盈餘。本公司轉投資之海外子公司盛揚半導體(深圳)有限公司已於民國一〇三年八月完成清算各項權利義務及註銷登記，本公司依據前述函令規定，就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉特別盈餘公積併入保留盈餘計1,956千元。截至民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日止，該項特別盈餘公積餘額均為2,642千元。

又依上段所述函令規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額與上段所提列特別盈餘公積餘額之差額，自當期損益與前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

(3)盈餘分派

本公司民國一〇六年度及一〇五年度盈餘分派案，分別於民國一〇七年五月二十八日及一〇六年五月二十六日經股東常會決議，分派予業主之股利如下：

	106年度		105年度	
	每股股利 (元)	金 額	每股股利 (元)	金 額
分派予普通股業主之現金股利	\$ <u>4.10</u>	<u>927,290</u>	<u>3.50</u>	<u>791,589</u>

(十四)每股盈餘

本公司每股盈餘之計算列示如下：

	107年度	106年度
基本每股盈餘：		
歸屬於本公司股東之本期淨利	\$ <u>1,063,990</u>	<u>926,188</u>
計算每股盈餘之加權平均流通在外股數(千股)	<u>226,168</u>	<u>226,168</u>
基本每股盈餘(元)	\$ <u>4.70</u>	<u>4.10</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	107年度	106年度
稀釋每股盈餘：		
歸屬於本公司股東之本期淨利	\$ <u>1,063,990</u>	<u>926,188</u>
加權平均流通在外股數(千股)	226,168	226,168
具稀釋作用潛在普通股之影響(千股)		
員工酬勞	<u>2,335</u>	<u>1,746</u>
計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數(千股)	<u>228,503</u>	<u>227,914</u>
稀釋每股盈餘(元)	\$ <u>4.66</u>	<u>4.06</u>

(十五)員工及董事酬勞

依本公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一・五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

本公司民國一〇七年度及一〇六年度員工酬勞估列金額分別為129,225千元及111,567千元，董事酬勞估列金額分別為14,248千元及12,286千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之金額乘上本公司章程所訂之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為民國一〇七年度及一〇六年度之營業成本或營業費用。若次年度實際分派金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，將該變動之差異認列為次年度損益。如董事會決議採股票發放員工酬勞，股票酬勞之股數計算基礎係依據董事會決議日前一日的收盤價。

本公司民國一〇六年度及一〇五年度員工酬勞提列金額分別為111,567千元及94,738千元，董事酬勞提列金額分別為12,286千元及10,526千元，皆係以現金發放，其中民國一〇六年度以董事酬勞科目發放12,176千元，差異係估列計算之差異；民國一〇五年度以董事酬勞科目發放金額為10,416千元，差異係帳列科目調整，相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。

(十六)客戶合約之收入

1.收入之細分

收入之細分請詳附註十四。

2.合約餘額

應收帳款及其減損之揭露請詳附註六(五)。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(十七)營業外收入及支出

綜合損益表所列之其他利益及損失明細如下：

	107年度	106年度
處分採用權益法之投資利益	-	17,215
外幣兌換(損失)利益	\$ (7,530)	338
其他	23,001	16,403
	<u>\$ 15,471</u>	<u>33,956</u>

(十八)金融工具

1.信用風險

(1)信用風險之暴險

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日之最大信用暴險金額分別為3,912,124千元及3,564,805千元。

合併公司之潛在信用風險係源自金融資產交易對方或他方未履行合約之潛在影響，主要來自於合併公司之現金及約當現金、約定期間三個月以上之定期存款及應收客戶之帳款。

合併公司之現金及約當現金及定期存款存放於信用良好之銀行，發生信用風險可能性低。

合併公司主要銷售對象為國內外信譽良好之公司，除依授信作業程序給予客戶信用額度外，並持續了解客戶之信用狀況，民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日佔合併公司應收票據及帳款(含關係人)10%以上客戶之帳款金額分別為404,381千元及447,529千元，使合併公司有應收帳款信用風險集中之情形，惟已定期評估應收帳款之回收可能性並提列適當備抵損失，管理當局預期未來不致有重大損失。

(2)應收款項及債務證券之信用風險

應收票據及帳款之信用曝險資訊請詳附註六(五)。

其他按攤銷後成本衡量之金融資產包括三個月以上定期存款及受限制銀行存款等，相關明細及減損提列情形請詳附註六(七)。

上開均為信用風險低之金融資產，因此按十二個月預期信用損失金額衡量該期間之備抵損失(合併公司如何判定信用風險低之說明請詳附註四(七))。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2.流動性風險

除應付薪資及其他流動負債項下之應付費用外，其餘之金融負債之合約到期日分析：

	帳面金額	合 約 現金流量	1年以內	超過1年
107年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 614,409	614,409	614,409	-
存入保證金	8,706	8,706	-	8,706
	<u>\$ 623,115</u>	<u>623,115</u>	<u>614,409</u>	<u>8,706</u>
106年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 600,932	600,932	600,932	-
存入保證金	8,710	8,710	-	8,710
	<u>\$ 609,642</u>	<u>609,642</u>	<u>600,932</u>	<u>8,710</u>

合併公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

3.市場風險

匯率風險

(1)匯率風險之暴險

合併公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	107.12.31			106.12.31		
	外幣	匯率	台幣	外幣	匯率	台幣
<u>金融資產</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美 金	\$ 18,380	30.665	563,619	9,269	29.71	275,385
人民幣	98,174	4.4459	436,473	112,470	4.5394	510,544
<u>非貨幣性項目</u>						
美 金	\$ 11,977	30.665	367,289	11,372	29.71	337,870
<u>金融負債</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美 金	\$ 9,311	30.665	285,533	8,081	29.71	240,082
人民幣	13,886	4.4459	61,737	14,933	4.5394	67,786

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(2) 敏感性分析

合併公司之匯率風險主要來自於以外幣計價之現金、應收帳款、其他應收款及應付帳款等，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日當新台幣相對於美金及人民幣貶值或升值1%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一〇七年度及一〇六年度之稅後淨利將分別增加或減少5,223千元及3,968千元。

(3) 貨幣性項目之兌換損益

由於合併公司使用貨幣種類繁多，故採彙整方式揭露貨幣性項目之兌換損益資訊，民國一〇七年度及一〇六年度外幣兌換(損失)利益淨額(含已實現及未實現)分別為(7,530)千元及338千元。

4. 公允價值資訊

(1) 金融工具之種類及公允價值

合併公司透過損益按公允價值衡量之金融資產及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產係以重複性為基礎按公允價值衡量。各種類金融資產及金融負債之帳面金額及公允價值(包括公允價值等級資訊，但非按公允價值衡量金融工具之帳面金額為公允價值之合理近似值者，及於活絡市場無報價且公允價值無法可靠衡量之權益工具投資，依規定無須揭露公允價值資訊)列示如下：

107.12.31					
	帳面價值	公 允 價 值			合 計
		第一級	第二級	第三級	
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	\$ 486,555	486,555	-	-	486,555
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	265,161	-	-	265,161	265,161
按攤銷後成本衡量之金融資產					
現金及約當現金	1,517,632	-	-	-	-
應收票據及帳款淨額(含關係人)	847,393	-	-	-	-
其他金融資產—流動	784,175	-	-	-	-
存出保證金(帳列其他非流動資產)	11,208	-	-	-	-
	<u>\$ 3,912,124</u>	<u>486,555</u>	<u>-</u>	<u>265,161</u>	<u>751,716</u>
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付票據及帳款淨額	\$ 614,409	-	-	-	-
存入保證金	8,706	-	-	-	-
	<u>\$ 623,115</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

	106.12.31				
	帳面價值	公 允 價 值			合 計
		第一級	第二級	第三級	
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	\$ 582,902	582,902	-	-	582,902
以成本衡量之金融資產—非流動	259,446	-	-	-	-
放款及應收款					
現金及約當現金	1,391,728	-	-	-	-
應收票據及帳款淨額(含關係人)	870,571	-	-	-	-
其他金融資產—流動	711,632	-	-	-	-
存出保證金(帳列其他非流動資產)	7,972	-	-	-	-
	<u>\$ 3,824,251</u>	<u>582,902</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>582,902</u>
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付票據及帳款淨額	\$ 600,932	-	-	-	-
存入保證金	8,710	-	-	-	-
	<u>\$ 609,642</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(2)按公允價值衡量金融工具之公允價值評價技術

A.合併公司持有之受益憑證係具有標準條款與條件並於活絡市場交易之金融資產，其公允價值係參照市場報價決定。

B.合併公司持有之金融工具屬無活絡市場者，其公允價值依類別及屬性列示如下：

無公開報價之權益工具：屬投資公司者，係使用淨資產價值法估算公允價值，資產法係經由評估評價標的涵蓋之個別資產及個別負債之總價值，以反映企業整體價值。

無公開報價之權益工具：其他投資標的，則係使用市場可比公司法估算公允價值，按同業之股價淨值比評估。

(3)民國一〇七年度及一〇六年度間並無任何公允價值等級移轉情形。

(4)重大不可觀察輸入值(第三等級)之公允價值衡量之量化資訊

合併公司公允價值衡量歸類為第三等級為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—權益證券投資。

合併公司歸類為第三等級之無活絡市場權益工具投資具有複數重大不可觀察輸入值。無活絡市場之權益工具投資之重大不可觀察輸入值因彼此獨立，故不存在相互關聯性。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

重大不可觀察輸入值之量化資訊列表如下：

項目	評價技術	重大不可觀察輸入值	重大不可觀察輸入值與公允價值關係
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-無活絡市場之權益工具投資	市場法(可類比上市櫃公司同業股價淨值比)	- 股價淨值比乘數(107.12.31為2.00) - 缺乏市場流通性折價(107.12.31為20%)	- 股價淨值比乘數愈高，公允價值愈高 - 缺乏市場流通性折價愈高，公允價值愈低
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-無活絡市場之權益工具投資	淨資產價值法	- 淨資產價值 - 缺乏市場流通性折價(107.12.31為10%)	- 不適用 - 缺乏市場流通性折價愈高，公允價值愈低

(5)第三等級間之變動明細

	透過其他綜合損益按公允價值衡量-無公開報價之權益工具
107年1月1日餘額	\$ -
追溯適用新準則之調整數	326,736
總利益	
認列於其他綜合損益	(58,603)
處分	(2,972)
107年12月31日餘額	<u>\$ 265,161</u>

上述總利益，係列報於「透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益」。

(十九)財務風險管理

1.概要

合併公司因金融工具之使用而暴露於下列風險：

- (1)信用風險
- (2)流動性風險
- (3)市場風險

本附註表達合併公司上述各項風險之暴險資訊、合併公司衡量及管理風險之目標、政策及程序。進一步量化揭露請詳附註六(十八)。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2.風險管理架構

董事會全權負責發展及控管合併公司之風險管理政策。

合併公司之風險管理政策之建置係為辨認及分析合併公司所面臨之風險，及設定適當風險限額及控制，並監督風險及風險限額之遵循。風險管理政策及系統係定期覆核以反映市場情況及合併公司運作之變化。合併公司透過訓練、管理準則及作業程序，以發展有紀律且具建設性之控制環境，使所有員工了解其角色及義務。

本公司之董事會監督管理階層如何監控合併公司風險管理政策及程序之遵循，及覆核合併公司對於所面臨風險之相關風險管理架構之適當性。內部稽核人員協助董事會扮演監督角色。該等人員進行定期及例外覆核風險管理控制及程序，並將覆核結果報告予董事會。

3.信用風險

信用風險係合併公司因客戶或金融工具之交易對手無法履行合約義務而產生財務損失之風險，主要來自於合併公司現金及約當現金及應收客戶之帳款。

有關現金及約當現金、應收款項之信用風險分析，請詳附註六(十八)。另，截至民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日止，合併公司均無提供任何背書保證。

4.流動性風險

流動性風險係合併公司無法交付現金或其他金融資產以清償金融負債，未能履行相關義務之風險。合併公司管理流動性之方法係盡可能確保合併公司在一般及具壓力之情況下，皆有足夠之流動資金以支應到期之負債，而不致發生不可接受之損失或使合併公司之聲譽遭受到損害之風險。

流動性風險係由本公司之財務部門所監控，持續監督合併公司實際現金流量部位，並使用多方面的資訊，預測並監控合併公司在長期與短期之現金流動部位，財務部門並投資額外之現金於適當到期日之存款或短期性投資，並確保合併公司之流動性，足以因應即將到期之負債。截至民國一〇七年十二月三十一日止，合併公司之營運資金及目前尚有銀行未動支之借款額度153,575千元，應足以支應履行所有合約義務，故未有無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

5.市場風險

市場風險係指因市價變動，如匯率、利率、權益工具價格變動，而影響合併公司之收益或所持有金融工具價值之風險。市場風險管理之目標係管控市場風險之暴險程度在可承受範圍內，並將投資報酬最佳化。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

合併公司為管理市場匯率及受益憑證價格變動風險，所有重大交易之執行均經董事會之覆核與核准，相關財務操作亦受內部稽核部門之監督。相關之管理說明如下：

(1)合併公司暴露於非以功能性貨幣計價之銷售及採購交易所產生之匯率風險。該等交易主要之計價貨幣有美元及人民幣。

有關外幣計價之貨幣性資產及負債，當發生短期不平衡時，合併公司係藉由以即時匯率買進或賣出外幣，以確保淨暴險保持在可接受之水準。

(2)投資組合中重大投資均採個別管理，且所有買賣決策均經董事會之核准。

(二十)資本管理

董事會管理資本之目標係確保合併公司於繼續經營與成長之前提下，藉由將債務及權益餘額最適化，以提供股東足夠之報酬。

董事會之資本結構管理策略，係依據合併公司所營事業之產業規模、產業未來之成本與產品發展藍圖，以設定合併公司適當之市場佔有率，並據以規劃所需之營運資金與現金，以對合併公司長期發展所需之各項資產規模，做出整體性之規劃；最後根據合併公司產品競爭力推估可能之產品邊際貢獻、營業利益率與現金流量，並考量產業景氣循環波動、產品生命週期等風險因素，以決定合併公司適當之資本結構。

董事會定期審核資本結構，並考量不同資本結構可能涉及之成本與風險。

截至民國一〇七年十二月三十一日止，合併公司資本管理之方式並未改變。

合併公司於報導日之負債權益比率如下：

	107.12.31	106.12.31
負債總額	\$ <u>1,331,401</u>	<u>1,265,424</u>
權益總額	\$ <u>4,224,099</u>	<u>4,098,846</u>
負債權益比率	<u>31.52%</u>	<u>30.87%</u>

七、關係人交易

(一)關係人名稱及關係

於本合併財務報告之涵蓋期間內與合併公司有交易之關係人如下：

關係人名稱	與合併公司之關係
CROWN RICH	合併公司之關聯企業
FINE CHIP	合併公司之關聯企業
FORIC	合併公司之關聯企業
JXY	合併公司之關聯企業
NEW WAVE	合併公司之關聯企業
NEWTEK	合併公司之關聯企業

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

關係人名稱	與合併公司之關係
QUANDING	合併公司之關聯企業
SANTEK	合併公司之關聯企業
TRUETEK	合併公司之關聯企業
BESTWAY	合併公司之關聯企業
欣宏	合併公司之關聯企業
金濤高科	合併公司之關聯企業
宏達	合併公司之關聯企業
高聖	合併公司之關聯企業
鈺威	合併公司之關聯企業

(二)與關係人間之重大交易事項

1.銷售

合併公司對關係人之重大銷售金額如下：

	107年度	106年度
欣宏	\$ 635,592	571,681
CROWN RICH	544,069	465,727
其他	2,409,950	2,328,419
	<u>\$ 3,589,611</u>	<u>3,365,827</u>

合併公司之銷售價格依銷售之產品規格而定，並視銷售之數量給予不定幅度之折扣；銷售予關係人之收款條件約為月結60天至90天。合併公司與一般客戶之銷售交易收款條件則視個別客戶之交易往來經驗及債信評估結果決定採預收貨款、即期電匯或月結30天至60天不等。

民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日止合併公司與採權益法評價之被投資公司間因銷貨交易所產生之未實現銷貨毛利分別為101,540千元及88,916千元，帳列採用權益法之投資項下。

合併公司因上述銷貨交易產生之應收關係人款項明細如下：

	107.12.31	106.12.31
欣宏	\$ 123,653	121,816
CROWN RICH	107,074	110,054
NEW WAVE	86,922	114,810
TRUETEK	86,732	59,223
其他	345,408	349,504
	<u>\$ 749,789</u>	<u>755,407</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2.進貨

合併公司向關係人進貨金額如下：

	107年度	106年度
關聯企業	\$ <u>-</u>	<u>584</u>

合併公司與關係人間之進貨交易條件與一般供應商尚無明顯不同。

合併公司委託關係人提供積體電路銷售服務之金額如下：

	107年度	106年度
關聯企業	\$ <u>13</u>	<u>491</u>

(三)主要管理人員交易

主要管理人員報酬如下：

	107年度	106年度
短期員工福利	\$ 34,429	28,622
退職後福利	432	432
	\$ <u>34,861</u>	<u>29,054</u>

八、質押之資產

資產名稱	質押擔保標的	107.12.31	106.12.31
定期存款(帳列其他金融 資產－流動)	進口關稅保證金	\$ <u>3,712</u>	<u>3,820</u>

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

本公司與ARM公司等簽有技術授權合約，合約中訂定當本公司銷售之產品若有運用約定技術時，需依雙方議定價格支付權利金。

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

十二、其 他

員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總如下：

功 能 別 性 質 別	107年度			106年度		
	屬於營業 成 本 者	屬於營業 費 用 者	合 計	屬於營業 成 本 者	屬於營業 費 用 者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	30,468	762,573	793,041	31,114	703,743	734,857
勞健保費用	2,227	39,552	41,779	2,384	36,625	39,009
退休金費用	1,595	43,669	45,264	1,475	39,159	40,634
其他員工福利費用	1,430	20,265	21,695	1,398	19,427	20,825
折舊費用	2,753	54,845	57,598	4,894	52,125	57,019
攤銷費用	-	55,025	55,025	-	69,914	69,914

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

民國一〇七年度合併公司依證券發行人財務報告編製準則之規定，應再揭露之重大交易事項相關資訊如下：

- 1.資金貸與他人：無。
- 2.為他人背書保證：無。
- 3.期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)：

數量單位：千股(單位)

持有之 公 司	有價證券 種類及名稱	與有價證券 發行人之關係	帳列科目	期 末				期中最高 持股比率	備註
				股 數	帳面金額	持股比率	公允價值		
本公司	第一金台灣貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值 衡量之金融資產－流動	13,545	206,914	-	206,914	-	
本公司	統一強棒貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值 衡量之金融資產－流動	16,550	276,151	-	276,151	-	
本公司	元大得寶貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值 衡量之金融資產－流動	291	3,490	-	3,490	-	
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	Unitech Capital Inc.	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具之投資－非流動	2,500	60,848	5.00 %	-	5.00 %	
盛凌投資股份有限公司	譜永投資股份有限公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具之投資－非流動	23,124	161,110	3.03 %	-	3.03 %	
盛凌投資股份有限公司	金佶科技股份有限公司	-	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具之投資－非流動	3,330	43,203	13.59 %	-	16.38 %	

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期 初		買 入		賣 出				期 末	
					單位數	金額	單位數	金額	單位數	售價	帳面成本	處分損益	單位數	金額
本公司	統一強棒貨幣市場基金	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	統一投信	-	6,342	105,208	36,738	611,500	26,530	441,890	441,232	658	16,550	275,476 (註)

註：期末金額係取得成本，依市價評價後之帳面金額請詳3。

5. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
6. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關 係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金 額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單 價	授信期間	餘 額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	Holtek BVI	本公司之子公司	銷貨	(784,925)	(18) %	月結90天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	220,903	29 %	(註)
Holtek BVI	本公司	Holtek BVI之母公司	進貨	784,925	100 %	月結90天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(220,903)	(99) %	(註)
本公司	欣宏	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(512,531)	(12) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	96,514	13 %	
欣宏	本公司	對欣宏採權益法評價之投資公司	進貨	512,531	57 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(96,514)	(66) %	
本公司	優方	本公司之子公司	銷貨	(455,152)	(10) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	93,263	12 %	(註)
優方	本公司	優方之母公司	進貨	455,152	100 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(93,263)	(100) %	(註)
本公司	ForIC	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(127,791)	(3) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	16,519	2 %	
ForIC	本公司	對ForIC採權益法評價之投資公司	進貨	127,791	66 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(16,519)	(36) %	
本公司	Newtek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(246,166)	(6) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	32,506	4 %	
Newtek	本公司	對Newtek採權益法評價之投資公司	進貨	246,166	59 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(32,506)	(40) %	
本公司	Crown Rich	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(233,591)	(5) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	32,052	4 %	
Crown Rich	本公司	對Crown Rich採權益法評價之投資公司	進貨	233,591	36 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(32,052)	(22) %	
本公司	鈺威	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(148,581)	(3) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	23,260	3 %	
鈺威	本公司	對鈺威採權益法評價之投資公司	進貨	148,581	7 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(23,260)	(12) %	

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	New Wave	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(228,132)	(5) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	31,865	4 %	
New Wave	本公司	對New Wave採權益法評價之投資公司	進貨	228,132	51 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(31,865)	(39) %	
本公司	Truetek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(153,335)	(4) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	23,984	3 %	
Truetek	本公司	對Truetek採權益法評價之投資公司	進貨	153,335	41 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(23,984)	(27) %	
本公司	Santek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(155,310)	(4) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	47,820	6 %	
Santek	本公司	對Santek採權益法評價之投資公司	進貨	155,310	78 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(47,820)	(78) %	

註：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

8.應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額	提列備抵銷售金額
					金額	處理方式		
本公司	Holtek BVI	子公司	220,903 (註2)	3.59	-	即期收款	37,715 (註1)	-

註1：係截至民國一〇八年一月十八日止收回之金額。

註2：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

9.從事衍生性商品交易：無。

10.母子公司間業務關係及重要交易往來情形：

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係	交易往來情形			
				科目	金額	交易條件	佔合併總營收或資產之比率
0	本公司	HOLTEK BVI	母公司對子公司	銷貨收入	784,925	月結90天	16.14 %
0	本公司	HOLTEK BVI	母公司對子公司	應收帳款	220,903	-	3.86 %
0	本公司	優方	母公司對子公司	銷貨收入	455,152	月結60天	9.36 %
0	本公司	優方	母公司對子公司	應收帳款	93,263	-	1.68 %
0	本公司	悠健	母公司對子公司	銷貨收入	29,223	月結60天	0.60 %
0	本公司	盛通	母公司對子公司	銷貨收入	27,384	月結60天	0.56 %

註：係揭示交易金額佔合併總營收或總資產0.5%以上之交易。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(二)轉投資事業相關資訊：

民國一〇七年度合併公司之轉投資事業資訊如下(不包含大陸被投資公司)：

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高 持股比率	被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
本公司	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	475,831	475,831	15,253	100.00 %	524,475	100.00 %	43,268	43,268 註2	本公司之子公司
本公司	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	69,542	69,542	2,000	100.00 %	120,725	100.00 %	1,632	1,632 註2	本公司之子公司
本公司	Sigmos Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	6,898	6,898	200	100.00 %	22,811	100.00 %	231	231 註2	本公司之子公司
Sigmos Holdings Ltd.	Holtek Semiconductor (USA) Inc.	美國加洲	積體電路買賣及技術服務	6,898	6,898	2,000	100.00 %	22,811	100.00 %	231	註1,2	本公司之孫公司
本公司	MCU Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	16,333	16,333	500	100.00 %	650,461	100.00 %	106,251	106,251 註2	本公司之子公司
MCU Holdings Ltd.	ForIC Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件之技術支持與諮詢服務	9,733	9,733	300	40.00 %	23,302	40.00 %	3,025	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
ForIC Electronics Holding Ltd.	E-Micro Technology Holding Ltd. (BVI)	B.V.I.	投資海外各項事業	9,473	9,473	300	100.00 %	10,084	100.00 %	1,641	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Truetek Technology Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	16,306	16,306	920	40.00 %	49,594	40.00 %	26,880	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Quanding Technology Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件之技術支持與諮詢服務	1,868	1,868	60	40.00 %	18,746	40.00 %	14,777	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Santek Holdings Ltd.	B.V.I.	投資並提供電子元器件與單片機蕊片之應用與技術諮詢	3,758	3,758	180	40.00 %	22,651	40.00 %	23,354	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Bestway Electronic Inc.	B.V.I.	電子零件之銷售及技術服務	3,470	3,470	800	40.00 %	22,696	40.00 %	11,249	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	New Wave Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	24,784	24,784	800	40.00 %	67,736	40.00 %	36,491	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高 持股比例	被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
MCU Holdings Ltd.	Newtek Electronics Ltd.	B.V.I.	投資並提供電子元件與單片機蕊片之應用與技術諮詢	8,105	8,105	1,501	40.61 %	68,739	40.61 %	32,072	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Crown Rich Technology Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件之技術支持與諮詢服務	2,641	2,641	80	40.00 %	61,590	40.00 %	49,270	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Fine Chip Electronics Inc.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件之技術支持與諮詢服務	7,039	7,039	1	40.00 %	2,371	40.00 %	(2,960)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Anchip Technology Corporation	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件之技術支持與諮詢服務	2,937	2,937	1	60.00 %	2,522	60.00 %	1,438	註1,2	本公司之孫公司
MCU Holdings Ltd.	金濤高科有限公司	香港	電子零件之銷售及技術服務	9,907	9,907	2,400	40.00 %	18,452	40.00 %	4,072	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	宏達科技有限公司	香港	電子零件設計及銷售	5,427	5,427	1,275	33.33 %	8,144	33.00 %	1,015	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	JXY Electronics Corporation	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件之技術支持與諮詢服務	3,664	3,664	1	40.00 %	3,268	40.00 %	934	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Best Health Electronics Corporation	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件之技術支持與諮詢服務	20,965	20,965	5	80.00 %	22,669	80.00 %	1,755	註1,2	本公司之孫公司
MCU Holdings Ltd.	Best Power Electronics Corporation	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件之技術支持與諮詢服務	8,844	-	2	100.00 %	8,940	100.00 %	(48)	註1,2	本公司之孫公司
本公司	Holtek Semiconductor (India) Private Limited	INDIA	電子元器件及單片機蕊件之技術支持與諮詢服務	3	-	6	0.10 %	2	0.10 %	(1,186)	(1) 註2	本公司之孫公司
本公司	盛凌投資股份有限公司	新竹市	專營投資業務	429,826	400,000	42,983	100.00 %	490,773	100.00 %	19,229	19,229 註2	本公司之子公司
盛凌投資股份有限公司	欣宏電子股份有限公司	台北市	電子零組件製造/批發/零售	95,940	89,140	7,880	40.00 %	116,854	40.00 %	26,731	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高 持股比率	被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
欣宏電子股份 有限公司	A-ONE Wireless Technology Corp.	B.V.I.	電子零組 件製造/ 批發/零 售	59,204	59,204	2,000	100.00 %	90,082	100.00 %	10,674	註1	本公司之 子公司採 權益法評 價之被投 資公司轉 投資之子 公司
欣宏電子股份 有限公司	INNOTEK ELECTRONIC S INC.	B.V.I.	電子元器 件及單片 機蕊件之 技術支持 與諮詢服 務	43,810	43,810	800	100.00 %	41,289	100.00 %	8,737	註1	本公司之 子公司採 權益法評 價之被投 資公司轉 投資之子 公司
欣宏電子股份 有限公司	優方科技股份 有限公司	台北市	電子零組 件製造、 電子材料 批發零 售、電腦 及其週邊 設備製 造、資訊 軟體服務 及國際貿 易	7,375	7,375	738	36.88 %	14,326	36.88 %	12,044	註1	本公司之 孫公司
盛凌投資股份 有限公司	鈺威科技股份 有限公司	新北市	電子零組 件加工製 造、買賣 進出口	37,500	37,500	5,641	22.39 %	69,322	22.39 %	24,750	註1	本公司之 子公司採 權益法評 價之被投 資公司
盛凌投資股份 有限公司	高聖科技股份 有限公司	新北市	電子零組 件製造、 電子材料 批發零 售、電信 器材批發 零售、電 腦及其週 邊設備製 造、資訊 軟體服務 及國際貿 易	2,350	2,350	235	39.17 %	2,821	39.17 %	1,555	註1	本公司之 子公司採 權益法評 價之被投 資公司
盛凌投資股份 有限公司	優方科技股份 有限公司	台北市	電子零組 件製造、 電子材料 批發零 售、電腦 及其週邊 設備製 造、資訊 軟體服務 及國際貿 易	8,000	8,000	800	40.00 %	15,540	40.00 %	12,044	註1,2	本公司之 孫公司
優方科技股份 有限公司	Best Solution Electronics Inc.	B.V.I.	電子元器 件、電子 材料批發	6,140	6,140	200	100.00 %	40,543	100.00 %	15,636	註1,2	本公司之 孫公司投 資之子公 司

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高 持股比例	被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
盛凌投資股份 有限公司	天宇微機電股 份有限公司	新竹市	電子零組 件製造、 電子材料 批發零 售、電信 器材批發 零售、智 慧財產權 業、資訊 軟體服務 及國際貿 易	10,002	10,002	380	20.00 %	-	20.00 %	611	註1	本公司之 子公司採 權益法評 價之被投 資公司
盛凌投資股份 有限公司	盛通科技股份 有限公司	新竹市	電子零組 件製造、 電子材料 批發零 售、國際 貿易業及 資訊軟體 服務	40,000	40,000	4,000	100.00 %	21,662	100.00 %	(3,356)	註1,2	本公司之 孫公司
盛通科技股份 有限公司	BestComm RF Electronics Inc.	B.V.I.	電子零組 件製造/ 批發/零 售	14,054	14,054	30	100.00 %	10,788	100.00 %	434	註1,2	本公司之 孫公司投 資之子公司
盛凌投資股份 有限公司	倍創科技股份 有限公司	新竹市	電子零組 件製造、 電子材料 批發、無 店面零售 業、國際 貿易業	10,000	10,000	1,000	100.00 %	9,895	100.00 %	(41)	註1,2	本公司之 孫公司
盛凌投資股份 有限公司	Holtek Semiconductor (India) Private Limited	INDIA	電子元器 件及單片 機蕊片之 技術支持 與諮詢服 務業務	2,945	-	6,479	99.90 %	1,654	99.90 %	(1,186)	註1,2	本公司之 孫公司

註1：對各該公司投資損益之認列已分別包含於對子公司或孫公司之投資損益中。

註2：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

(三)大陸投資資訊：

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：

大陸被 投資公 司名稱	主要營業 項目	實 收 資本額	投資 方式	本期期初自 台灣匯出累 積投資金額	本期匯出或 收回投資金額		本期期末自 台灣匯出累 積投資金額	被投資 公司本 期損益	本公司直接 或間接投資 之持股比例	期中最高 持股比例	本期認列 投資損益 (註5)	期末投 資帳面 價值	截至本期 止已匯回 投資收益
					匯出	收回							
芯群集成 電路(廈 門)有限公 司	積體電路 買賣及技 術服務	113,551	(註1)	101,027	-	-	101,027	531	100 %	100 %	531	113,289	-
合泰半導 體(中國) 有限公司	集成電 路、電子 元器件及 單片機蕊 片之批發 及進出口 業務與諮 詢服務業 務	292,423	(註1)	272,221	-	-	272,221	35,312	100 %	100 %	35,312	326,434	-
新緯科技 (深圳)有 限公司	電子零件 銷售及售 後服務	6,769	(註1)	3,383	-	-	3,383	3,483	40 %	40 %	1,393	17,940	-

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期末初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	期中最高持股比例	本期認列投資損益(註5)	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回							
新禾(廈門)電子有限公司	電子元件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	6,398	(註1)	2,506	-	-	2,506	1,171	40 %	40 %	468	19,773	-
諾華達電子(深圳)有限公司	電子元件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	9,287	(註1)	3,928	-	-	3,928	7,893	40 %	40 %	3,157	22,146	-
華榮匯電子科技(北京)有限公司	電子元件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	19,361	(註1)	3,601	-	-	3,601	(6,091)	40 %	40 %	(2,436)	16,106	-
振揚電子(青島)有限公司	電子元件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	6,315	(註1)	2,634	-	-	2,634	633	40 %	40 %	253	6,647	-
新鼎電子(深圳)有限公司	電子元件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	6,699	(註1)	2,647	-	-	2,647	6,179	40.61 %	40.61 %	2,509	29,383	-
信霖電子商貿(上海)有限公司	電子元件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	30,293	(註1)	3,911	-	-	3,911	5,786	40 %	40 %	2,314	48,358	-
華瑞昇電子(深圳)有限公司	電子元件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	4,952	(註1)	1,964	-	-	1,964	27,034	40 %	40 %	10,814	60,116	-
全鼎電子(蘇州)有限公司	電子元件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	3,736	(註1)	1,600	-	-	1,600	2,236	40 %	40 %	894	18,345	-
金科集成電路(蘇州)有限公司	電子零件銷售及售後服務	69,712	(註1)	69,712	-	-	69,712	1,630	100 %	100 %	1,630	120,685	-
健芳電子科技(上海)有限公司	電子元件及單片機晶片技術研發與諮詢服務	7,541	(註1)	-	-	-	-	(1,197)	40 %	40 %	(479)	2,836	-
安禧普電子科技(東莞)有限公司	電子元件及單片機晶片技術研發與諮詢服務	1,521	(註1)	-	-	-	-	(647)	60 %	60 %	(388)	641	-
集芯源電子科技有限公司	電子元件及單片機晶片技術研發與諮詢服務	6,843	(註1)	-	-	-	-	(2,287)	40 %	40 %	(915)	4,407	-

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	期中最高持股比例	本期認列投資損益(註5)	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回							
悠健電子(東莞)有限公司	電子元器件及單片機芯片技術研發與諮詢服務	23,057	(註1)	-	-	-	-	(5,930)	80 %	80 %	(4,744)	15,110	-
芯通電子科技(東莞)有限公司	集成電路、電子元器件、單片機芯片的技術研發、技術服務及銷售	9,214	(註1)	-	9,392	-	9,392	(2,574)	100 %	100 %	(2,574)	6,351	-

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

2.轉投資大陸地區限額：

本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額(註2)	經濟部投審會核准 投資金額(註3)	依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額
480,481 (美金15,425千元)	547,438 (美金17,853千元)	2,519,502 (註4)

註1：透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

註2：累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額係依實際匯出之歷史匯率換算之新台幣金額；該金額包含盛通本期期末累計自台灣匯出之投資金額9,392千元(美金314千元)。

註3：經濟部投審會核准投資金額係以報導日匯率換算新台幣金額；該金額係包括核准自台灣匯出投資金額計461,620千元(美金15,054千元)、第三地區之盈餘轉增資金額計76,205千元(美金2,485千元)及盛通核准自台灣匯出投資金額計9,613千元(美金314千元)。

註4：依「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定，本公司對大陸投資累計金額未超過主管機關所定投資金額或比例上限。淨值4,199,170千元 $\times$ 60% $\div$ 2,519,502千元；另盛通之限額計算為淨值21,662千元 $\times$ 60% $\div$ 12,997千元。

註5：經台灣母公司查核之財務報告。

3.與大陸被投資公司間之重大交易事項：

本公司民國一〇七年度與大陸被投資公司直接或間接之重大交易事項，請詳「重大交易事項相關資訊」之說明。

十四、部門資訊

(一)一般性資訊及部門資訊

合併公司主要營運項目為積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售，為單一營運部門。營運部門資訊與合併財務報告一致，收入(來自外部客戶收入)及部門損益請詳合併綜合損益表；部門資產請詳合併資產負債表。

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(二)產品別及勞務別資訊

合併公司來自外部客戶收入資訊如下：

	107年度		106年度	
	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%
積體電路銷貨收入	\$ 4,853,674	100	4,607,916	100
設計收入	9,133	-	7,001	-
	<u>\$ 4,862,807</u>	<u>100</u>	<u>4,614,917</u>	<u>100</u>

(三)地區別資訊

合併公司地區別資訊如下，其中收入係依據客戶所在地理位置歸類，而非流動資產則依據資產所在地理位置歸類。

	107年度		106年度	
	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%
來自外部客戶收入：				
中國	\$ 3,716,948	76	3,331,746	72
台灣	484,264	10	557,865	12
其他國家	<u>661,595</u>	<u>14</u>	<u>725,306</u>	<u>16</u>
	<u>\$ 4,862,807</u>	<u>100</u>	<u>4,614,917</u>	<u>100</u>
	107.12.31		106.12.31	
	金 額	佔當期總 資產之%	金 額	佔當期總 資產之%
非流動資產：				
台灣	\$ 182,991	3	188,647	4
中國	265,648	5	268,385	5
其他國家	<u>868</u>	<u>-</u>	<u>106</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 449,507</u>	<u>8</u>	<u>457,138</u>	<u>9</u>

盛群半導體股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)

(四)主要客戶

合併公司佔營業收入淨額10%以上之重要客戶資訊如下：

	107年度		106年度	
	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%
欣宏	\$ 635,592	13	571,681	12
CROWN RICH	544,069	11	465,727	10
	<u>\$ 1,179,661</u>	<u>24</u>	<u>1,037,408</u>	<u>22</u>

會計師查核報告

盛群半導體股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

盛群半導體股份有限公司民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達盛群半導體股份有限公司民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與盛群半導體股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對盛群半導體股份有限公司民國一〇七年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、銷貨收入－關係人及未實現銷貨毛利

有關收入認列之評估會計政策請詳個體財務報告附註四(十五)收入認列。與關係人間之重大交易事項請詳個體財務報告附註七(二)。

關鍵查核事項之說明：

收入為企業永續經營之基本營運活動，攸關企業營運績效，因主要交易對象為關係人，其先天存在較高舞弊風險，故收入認列－關係人及未實現銷貨毛利之測試為本會計師執行盛群半導體股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之相關控制並評估商業交易之合理性；評估收入趨勢分析；瞭解關係人交易及對帳執行情形；執行關係人函証發函詢証；評估銷貨毛利率及未實現銷貨毛利之正確性及合理性；並評估盛群半導體股份有限公司是否已適當揭露關係人銷貨收入及未實現銷貨毛利之相關資訊。

二、存貨備抵跌價損失之評估

有關存貨備抵跌價損失之評估會計政策請詳個體財務報告附註四(八)存貨；存貨備抵跌價損失之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五。相關說明請詳個體財務報告附註六(四)(重要會計項目說明—存貨)。

關鍵查核事項之說明：

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低衡量，盛群半導體股份有限公司評估報導日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎，故可能因產業快速變遷而產生重大變動，因此，存貨備抵跌價損失之評估測試為本會計師執行盛群半導體股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視存貨庫齡報表分析各期存貨庫齡變化情形；執行電腦審計程序以檢查存貨庫齡報表之正確性；檢視管銷會議評估存貨去化情形；評估存貨之評價是否已按盛群半導體股份有限公司既訂之會計政策；執行存貨備抵跌價損失提列之回溯性測試，以驗證提列呆滯損失之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估盛群半導體股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算盛群半導體股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

盛群半導體股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對盛群半導體股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使盛群半導體股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致盛群半導體股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成盛群半導體股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對盛群半導體股份有限公司民國一〇七年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

曾漢鈺



游萬齡



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號

民 國 一〇八 年 一 月 二十八 日

盛群半導體股份有限公司



民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	107年度		106年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十四)及七)	\$ 4,358,758	100	4,130,794	100
5000 營業成本(附註六(四)、(九)、(十三)、七及十二)	<u>2,274,449</u>	<u>52</u>	<u>2,235,347</u>	<u>54</u>
營業毛利	2,084,309	48	1,895,447	46
5910 未實現銷貨利益之變動	<u>33,928</u>	<u>1</u>	<u>38,452</u>	<u>1</u>
已實現營業毛利	<u>2,050,381</u>	<u>47</u>	<u>1,856,995</u>	<u>45</u>
營業費用(附註六(九)、(十三)及十二)：				
6100 推銷費用	98,669	2	98,272	3
6200 管理費用	253,565	6	249,816	6
6300 研究發展費用	643,748	15	628,671	15
6450 預期信用減損損失(附註六(三))	<u>3,066</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>999,048</u>	<u>23</u>	<u>976,759</u>	<u>24</u>
營業淨利	<u>1,051,333</u>	<u>24</u>	<u>880,236</u>	<u>21</u>
營業外收入及支出：				
7020 其他利益及損失(附註六(十五))	1,618	-	17,166	-
7070 採用權益法認列之子公司利益之份額(附註六(六))	170,610	4	147,145	4
7100 利息收入	<u>9,349</u>	<u>-</u>	<u>7,318</u>	<u>-</u>
	<u>181,577</u>	<u>4</u>	<u>171,629</u>	<u>4</u>
稅前淨利	1,232,910	28	1,051,865	25
7950 所得稅費用(附註六(十))	<u>168,920</u>	<u>4</u>	<u>125,677</u>	<u>3</u>
本期淨利	<u>1,063,990</u>	<u>24</u>	<u>926,188</u>	<u>22</u>
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(九))	(5,618)	-	(5,148)	-
8330 採用權益法認列子公司之其他綜合損益之份額	(58,603)	(1)	-	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十))	<u>1,124</u>	<u>-</u>	<u>875</u>	<u>-</u>
	<u>(63,097)</u>	<u>(1)</u>	<u>(4,273)</u>	<u>-</u>
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(16,431)	-	(9,426)	-
8371 採用權益法認列子公司之國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(521)	-	456	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十))	<u>3,990</u>	<u>-</u>	<u>1,525</u>	<u>-</u>
	<u>(12,962)</u>	<u>-</u>	<u>(7,445)</u>	<u>-</u>
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>(76,059)</u>	<u>(1)</u>	<u>(11,718)</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 987,931</u>	<u>23</u>	<u>914,470</u>	<u>22</u>
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十二))				
9750 基本每股盈餘	\$ <u>4.70</u>		\$ <u>4.10</u>	
9850 稀釋每股盈餘	\$ <u>4.66</u>		\$ <u>4.06</u>	

董事長：吳啟勇



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：高國棟



會計主管：廖明通





民國一〇七年及一〇六年度十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘		國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	其他權益 透過其他綜 合損益按公 允價值衡量 之金融資產 未實現損益	合 計	權益總計
				特別盈 餘公積	未分配 盈 餘				
民國一〇六年一月一日餘額	\$ 2,261,682	159,281	781,525	2,642	784,511	(24,311)	-	(24,311)	3,965,330
本期淨利	-	-	-	-	926,188	-	-	-	926,188
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,273)	(7,445)	-	(7,445)	(11,718)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	921,915	(7,445)	-	(7,445)	914,470
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	78,422	-	(78,422)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	24,312	(24,312)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(109,918)	-	(681,671)	-	-	-	(791,589)
採用權益法認列之子公司之變動數	-	(16,972)	-	-	-	-	-	-	(16,972)
民國一〇六年十二月三十一日餘額	2,261,682	142,309	750,029	26,954	922,021	(31,756)	-	(31,756)	4,071,239
追溯適用新準則之調整數	-	-	-	-	-	-	67,290	67,290	67,290
民國一〇七年一月一日重編後餘額	2,261,682	142,309	750,029	26,954	922,021	(31,756)	67,290	35,534	4,138,529
本期淨利	-	-	-	-	1,063,990	-	-	-	1,063,990
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,494)	(12,962)	(58,603)	(71,565)	(76,059)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,059,496	(12,962)	(58,603)	(71,565)	987,931
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	92,202	-	(92,202)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	7,445	(7,445)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(104,942)	-	(822,348)	-	-	-	(927,290)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之權益工具	-	-	-	-	1,355	-	(1,355)	(1,355)	-
民國一〇七年十二月三十一日餘額	\$ 2,261,682	142,309	737,289	34,399	1,060,877	(44,718)	7,332	(37,386)	4,199,170



董事長：吳啟勇

(請詳閱後附個體財務報告附註)



經理人：高國棟



會計主管：廖明通

盛群半導體股份有限公司

現金流量表

民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	107年度	106年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 1,232,910	1,051,865
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	33,247	32,959
攤銷費用	54,186	69,433
預期信用損失	3,066	-
利息收入	(9,349)	(7,318)
採用權益法認列之子公司利益之份額	(170,610)	(147,145)
聯屬公司間未實現銷貨利益變動	33,928	38,452
其他不影響現金流量之損費淨額	6,379	3,325
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	97,382	(222,513)
應收票據及帳款(含應收關係人帳款)減少(增加)	32,993	(164,069)
存貨增加	(53,019)	(71,927)
其他營業資產增加	(12,247)	(3,993)
應付票據及帳款增加	17,579	33,737
淨確定福利負債減少	(1,953)	(1,784)
其他營業負債增加	9,231	26,638
營運產生之現金流入	1,273,723	637,660
收取之利息	9,263	7,256
收取之股利	-	15,585
支付之所得稅	(119,958)	(89,364)
營業活動之淨現金流入	1,163,028	571,137
投資活動之現金流量：		
長期投資增加數	(3)	-
取得不動產、廠房及設備	(19,502)	(20,101)
處分不動產、廠房及設備	33	-
存出保證金增加	(724)	(183)
其他金融資產減少	105,908	419,314
其他非流動資產增加	(64,107)	(48,391)
投資活動之淨現金流入	21,605	350,639
籌資活動之現金流量：		
發放股東現金股利	(927,290)	(791,589)
籌資活動之淨現金流出	(927,290)	(791,589)
本期現金及約當現金增加數	257,343	130,187
期初現金及約當現金餘額	921,425	791,238
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,178,768	921,425

董事長：吳啟勇



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：高國棟



會計主管：廖明通



盛群半導體股份有限公司
個體財務報告附註
民國一〇七年度及一〇六年度
(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

盛群半導體股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國八十七年十月一日依中華民國公司法及科學園區設置管理條例之規定成立，自民國八十七年十二月十一日開始營業，民國八十九年四月於香港設立分公司。本公司股票自民國九十一年十一月四日起於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌買賣，自民國九十三年九月二十七日起改於台灣證券交易所股份有限公司掛牌買賣。

本公司主要營業項目為各種積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售。

二、通過財務報告之日期及程序

本個體財務報告已於民國一〇八年一月二十八日經提報董事會後發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會認可之新發布及修訂後準則及解釋之影響

本公司自民國一〇七年起全面採用經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)認可並於民國一〇七年生效之國際財務報導準則編製個體財務報告。相關新發布、修正及修訂之準則及解釋彙列如下：

新發布／修正／修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第2號之修正「股份基礎給付交易之分類及衡量」	2018年1月1日
國際財務報導準則第4號之修正「於國際財務報導準則第4號『保險合約』下國際財務報導準則第9號『金融工具』之適用」	2018年1月1日
國際財務報導準則第9號「金融工具」	2018年1月1日
國際財務報導準則第15號「客戶合約之收入」	2018年1月1日
國際會計準則第7號之修正「揭露倡議」	2017年1月1日
國際會計準則第12號之修正「未實現損失之遞延所得稅資產之認列」	2017年1月1日
國際會計準則第40號之修正「投資性不動產之轉列」	2018年1月1日

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

新發布／修正／修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則2014-2016週期之年度改善：	
國際財務報導準則第12號之修正	2017年1月1日
國際財務報導準則第1號之修正及國際會計準則第28號之修正	2018年1月1日
國際財務報導解釋第22號「外幣交易與預收(付)對價」	2018年1月1日

除下列項目外，適用上述新認可之國際財務報導準則對個體財務報告未造成重大變動。造成重大變動者之性質及影響說明如下：

1. 國際財務報導準則第十五號「客戶合約之收入」

該準則取代國際會計準則第十八號「收入」、國際會計準則第十一號「建造合約」及相關解釋，以單一分析模型按五個步驟決定企業認列收入之方法、時點及金額。本公司採累積影響數法適用國際財務報導準則第十五號，因此，以前期間之比較資訊無須重編而係繼續適用國際會計準則第十八號、國際會計準則第十一號及相關解釋，初次適用國際財務報導準則第十五號之累積影響數係調整民國一〇七年一月一日之保留盈餘。

此項會計政策變動之性質及影響說明如下：

銷售商品

針對產品之銷售，過去係於商品交付至客戶場址時認列收入，於該時點客戶已接受該產品，且相關所有權之重大風險及報酬已移轉予客戶。於該時點認列收入，係因該時點收入及成本能可靠衡量、對價很有可能收回，且不再繼續參與對商品之管理。國際財務報導準則第十五號下，係於客戶取得對產品之控制時認列收入。

首次適用國際財務報導準則第十五號之規定編製之綜合損益表與適用國際會計準則第十八號「收入」及相關解釋所編製者，並無重大差異。

2. 國際財務報導準則第九號「金融工具」

國際財務報導準則第九號「金融工具」(以下稱國際財務報導準則第九號或IFRS 9)取代國際會計準則第三十九號「金融工具：認列與衡量」(以下稱國際會計準則第三十九號或IAS 39)，修正金融工具之分類與衡量、減損及避險會計。

由於採用國際財務報導準則第九號，本公司採用修正後之國際會計準則第一號「財務報表之表達」，該準則規定於綜合損益表將金融資產之減損列報為單行項目，先前本公司係將應收帳款之減損列報於管理費用。此外，本公司採用修正後之國際財務報導準則第七號「金融工具：揭露」揭露民國一〇七年資訊，該等規定通常不適用於比較期資訊。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司適用國際財務報導準則第九號導致之會計政策重大變動說明如下：

(1) 金融資產及負債之分類

該準則主要將金融資產分類為按攤銷後成本衡量、透過其他綜合損益按公允價值衡量及透過損益按公允價值衡量三類，國際財務報導準則第九號下金融資產之分類係以持有該金融資產之經營模式及其合約現金流量特性為基礎，並刪除原準則下持有至到期日、放款及應收款及備供出售金融資產之分類。依該準則，混合合約包含之主契約若屬該準則範圍內之金融資產，則不拆分嵌入之衍生工具，而係評估整體混合金融工具之分類。本公司於國際財務報導準則第九號下金融資產之分類、衡量及相關利益及損失認列之會計政策說明請詳附註四(六)。

採用國際財務報導準則第九號對本公司之金融負債會計政策無重大影響。

(2) 金融資產之減損

該準則以前瞻性之預期信用損失模式取代現行國際會計準則第三十九號已發生減損損失模式，新減損模式適用於按攤銷後成本衡量之金融資產、合約資產及透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資，但不適用於權益工具投資。國際財務報導準則第九號下，信用損失之認列時點早於國際會計準則第三十九號下之認列時點，請詳附註四(六)。

(3) 過渡處理

除下列項目外，通常係追溯適用國際財務報導準則第九號：

- 適用國際財務報導準則第九號所產生之金融資產帳面金額差異數，係認列於民國一〇七年一月一日之保留盈餘及其他權益項目，據此，民國一〇六年表達之資訊通常不會反映國際財務報導準則第九號之規定，因此，與民國一〇七年適用國際財務報導準則第九號所揭露之資訊不具可比性。
- 下列事項係以初次適用日存在之事實及情況為基礎評估：
 - 判定金融資產係以何種經營模式持有。
 - 先前指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產及金融負債之指定及撤銷。
 - 部分非持有供交易之權益工具投資作透過其他綜合損益按公允價值衡量之指定。
- 若債務證券投資於國際財務報導準則第九號初始適用日之信用風險低，則本公司假定該資產自原始認列日信用風險未顯著增加。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(4)國際財務報導準則第九號初次適用日之金融資產分類

適用國際會計準則第三十九號衡量種類之金融資產轉換至國際財務報導準則第九號衡量種類之金融資產，該金融資產民國一〇七年一月一日之新衡量種類、帳面金額及說明如下(金融負債之衡量種類及帳面金額未改變)：

金融資產	IAS39		IFRS9	
	衡量種類	帳面金額	衡量種類	帳面金額
現金及約當現金	放款及應收款	921,425	攤銷後成本	921,425
應收款項淨額	放款及應收款	785,595	攤銷後成本	785,595
其他金融資產(三個月以上定存)	放款及應收款(無活絡市場之債務工具投資)	670,131	攤銷後成本	670,131
存出保證金	放款及應收款	5,562	攤銷後成本	5,562

3.國際會計準則第十二號之修正「未實現損失之遞延所得稅資產之認列」

修正條文闡明符合特定條件之情況下，將對未實現損失認列遞延所得稅資產，並釐清「未來課稅所得」之計算方式。

適用國際會計準則第十二號對本公司並無重大影響。

(二)尚未採用金管會認可之國際財務報導準則之影響

依據金管會民國一〇七年七月十七日金管證審字第1070324857號令，公開發行以上公司應自民國一〇八年起全面採用經金管會認可並於民國一〇八年生效之國際財務報導準則。相關新發布、修正及修訂之準則及解釋彙列如下：

新發布／修正／修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第16號「租賃」	2019年1月1日
國際財務報導解釋第23號「所得稅務處理之不確定性」	2019年1月1日
國際財務報導準則第9號之修正「具有負補償之提前還款特性」	2019年1月1日
國際會計準則第19號之修正「計畫修正、縮減或清償」	2019年1月1日
國際會計準則第28號之修正「對關聯企業及合資之長期權益」	2019年1月1日
國際財務報導準則2015-2017週期之年度改善	2019年1月1日

除下列項目外，適用上述新認可之國際財務報導準則將不致對個體財務報告造成重大變動。造成重大變動者之性質及影響說明如下：

1.國際財務報導準則第十六號「租賃」

該準則將取代現行國際會計準則第十七號「租賃」、國際財務報導解釋第四號「決定一項安排是否包含租賃」、解釋公告第十五號「營業租賃：誘因」及解釋公告第二十七號「評估涉及租賃之法律形式之交易實質」。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

新準則針對承租人採用單一會計處理模式將租賃交易認列於資產負債表，並以使用權資產表達其使用標的資產之權利，以租賃負債表達支付租賃給付之義務。此外，該等租賃相關之費用將以折舊及利息取代現行營業租賃下以直線基礎認列租金之方式表達。另對於短期租賃及低價值標的資產租賃提供認列豁免規定。出租人之會計處理則維持與現行準則類似，亦即，出租人仍應將租賃分類為營業租賃或融資租賃。

(1)判斷合約是否包含租賃

於過渡至新準則時，本公司得選擇：

- 針對所有合約適用新準則規定之租賃定義；或
- 採用實務權宜作法而不重新評估合約是否為或包含租賃。

本公司預計於過渡時採用實務權宜作法豁免租賃定義之重評估，亦即，本公司係將民國一〇八年一月一日前所簽訂之所有合約適用現行規定之租賃定義。

(2)過渡處理

本公司為承租人之合約，得就所有合約選擇：

- 完全追溯；或
- 修正式追溯及一個或多個實務權宜作法

本公司預計採用修正式追溯過渡至新準則，因此不重編比較期資訊。

於採用修正式追溯時，現行準則分類為營業租賃之合約得以個別合約為基礎，於過渡時選擇是否採用一個或多個實務權宜作法。本公司評估將採用以下實務權宜作法：

- 針對具有類似特性之租賃組合採用單一折現率；
- 依其於初次適用日前依據IAS37虧損性合約之評估結果，作為對使用權資產減損評估之替代方法；
- 針對租賃期間於初次適用日後12個月內結束之租賃，適用豁免而不認列使用權資產及租賃負債；
- 不將原始直接成本計入初次適用日之使用權資產衡量中；
- 於租賃合約包含租賃延長或終止選擇權下，決定租賃期間時，採用後見之明。

(3)截至目前為止，本公司評估適用新準則最重大的影響係針對現行以營業租賃承租辦公處所認列使用權資產及租賃負債，預估上述差異可能使民國一〇八年一月一日使用權資產及租賃負債均增加93,218千元。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

2. 國際財務報導解釋第23號「所得稅務處理之不確定性」

新解釋闡明於評估具不確定性之租稅處理對課稅所得(損失)、課稅基礎、未使用課稅損失、未使用投資抵減及稅率之影響時，應假設租稅主管機關將依法審查相關金額，並且於審查時已取得所有相關資訊。

若評估後認為租稅主管機關很有可能接受一項具不確定性之租稅處理，則應以與租稅申報時所使用之處理一致之方式決定課稅所得(損失)、課稅基礎、未使用課稅損失、未使用投資抵減及稅率；反之，若並非很有可能，則得以最有可能金額或期望值兩者較適用者，反映每一項具不確定性之租稅處理之影響。

截至目前為止，本公司評估適用新解釋並無重大影響。

(三) 金管會尚未認可之新發布及修訂準則及解釋

下表彙列國際會計準則理事會(以下簡稱理事會)已發布及修訂但尚未經金管會認可之準則及解釋：

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布之生效日
國際財務報導準則第3號之修正「業務之定義」	2020年1月1日
國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	尚待理事會決定
國際財務報導準則第17號「保險合約」	2021年1月1日
國際會計準則第1號及國際會計準則第8號之修正「重大性之定義」	2020年1月1日

本公司現正持續評估上述準則及解釋對本公司財務狀況與經營結果之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

本個體財務報告所採用之重大會計政策彙總說明如下，下列會計政策已一致適用於本個體財務報告之所有表達期間。

(一) 遵循聲明

本個體財務報告係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製。

(二) 編製基礎

1. 衡量基礎

除下列資產負債表之重要項目外，本個體財務報告係依歷史成本為基礎編製：

- (1) 依公允價值衡量之透過損益按公允價值衡量金融資產；及
- (2) 淨確定福利負債，係依退休基金資產之公允價值減除確定福利義務現值。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

2.功能性貨幣及表達貨幣

本公司以營運所處主要經濟環境之貨幣為功能性貨幣。本個體財務報告係以本公司之功能性貨幣，新台幣表達。所有以新台幣表達之財務資訊均以新台幣千元為單位。

(三)外幣

1.外幣交易

外幣交易依交易日之匯率換算為功能性貨幣。報導期間結束日(以下稱報導日)之外幣貨幣性項目依當日之匯率換算為功能性貨幣，其兌換損益係指期初以功能性貨幣計價之攤銷後成本，調整當期之有效利息及付款後之金額，與依外幣計價之攤銷後成本按報導日匯率換算金額間之差異。以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目依衡量公允價值當日之匯率重新換算為功能性貨幣，以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目則依交易日之匯率換算。

2.國外營運機構

國外營運機構之資產及負債，係依報導日之匯率換算為新台幣；股東權益項目除期初保留盈餘以上期期末換算後之餘額結轉外，其餘依歷史匯率換算為新台幣；收益及費損項目係依當期平均匯率換算為新台幣，所產生之兌換差額均認列為其他綜合損益。

當處分國外營運機構致喪失控制、共同控制或重大影響時，與該國外營運機構相關之累計兌換差額係全數重分類為損益。

(四)資產與負債區分流動與非流動之分類標準

符合下列條件之一之資產列為流動資產，非屬流動資產之所有其他資產則列為非流動資產：

- 1.預期於其正常營業週期中實現，或意圖將其出售或消耗；
- 2.主要為交易目的而持有該資產；
- 3.預期於報導期間後十二個月內實現該資產；或
- 4.該資產為現金或約當現金，但於報導期間後至少十二個月將該資產交換或用以清償負債受到其他限制者除外。

符合下列條件之一之負債列為流動負債，非屬流動負債之所有其他負債則列為非流動負債：

- 1.預期將於正常營業週期中清償該負債；
- 2.主要為交易目的而持有該負債；
- 3.預期將於報導期間後十二個月內到期清償該負債；或
- 4.未具無條件將清償期限遞延至報導期間後至少十二個月之權利之負債。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(五)現金及約當現金

現金包括庫存現金及活期存款。約當現金係指可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之短期並具高度流動性之投資。定期存款符合前述定義且持有目的係滿足短期現金承諾而非投資或其他目的者，列報於約當現金。

(六)金融工具(民國一〇七年一月一日(含)以後適用)

1.金融資產

本公司之金融資產分類為：按攤銷後成本衡量之金融資產、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及透過損益按公允價值衡量之金融資產。

本公司僅於改變管理金融資產之經營模式時，始依規定重分類所有受影響之金融資產。

(1)按攤銷後成本衡量之金融資產

金融資產同時符合下列條件，且未指定為透過損益按公允價值衡量時，係按攤銷後成本衡量：

- 係在以收取合約現金流量為目的之經營模式下持有該金融資產。
- 該金融資產之合約條款產生特定日期之現金流量，完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

原始認列時係按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量；後續採有效利率法以攤銷後成本衡量，該攤銷後成本已減除減損損失。利息收入、外幣兌換損益及減損損失係認列於損益。除列時，將利益或損失列入損益。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交易日會計處理。

(2)透過損益按公允價值衡量之金融資產

非屬上述按攤銷後成本衡量或透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，係透過損益按公允價值衡量。本公司於原始認列時，為消除或重大減少會計配比不當，得不可撤銷地將符合按攤銷後成本衡量或透過其他綜合損益按公允價值衡量條件之金融資產，指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產。

原始認列時係按公允價值衡量，交易成本於發生時認列為損益；後續按公允價值衡量，再衡量產生之利益或損失(包含利息收入)認列為損益。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交易日會計處理。

(3)金融資產減損

本公司針對按攤銷後成本衡量之金融資產(包括現金及約當現金、應收票據及應收帳款、存出保證金及其他金融資產等)之預期信用損失認列備抵損失。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

下列金融資產係按十二個月預期信用損失金額衡量備抵損失，其餘係按存續期間預期信用損失金額衡量：

- 判定債務證券於報導日之信用風險低；及
- 其他債務證券及銀行存款之信用風險(即金融工具之預期存續期間發生違約之風險)自原始認列後未顯著增加。

應收帳款之備抵損失係按存續期間預期信用損失金額衡量。

存續期間預期信用損失係指金融工具預期存續期間所有可能違約事項產生之預期信用損失。

十二個月預期信用損失係指金融工具於報導日後十二個月內可能違約事項所產生之預期信用損失(或較短期間，若金融工具之預期存續期間短於十二個月時)。

衡量預期信用損失之最長期間為本公司暴露於信用風險之最長合約期間。

於判定自原始認列後信用風險是否已顯著增加時，本公司考量合理且可佐證之資訊(無需過度成本或投入即可取得)，包括質性及量化資訊，及根據本公司之歷史經驗、信用評估及前瞻性資訊所作之分析。

若金融工具之信用風險評等相當於全球所定義之「投資等級」(為標準普爾之投資等級BBB-、穆迪之投資等級Baa3或中華信評之投資等級twA，或高於該等級者)，本公司視為該債務證券之信用風險低。

若合約款項逾期超過九十天，本公司假設金融資產之信用風險已顯著增加。

若合約款項逾期超過一百八十天，或借款人不太可能履行其信用義務支付全額款項予本公司時，本公司視為該金融資產發生違約。

預期信用損失為金融工具預期存續期間信用損失之機率加權估計值。信用損失係按所有現金短收之現值衡量，亦即本公司依據合約可收取之現金流量與本公司預期收取之現金流量之差額。預期信用損失係按金融資產之有效利率折現。

按攤銷後成本衡量之金融資產之備抵損失係自資產之帳面金額中扣除，備抵損失之提列或迴轉金額係認列於損益中。

當本公司對回收金融資產整體或部分無法合理預期時，係直接減少其金融資產總帳面金額。通常係指本公司判定債務人之資產或收益來源不能產生足夠之現金流量以償還沖銷之金額，然而，已沖銷之金融資產仍可強制執行，以符合本公司回收逾期金額之程序。

(4)金融資產之除列

本公司僅於對來自該資產現金流量之合約權利終止，或已移轉金融資產且該資產所有權幾乎所有之風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(七)金融工具(民國一〇七年一月一日以前適用)

1.金融資產

(1)透過損益按公允價值衡量之金融資產

此類金融資產係指持有供交易之金融資產，其取得或發生之主要目的為短期內出售或再買回。此類金融資產於原始認列時係按公允價值衡量，交易成本於發生時認列為損益；後續評價按公允價值衡量，再衡量產生之利益或損失認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交易日會計處理。

(2)應收款

應收款係無活絡市場公開報價，且具固定或可決定付款金額之金融資產，包括應收款項及其他應收款。原始認列時係按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量；續後評價採有效利率法以攤銷後成本減除減損損失衡量，惟短期應收款項之利息認列不具重大性之情況除外。

(3)金融資產減損

非透過損益按公允價值衡量之金融資產，於每個報導日評估減損。當有客觀證據顯示，因金融資產原始認列後發生之單一或多項事件，致使該資產之估計未來現金流量受損失者，該金融資產即已發生減損。

針對應收款個別評估未有減損後，另再以組合基礎評估減損。應收款組合之客觀減損證據可能包含本公司過去收款經驗、該組合超過平均授信期間之延遲付款增加情況，以及與應收款拖欠有關之全國性或區域性經濟情勢變化。

所有金融資產之減損損失係直接自金融資產之帳面金額中扣除，惟應收款之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額，當判斷應收款無法收回時，則沖銷備抵帳戶，原先已沖銷而後續收回之款項則貸記備抵帳戶。備抵帳戶帳面金額之變動認列於損益。

當金融資產以攤銷後成本衡量時，若後續期間減損損失金額減少，且該減少客觀地連結至認列減損後發生之事項，則先前認列之減損損失予以迴轉認列於損益，惟該投資於減損迴轉日之帳面金額不得大於若未認列減損情況下應有之攤銷後成本。

(4)金融資產之除列

本公司僅於對來自該資產現金流量之合約權利終止，或已移轉金融資產且該資產幾乎所有之風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

2.金融負債

(1)應付款

金融負債非屬持有供交易且未指定為透過損益按公允價值衡量者，包括應付帳款及其他應付款，原始認列時係按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量；續後評價採有效利率法以攤銷後成本衡量。

(2)金融負債之除列

本公司係於合約義務已履行、取消或到期時，除列金融負債。

除列金融負債時，其帳面金額與所支付或應支付對價總額間之差額認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。

(3)金融資產及負債之互抵

金融資產及金融負債僅於本公司有法定權利進行互抵及有意圖以淨額交割或同時變現資產及清償負債時，方予以互抵並以淨額表達於資產負債表。

(八)存貨

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。成本包括使其達可供使用之地點及狀態所發生之必要支出，並採加權平均法計算。淨變現價值係正常營業下之估計售價減除至完工尚需投入之成本及銷售費用為計算基礎。

(九)投資關聯企業

關聯企業係指本公司對其財務及營運政策具有重大影響力但未達控制能力者。本公司持有被投資公司百分之二十至百分之五十之表決權時，即假設具有重大影響力，並採權益法評價。

在權益法下，原始取得時係依成本認列，投資成本包含交易之成本。投資關聯企業之帳面金額包括原始投資時所辨認之商譽，減除任何累計減損損失。

個體財務報告包括自具有重大影響力之日起至喪失重大影響力之日止，於進行與本公司會計政策一致性之調整後，本公司依權益比例認列各該投資關聯企業之損益及其他綜合損益之金額。

本公司與關聯企業間之交易所產生之未實現損益，已在本公司對該被投資公司之權益範圍內予以消除。

當本公司依比例應認列關聯企業之損失份額等於或超過其在關聯企業之權益時，即停止認列其損失，而僅於發生法定義務、推定義務或已代該被投資公司支付款項之範圍內，認列額外之損失及相關負債。

(十)投資子公司

於編製個體財務報告時，本公司對具控制力之被投資公司係採權益法評價。在權益法下，個體財務報告當期損益及其他綜合損益與合併基礎編製之財務報告中當期損益及其他綜合損益歸屬於母公司業主之分攤數相同，且個體財務報告業主權益與合併基礎編製之財務報告中歸屬於母公司業主之權益相同。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司對子公司所有權權益之變動，未導致喪失控制者，作為與業主間之權益交易處理。

(十一)不動產、廠房及設備

1.認列與衡量

不動產、廠房及設備之認列及衡量係採成本模式，依成本減除累計折舊與累計減損後之金額衡量。成本包含可直接歸屬於取得資產之支出、任何其他使資產達預計用途之可使用狀態的直接可歸屬成本、拆卸與移除該項目及復原所在地點之成本。此外，為整合相關設備功能而購入之軟體亦資本化為該設備之一部分。

當不動產、廠房及設備包含不同組成部分，且相對於該項目之總成本若屬重大而採用不同之折舊方法較為合宜時，則視為不動產、廠房及設備之單獨項目(主要組成部分)處理。

不動產、廠房及設備之處分損益，以淨額認列於營業外收入及支出項下。

2.後續成本

若不動產、廠房及設備項目後續支出所預期產生之未來經濟效益很有可能流入本公司，且其金額能可靠衡量，則該支出認列為該項目帳面金額之一部分，被重置部分之帳面金額則予以除列。不動產、廠房及設備之日常維修成本於發生時認列為損益。

3.折舊

折舊係依資產成本減除殘值後按估計耐用年限採直線法計提，並依資產之各別重大組成部分評估，若一組成部分之耐用年限不同於資產之其他部分，則此組成部分應單獨提列折舊。折舊之提列認列為損益。

當期及比較期間之估計耐用年限如下：

(1)房屋及建築物：20~30年

(2)機器設備：3~5年

(3)其他設備：2~8年

每年至少於年度報導日檢視不動產、廠房及設備之折舊方法、耐用年限及殘值，若有變動，視為會計估計變動。

(十二)租賃

營業租賃之租金給付依直線法於租賃期間認列為費用。

(十三)無形資產

1.研究與發展

研究階段係指預期為獲取及瞭解嶄新的科學或技術知識而進行之活動，相關支出於發生時認列於損益。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

發展階段之支出於同時符合下列所有條件時，認列為無形資產；未同時符合者，於發生時即認列於損益：

- (1)完成無形資產之技術可行性已達成，使該無形資產將可供使用或出售。
- (2)意圖完成該無形資產，並加以使用或出售。
- (3)有能力使用或出售該無形資產。
- (4)無形資產將很有可能產生未來經濟效益。
- (5)具充足之技術、財務及其他資源，以完成此項發展，並使用或出售該無形資產。
- (6)歸屬於該無形資產發展階段之支出能可靠衡量。

2.其他無形資產

本公司取得其他無形資產係以成本減除累計攤銷與累計減損衡量之。

3.後續支出

後續支出僅於可增加相關特定資產的未來經濟效益時，方將其資本化。

4.攤銷

攤銷時係以資產成本減除殘值後金額為可攤銷金額，自達可供使用狀態起，按估計耐用年限採直線法攤銷，攤銷數認列於損益。

本公司於每一年度報導日檢視無形資產之殘值、攤銷期間及攤銷方法，若有變動，視為會計估計變動。

(十四)非金融資產減損

針對存貨及遞延所得稅資產以外之非金融資產，本公司於每一報導日評估是否發生減損，就有減損跡象之資產(個別資產或現金產生單位)估計其可回收金額，並就可回收金額低於帳面價值之資產，認列減損損失。於以前年度所認列除商譽以外之累計減損損失，嗣後若已不存在或減少，則迴轉增加帳面價值至可回收金額，惟不超過資產在未認列減損損失下，減除應提列折舊或攤銷之數。

(十五)客戶合約之收入(民國一〇七年一月一日(含)以後適用)

收入係按移轉商品或勞務而預期有權取得之對價衡量。本公司係於對商品或勞務之控制移轉予客戶而滿足履約義務時認列收入。本公司依主要收入項目說明如下：

1.銷售商品

本公司研究、開發、生產、製造及銷售各種積體電路。本公司係於對產品之控制移轉時認列收入。該產品之控制移轉係指產品已交付給客戶，客戶能完全裁決產品之銷售通路及價格，且已無會影響客戶接受該產品之未履行義務。交付係發生於產品運送至特定地點，其陳舊過時及損失風險已移轉予客戶，及客戶已依據銷售訂單接受產品，驗收條款已失效，或本公司有客觀證據認為已滿足所有驗收條件時。

本公司於交付商品時認列應收帳款，因本公司在該時點具無條件收取對價之權利。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

2.財務組成部分

本公司預期所有客戶合約移轉商品或勞務予客戶之時間與客戶為該商品或勞務付款之時間間隔皆不超過一年，因此，本公司不調整交易價格之貨幣時間價值。

(十六)收入認列(民國一〇七年一月一日以前適用)

正常活動中銷售商品所產生之收入，係考量退回、商業折扣及數量折扣後，按已收或應收對價之公允價值衡量。收入係俟具說服力之證據存在、所有權之重大風險及報酬已移轉予買方、價款很有可能收回及相關成本與可能之商品退回能可靠估計、不持續參與商品之管理及收入金額能可靠衡量時加以認列。若折扣很有可能發生且金額能可靠衡量時，則於銷售認列時予以認列作為收入之減項。

風險及報酬移轉之時點係視銷售訂單個別條款而定。

(十七)員工福利

1.確定提撥計畫

確定提撥退休金計畫之提撥義務係於員工提供勞務期間內認列為損益項下之員工福利費用。

2.確定福利計畫

本公司在確定福利退休金計畫下之淨義務係針對福利計畫以員工當期或過去服務所賺得之未來福利金額折算為現值計算。任何計畫資產之公允價值均予以減除。折現率係以到期日與本公司淨義務期限接近，且計價幣別與預期支付福利金相同之政府公債之市場殖利率於財務報導日之利率為主。

企業淨義務每年由精算師以預計單位福利法精算。當計算結果對本公司有利時，認列資產係以未來得以從該計畫退還之資金或減少未來對該計畫之提撥等方式所可獲得經濟效益現值之總額為限。計算經濟效益現值時應考量任何適用於本公司任何計畫之最低資金提撥需求。一項效益若能在計畫期間內或計畫負債清償時實現，對本公司而言，即具有經濟效益。

淨確定福利負債之再衡量數包含(1)精算損益；(2)計畫資產報酬，但不包括包含於淨確定福利負債淨利息之金額；及(3)資產上限影響數之任何變動，但不包括包含於淨確定福利負債淨利息之金額。淨確定福利負債再衡量數認列於其他綜合損益項目下。

3.短期員工福利

短期員工福利義務係以未折現之基礎衡量，且於提供相關服務時認列為費用。

有關短期現金紅利或分紅計畫下預期支付之金額，若係因員工過去提供服務而使本公司負有現時之法定或推定支付義務，且該義務能可靠估計時，將該金額認列為負債。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十八)所得稅

所得稅費用包括當期及遞延所得稅。除與企業合併、直接認列於權益或其他綜合損益之項目相關者外，當期所得稅及遞延所得稅應認列於損益。

當期所得稅包括當年度課稅所得(損失)按報導日之法定稅率或實質性立法稅率計算之預計應付所得稅或應收退稅款，及任何對以前年度應付所得稅的調整。

遞延所得稅係就資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異予以衡量認列。

遞延所得稅係以預期資產實現或負債清償當期之稅率衡量，並以報導日之法定稅率或實質性立法稅率為基礎。

本公司僅於同時符合下列條件時，始將遞延所得稅資產及遞延所得稅負債互抵：

- 1.有法定執行權將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵；且
- 2.遞延所得稅資產及遞延所得稅負債與下列由同一稅捐機關課徵所得稅之納稅主體之一有關；

(1)同一納稅主體；或

(2)不同納稅主體，惟各主體意圖在重大金額之遞延所得稅資產預期回收及遞延所得稅負債預期清償之每一未來期間，將當期所得稅負債及資產以淨額基礎清償，或同時實現資產及清償負債。

對於可遞轉後期之未使用所得稅抵減及可減除暫時性差異，在很有可能有未來課稅所得可供使用之範圍內，認列為遞延所得稅資產。並於每一報導日予以重評估，就相關所得稅利益非屬很有可能實現之範圍內予以調減。

(十九)每股盈餘

本公司列示歸屬於本公司普通股權益持有人之基本及稀釋每股盈餘。基本每股盈餘係以歸屬於本公司普通股權益持有人之損益，除以當期加權平均流通在外普通股股數計算之。稀釋每股盈餘則係將歸屬於本公司普通股權益持有人之損益及加權平均流通在外普通股股數，分別調整所有潛在稀釋普通股之影響後計算之。本公司之潛在稀釋普通股包括本公司尚未經董事會決議且得採股票發放之員工酬勞。因盈餘或資本公積轉增資而新增之股份，採追溯調整計算。

(二十)部門資訊

本公司已於合併財務報告揭露部門資訊，因此個體財務報告不揭露部門資訊。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層依「證券發行人財務報告編製準則」編製本個體財務報告時，必須作出判斷、估計及假設，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費用之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

管理階層持續檢視估計及基本假設，會計估計變動於變動期間及受影響之未來期間予以認列。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

對於假設及估計之不確定性中，存有重大風險將於未來次一年度造成重大調整之相關資訊，請詳下列附註：

存貨之評價

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低衡量，本公司評估報導日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎，故可能因產業快速變遷而產生重大變動。存貨評價估列情形請詳附註六(四)。

本公司之會計政策及揭露包含採用公允價值衡量其金融、非金融資產及負債。本公司之財務部門負責進行公允價值驗證，藉獨立、可靠、且能代表可執行價格之資料使評價結果貼近市場狀態，並定期校準評價模型、進行回溯測試、更新評價模型所需輸入值及資料及其他任何必要之公允價值調整，以確保評價結果係屬合理。

本公司在衡量其資產和負債時，盡可能使用市場可觀察之輸入值。公允價值之等級係以評價技術使用之輸入值為依據，歸類如下：

第一級：相同資產或負債於活絡市場之公開報價(未經調整)。

第二級：除包含於第一級之公開報價外，資產或負債之輸入參數係直接(即價格)或間接(即由價格推導而得)可觀察。

第三級：資產或負債之輸入參數非基於可觀察之市場資料(非可觀察參數)。

若發生公允價值各等級間之移轉事項或情況，本公司係於報導日認列該移轉。衡量公允價值所採用假設之相關資訊請詳附註六(十五)金融工具。

六、重要會計項目之說明

(一)現金及約當現金

	107.12.31	106.12.31
現金及活期存款	\$ 151,095	70,837
定期存款	1,027,673	850,588
	<u>\$ 1,178,768</u>	<u>921,425</u>

(二)透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動

	107.12.31	106.12.31
受益憑證	\$ 486,555	582,902

民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日當權益價格上漲或下跌1%，而其他所有因素維持不變的情況下，民國一〇七年及一〇六年一月一日至十二月三十一日之稅後淨利將分別增加或減少3,892千元及4,838千元。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(三)應收票據及帳款淨額(含關係人)

	107.12.31	106.12.31
應收票據	\$ 278	827
應收帳款	93,180	107,648
應收關係人款	666,537	684,513
	759,995	792,988
減：備抵損失	(10,459)	(7,393)
	<u>\$ 749,536</u>	<u>785,595</u>

本公司民國一〇七年十二月三十一日針對所有應收款項採用簡化作法估計預期信用損失，亦即使用存續期間預期信用損失衡量，為此衡量目的，該等應收款項係按代表客戶依據合約條款支付所有到期金額能力之共同信用風險特性予以分組，並已納入前瞻性之資訊。本公司民國一〇七年十二月三十一日應收款項之預期信用損失分析如下：

	應收款項 帳面金額	加權平均預期 信用損失率	備抵存續期間 預期信用損失
未逾期	\$ 743,494	0.5%~1.5%	7,287
逾期90天以下	2,118	5%	106
合計	<u>\$ 745,612</u>		<u>7,393</u>

個別客戶應收帳款14,383千元，經評估有違約風險，故針對該客戶提列3,066千元預期信用損失。

民國一〇六年十二月三十一日係採用已發生信用損失模式考量應收票據及應收帳款(含關係人)之備抵呆帳。本公司民國一〇六年十二月三十一日無已逾期但未減損之應收票據及應收帳款(含關係人)。

本公司民國一〇七年度及一〇六年度之應收票據及應收帳款之備抵損失變動表如下：

	107年度	106年度 群組評估 之減損損失
期初餘額(依IAS39)	\$ 7,393	<u>7,393</u>
初次適用IFRS 9之調整	-	
期初餘額(依IFRS 9)	7,393	
認列之減損損失	3,066	-
期末餘額	<u>\$ 10,459</u>	

註：民國一〇六年度期末餘額與期初餘額相同。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(四)存貨

	<u>107.12.31</u>	<u>106.12.31</u>
原料及物料	\$ 155,344	101,482
在製品	248,246	216,127
製成品及商品	<u>128,706</u>	<u>169,123</u>
	<u><u>\$ 532,296</u></u>	<u><u>486,732</u></u>

營業成本組成明細如下：

	<u>107年度</u>	<u>106年度</u>
銷貨成本	\$ 2,266,994	2,230,812
報廢成本	<u>7,455</u>	<u>4,535</u>
	<u><u>\$ 2,274,449</u></u>	<u><u>2,235,347</u></u>

(五)其他金融資產－流動

	<u>107.12.31</u>	<u>106.12.31</u>
定期存款(三個月以上)	\$ 559,900	665,700
受限制銀行存款	3,612	3,720
其他	<u>13,240</u>	<u>711</u>
	<u><u>\$ 576,752</u></u>	<u><u>670,131</u></u>

本公司於民國一〇七年度及一〇六年度，針對其他金融資產並無提列減損損失情形。

其餘信用風險資訊請詳附註六(十六)。

(六)採用權益法之投資

本公司於報導日採用權益法之投資列示如下：

	<u>107.12.31</u>	<u>106.12.31</u>
子公司	\$ 1,809,247	1,646,899
減：聯屬公司間未實現交易利得	<u>(172,107)</u>	<u>(138,244)</u>
	<u><u>\$ 1,637,140</u></u>	<u><u>1,508,655</u></u>

子公司相關資訊請參閱民國一〇七年度合併財務報告。

本公司民國一〇七年度及一〇六年度所享有子公司利益之份額分別為170,610千元及147,145千元。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(七)不動產、廠房及設備

本公司不動產、廠房及設備之成本及累計折舊變動明細如下：

	土 地	房 屋 及 建 築	機器設備	其他設備	總 計
成本：					
民國107年1月1日餘額	\$ 26,676	265,663	247,694	42,502	582,535
增添	-	3,319	15,188	995	19,502
處分	-	-	(5,565)	(75)	(5,640)
民國107年12月31日餘額	<u>\$ 26,676</u>	<u>268,982</u>	<u>257,317</u>	<u>43,422</u>	<u>596,397</u>
民國106年1月1日餘額	\$ 26,676	264,352	244,767	46,513	582,308
增添	-	1,311	11,512	7,278	20,101
處分	-	-	(8,585)	(11,289)	(19,874)
民國106年12月31日餘額	<u>\$ 26,676</u>	<u>265,663</u>	<u>247,694</u>	<u>42,502</u>	<u>582,535</u>
累計折舊：					
民國107年1月1日餘額	\$ -	169,688	220,104	27,693	417,485
本期折舊	-	14,133	13,954	5,160	33,247
處分	-	-	(5,508)	(75)	(5,583)
民國107年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>183,821</u>	<u>228,550</u>	<u>32,778</u>	<u>445,149</u>
民國106年1月1日餘額	\$ -	156,236	214,147	34,017	404,400
本期折舊	-	13,452	14,542	4,965	32,959
處分	-	-	(8,585)	(11,289)	(19,874)
民國106年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>169,688</u>	<u>220,104</u>	<u>27,693</u>	<u>417,485</u>
帳面價值：					
民國107年12月31日	<u>\$ 26,676</u>	<u>85,161</u>	<u>28,767</u>	<u>10,644</u>	<u>151,248</u>
民國106年12月31日	<u>\$ 26,676</u>	<u>95,975</u>	<u>27,590</u>	<u>14,809</u>	<u>165,050</u>
民國106年1月1日	<u>\$ 26,676</u>	<u>108,116</u>	<u>30,620</u>	<u>12,496</u>	<u>177,908</u>

(八)營業租賃

- 1.本公司依已簽訂之辦公室、停車位及員工宿舍租賃合約，預估未來最低租金給付額彙列如下：

	107.12.31	106.12.31
一年內	\$ 15,458	6,198
一年至二年	12,885	191
二年以上	5,974	-
	<u>\$ 34,317</u>	<u>6,389</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

- 2.本公司廠房之土地係向科學工業園區管理局承租，租賃期間自民國九十年三月十五日起至民國一〇九年十二月三十一日止，且租賃期間屆滿時得另訂新約。自民國一〇七年二月起租金每年約為3,558千元，如遇政府調整地價時，租金亦隨同調整。

(九)員工福利

1.確定福利計畫

本公司確定福利義務現值與計畫資產公允價值之調節如下：

	<u>107.12.31</u>	<u>106.12.31</u>
確定福利義務現值	\$ 127,611	123,354
計畫資產之公允價值	<u>(51,009)</u>	<u>(50,416)</u>
淨確定福利負債	<u>\$ 76,602</u>	<u>72,938</u>

本公司之確定福利計畫係提撥至台灣銀行之勞工退休準備金專戶。適用勞動基準法之每位員工之退休支付，係依據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算。

(1)計畫資產組成

本公司依勞動基準法提撥之退休基金係由勞動部勞動基金運用局(以下簡稱勞動基金局)統籌管理，依「勞工退休基金收支保管及運用辦法」規定，基金之運用，其每年決算分配之最低收益，不得低於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益。

截至報導日，本公司之台灣銀行勞工退休準備金專戶餘額計51,009千元。勞工退休基金資產運用之資料包括基金收益率以及基金資產配置，請詳勞動基金局網站公布之資訊。

(2)確定福利義務現值之變動

本公司民國一〇七年度及一〇六年度確定福利義務現值變動如下：

	<u>107年度</u>	<u>106年度</u>
1月1日確定福利義務	\$ 123,354	118,013
計畫支付之福利	(4,234)	(1,310)
當期服務成本及利息	1,480	1,770
淨確定福利負債再衡量數		
— 因財務假設變動所產生之精算損失	3,225	4,941
— 因經驗變動所產生之精算損(益)	<u>3,786</u>	<u>(60)</u>
12月31日確定福利義務	<u>\$ 127,611</u>	<u>123,354</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(3)計畫資產公允價值之變動

本公司民國一〇七年度及一〇六年度確定福利計畫資產公允價值之變動如下：

	107年度	106年度
1月1日計畫資產之公允價值	\$ 50,416	48,439
計畫支付之福利	(4,234)	(1,310)
利息收入	622	748
已提撥至計劃之金額	2,812	2,806
淨確定福利負債之再衡量數		
—計劃資產報酬(不含當期利息)	1,393	(267)
12月31日計畫資產之公允價值	<u>\$ 51,009</u>	<u>50,416</u>

(4)認列為損益之費用

本公司民國一〇七年度及一〇六年度認列為損益之費用如下：

	107年度	106年度
淨確定福利負債之淨利息	<u>\$ 858</u>	<u>1,022</u>
營業成本	\$ 57	70
推銷費用	65	79
管理費用	152	185
研究發展費用	584	688
	<u>\$ 858</u>	<u>1,022</u>

(5)認列為其他綜合損益之淨確定福利負債之再衡量數

本公司民國一〇七年度及一〇六年度累計認列於其他綜合損益之淨確定福利負債之再衡量數如下：

	107年度	106年度
1月1日累積餘額	\$ 15,885	10,737
本期認列	5,618	5,148
12月31日累積餘額	<u>\$ 21,503</u>	<u>15,885</u>

(6)精算假設

本公司於年度財務報導期間結束日用以決定確定福利義務現值之重大精算假設如下：

	107.12.31	106.12.31
折現率	1.00 %	1.20 %
未來薪資成長率	2.00 %	2.00 %

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司預計於民國一〇七年度報導日後之一年內支付予確定福利計畫之提撥金額為2,880千元。

確定福利計畫之加權平均存續期間為12.6年。

(7)敏感度分析

民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日，當採用之主要精算假設變動對確定福利義務現值之影響如下：

精算假設	淨確定福利負債	
	增加1%	減少1%
107年12月31日		
折現率	\$ (15,127)	17,814
未來薪資成長率	\$ 16,056	(14,039)
106年12月31日		
折現率	\$ (15,542)	18,433
未來薪資成長率	\$ 16,710	(14,503)

上述之敏感度分析係基於其他假設不變的情況下分析單一假設變動之影響。實務上許多假設的變動則可能是連動的。敏感度分析係與計算資產負債表之淨確定福利負債所採用的方法一致。

本期編製敏感度分析所使用之方法與假設與前期相同。

2.確定提撥計畫

本公司之確定提撥計畫係依勞工退休金條例之規定，依勞工每月工資6%之提繳率，提撥至勞動部勞工保險局(以下簡稱勞工保險局)之勞工退休金個人專戶。在此計畫下本公司提撥固定金額至勞工保險局後，即無支付額外金額之法定或推定義務。本公司民國一〇七年度及一〇六年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為21,105千元及20,056千元，已提撥至勞工保險局。

除上，民國一〇七年度及一〇六年度國外分公司依當地相關法令認列之退休金費用分別為2,247千元及808千元。

(十)所得稅

1.所得稅費用

總統府於民國一〇七年二月七日頒布所得稅法修正案將營利事業所得稅率自民國一〇七年度起由現行17%調高至20%。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司民國一〇七年度及一〇六年度之所得稅費用明細如下：

	<u>107年度</u>	<u>106年度</u>
當期所得稅費用		
當期產生	\$ 138,171	111,687
調整前期之當期所得稅	<u>(3,754)</u>	<u>509</u>
	<u>134,417</u>	<u>112,196</u>
遞延所得稅費用		
暫時性差異之發生及迴轉	23,202	13,481
稅率變動影響數	<u>11,301</u>	<u>-</u>
	<u>34,503</u>	<u>13,481</u>
	<u>\$ 168,920</u>	<u>125,677</u>

本公司民國一〇七年度及一〇六年度認列於其他綜合損益項下之所得稅費用(利益)明細如下：

	<u>107年度</u>	<u>106年度</u>
不重分類至損益之項目：		
確定福利計畫之再衡量數	<u>\$ (1,124)</u>	<u>(875)</u>
後續可能重分類至損益之項目：		
國外營運機構財務報告換算之兌換差額	\$ (3,870)	(1,603)
採用權益法認列關聯企業之國外營運機構 財務報表換算之兌換差額	<u>(120)</u>	<u>78</u>
	<u>\$ (3,990)</u>	<u>(1,525)</u>

本公司所得稅費用與稅前淨利之關係調節如下：

	<u>107年度</u>	<u>106年度</u>
稅前淨利	\$ 1,232,910	1,051,865
依本公司所在地國內稅率計算之所得稅	246,582	178,817
永久性差異調整	(4,459)	(5,796)
免稅所得	(77,572)	(55,078)
投資抵減預期新增數	(2,498)	-
所得基本稅額	-	8,619
稅率變動影響數	11,301	-
其他	<u>(4,434)</u>	<u>(885)</u>
	<u>\$ 168,920</u>	<u>125,677</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

2.遞延所得稅資產及負債變動明細表

遞延所得稅資產

	106.1.1	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	106.12.31	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	107.12.31
存貨跌價損失	\$ 10,200	-	-	10,200	(1,800)	-	12,000
未實現聯屬公司間利益	16,976	(6,525)	-	23,501	(10,920)	-	34,421
淨確定福利負債	11,827	303	(875)	12,399	(1,797)	(1,124)	15,320
國外營運機構財務報表 換算之兌換損失	1,878	-	(1,525)	3,403	-	(3,990)	7,393
其他	199	199	-	-	(572)	-	572
	<u>\$ 41,080</u>	<u>(6,023)</u>	<u>(2,400)</u>	<u>49,503</u>	<u>(15,089)</u>	<u>(5,114)</u>	<u>69,706</u>

遞延所得稅負債

	106.1.1	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	106.12.31	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	107.12.31
採權益法認列之國外投 資利益	\$ (89,704)	19,381	-	(109,085)	49,526	-	(158,611)
其他	(929)	123	-	(1,052)	66	-	(1,118)
	<u>\$ (90,633)</u>	<u>19,504</u>	<u>-</u>	<u>(110,137)</u>	<u>49,592</u>	<u>-</u>	<u>(159,729)</u>

3.本公司營利事業所得稅結算申報已奉稅捐稽徵機關核定至民國一〇四年度。

(十一)資本及其他權益

1.股本

民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日本公司額定股本均為3,000,000千元(均含保留供發行員工認股權憑證200,000千元及可轉換公司債500,000千元之額度)，實收股本均為2,261,682千元，每股面額10元。

2.資本公積

本公司資本公積餘額如下：

	107.12.31	106.12.31
普通股股本溢價	<u>\$ 142,309</u>	<u>142,309</u>

依公司法規定，資本公積需優先填補虧損後，始得以已實現資本公積之全部或一部轉作資本或發放現金。前項所稱之已實現資本公積，包括超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得。依發行人募集與發行有價證券處理準則規定，得撥充資本之資本公積，每年撥充之合計金額，不得超過實收資本額百分之十。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

3.保留盈餘

依本公司章程規定，公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派不低於稅後淨利之百分之五十。

上述股東股利部份，其中現金股利不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股利合計數之百分之五十。

(1)法定盈餘公積

依公司法規定，公司應就稅後純益提撥百分之十為法定盈餘公積，直至與資本總額相等為止。公司無虧損時，得經股東會決議，以法定盈餘公積發給新股或現金，惟以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

(2)特別盈餘公積

本公司於首次採用金管會認可之國際財務報導準則時，因選擇適用國際財務報導準則第一號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目，調整帳列股東權益項下之累積換算調整數而增加保留盈餘之金額為18,008千元；另就轉換日之精算損益調整減列保留盈餘13,410千元。依金管會民國一〇一年四月六日金管證發字第1010012865號令規定，應就因轉換採用金管會認可之國際財務報導準則產生之保留盈餘淨增加數4,598千元提列特別盈餘公積，並於使用、處分或重分類相關資產時，得就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉分派盈餘。本公司轉投資之海外子公司盛揚半導體(深圳)有限公司已於民國一〇三年八月完成清算各項權利義務及註銷登記，本公司依據前述函令規定，就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉特別盈餘公積併入保留盈餘計1,956千元。截至民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日止，該項特別盈餘公積餘額均為2,642千元。

又依上段所述函令規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額與上段所提列特別盈餘公積餘額之差額，自當期損益與前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

(3)盈餘分派

本公司民國一〇六年度及一〇五年度盈餘分派案，分別於民國一〇七年五月二十八日及一〇六年五月二十六日經股東常會決議，分派予業主之股利如下：

	106年度		105年度	
	每股股利 (元)	金額	每股股利 (元)	金額
分派予普通股業主之現金股利	\$ 4.10	927,290	3.50	791,589

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十二)每股盈餘

本公司每股盈餘之計算列示如下：

	<u>107年度</u>	<u>106年度</u>
基本每股盈餘：		
本期淨利	\$ <u>1,063,990</u>	<u>926,188</u>
計算每股盈餘之加權平均流通在外股數(千股)	<u>226,168</u>	<u>226,168</u>
基本每股盈餘(元)	\$ <u>4.70</u>	<u>4.10</u>
稀釋每股盈餘：		
本期淨利	\$ <u>1,063,990</u>	<u>926,188</u>
加權平均流通在外股數(千股)	226,168	226,168
具稀釋作用潛在普通股之影響(千股)		
員工酬勞	<u>2,335</u>	<u>1,746</u>
計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數(千股)	<u>228,503</u>	<u>227,914</u>
稀釋每股盈餘(元)	\$ <u>4.66</u>	<u>4.06</u>

(十三)員工及董事酬勞

依本公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一・五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

本公司民國一〇七年度及一〇六年度員工酬勞估列金額分別為129,225千元及111,567千元，董事酬勞估列金額分別為14,248千元及12,286千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之金額乘上本公司章程所訂之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為民國一〇七年度及一〇六年度之營業成本或營業費用。若次年度實際分派金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，將該變動之差異認列為次年度損益。如董事會決議採股票發放員工酬勞，股票酬勞之股數計算基礎係依據董事會決議日前一日之收盤價。

本公司民國一〇六年度及一〇五年度員工酬勞提列金額分別為111,567千元及94,738千元，董事酬勞提列金額分別為12,286千元及10,526千元，皆係以現金發放，其中民國一〇六年度以董事酬勞科目發放12,176千元，差異係估列計算之差異；民國一〇五年度以董事酬勞科目發放金額為10,416千元，差異係帳列科目調整，相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十四)客戶合約之收入

1.收入之細分

	<u>107年度</u>
主要地區市場	
中國	\$ 3,331,122
臺灣	570,137
其他國家	<u>457,499</u>
	<u><u>\$ 4,358,758</u></u>
主要產品	
積體電路銷售	\$ 4,296,835
設計收入及其他	<u>61,923</u>
	<u><u>\$ 4,358,758</u></u>

2.合約餘額

應收帳款及其減損之揭露請詳附註六(三)。

(十五)營業外收入及支出

綜合損益表所列之其他利益及損失明細如下：

	<u>107年度</u>	<u>106年度</u>
外幣兌換(損失)利益	\$ (3,977)	14,267
其他	<u>5,595</u>	<u>2,899</u>
	<u><u>\$ 1,618</u></u>	<u><u>17,166</u></u>

(十六)金融工具

1.信用風險

(1)信用風險之暴險

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日之最大信用暴險金額分別為2,997,897千元及2,965,615千元。

本公司之潛在信用風險係源自金融資產交易對方或他方未履行合約之潛在影響，主要來自於本公司之現金及約當現金、約定期間三個月以上之定期存款及應收客戶之帳款。

本公司之現金及約當現金及定期存款存放於信用良好之銀行，發生信用風險可能性低。

本公司主要銷售對象為國內外信譽良好之公司，除依授信作業程序給予客戶信用額度外，並持續了解客戶之信用狀況，民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日估本公司應收票據及帳款(含關係人)10%以上客戶之帳款金額分別為410,501千元及308,859千元，使本公司有應收帳款信用風險集中之情形，惟已定期評估應收帳款之回收可能性並提列適當備抵損失，管理當局預期未來不致有重大損失。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(2)應收款項及債務證券之信用風險

應收票據及帳款之信用曝險資訊請詳附註六(三)。

其他按攤銷後成本衡量之金融資產包括三個月以上定期存款及受限制銀行存款等，相關明細及減損提列情形請詳附註六(五)。

上開均為信用風險低之金融資產，因此按十二個月預期信用損失金額衡量該期間之備抵損失(本公司如何判定信用風險低之說明請詳附註四(六))。

2.流動性風險

除應付薪資及其他流動負債項下之應付費用外，其餘之金融負債之合約到期日分析：

	帳面金額	合 約 現金流量	1年以內	超過1年
107年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 575,059	575,059	575,059	-
存入保證金	8,542	8,542	-	8,542
	<u>\$ 583,601</u>	<u>583,601</u>	<u>575,059</u>	<u>8,542</u>
106年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 557,480	557,480	557,480	-
存入保證金	8,542	8,542	-	8,542
	<u>\$ 566,022</u>	<u>566,022</u>	<u>557,480</u>	<u>8,542</u>

本公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

3.市場風險

匯率風險

(1)匯率風險之暴險

本公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	107.12.31			106.12.31		
	外幣	匯率	台幣	外幣	匯率	台幣
<u>金融資產</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美 金	\$ 10,924	30.665	334,987	6,405	29.71	190,291
人民幣	162,242	4.4459	721,313	143,985	4.5394	653,605
<u>非貨幣性項目</u>						
美 金	\$ 42,996	30.665	1,318,474	40,708	29.71	1,209,424

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

	107.12.31			106.12.31		
	外幣	匯率	台幣	外幣	匯率	台幣
金融負債						
貨幣性項目						
美金	\$ 9,311	30.665	285,533	8,081	29.71	240,082
人民幣	13,886	4.4459	61,737	14,933	4.5394	67,786

(2) 敏感性分析

本公司之匯率風險主要來自於以外幣計價之現金、應收帳款、其他應收款及應付帳款等，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日當新台幣相對於美金及人民幣貶值或升值1%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一〇七年度及一〇六年度之稅後淨利將分別增加或減少5,672千元及4,449千元。

(3) 貨幣性項目之兌換損益

由於本公司使用貨幣種類繁多，故採彙整方式揭露貨幣性項目之兌換損益資訊，民國一〇七年度及一〇六年度外幣兌換(損失)利益淨額(含已實現及未實現)分別為(3,977)千元及14,267千元。

4. 公允價值資訊

(1) 金融工具之種類及公允價值

本公司透過損益按公允價值衡量之金融資產係以重複性為基礎按公允價值衡量。各種類金融資產及金融負債之帳面金額及公允價值(包括公允價值等級資訊，但非按公允價值衡量金融工具之帳面金額為公允價值之合理近似值者，及於活絡市場無報價且公允價值無法可靠衡量之權益工具投資，依規定無須揭露公允價值資訊)列示如下：

	107.12.31				
	帳面價值	公 允 價 值			合 計
		第一級	第二級	第三級	
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	\$ 486,555	486,555	-	-	486,555
按攤銷後成本衡量之金融資產					
現金及約當現金	1,178,768	-	-	-	-
應收票據及帳款淨額(含關係人)	749,536	-	-	-	-
其他金融資產—流動	576,752	-	-	-	-
存出保證金(帳列其他非流動資產)	6,286	-	-	-	-
	<u>\$ 2,997,897</u>	<u>486,555</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>486,555</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

按攤銷後成本衡量之金融負債

應付票據及帳款(含關係人)

\$ 575,059	-	-	-	-
8,542	-	-	-	-
\$ 583,601	-	-	-	-

106.12.31

透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動放款及應收款	公 允 價 值				合 計
	帳面價值	第一級	第二級	第三級	
現金及約當現金	\$ 582,902	582,902	-	-	582,902
應收票據及帳款淨額(含關係人)	921,425	-	-	-	-
其他金融資產—流動	785,595	-	-	-	-
存出保證金(帳列其他非流動資產)	670,131	-	-	-	-
	5,562	-	-	-	-
	\$ 2,965,615	582,902	-	-	582,902

按攤銷後成本衡量之金融負債

應付票據及帳款(含關係人)

\$ 557,480	-	-	-	-
8,542	-	-	-	-
\$ 566,022	-	-	-	-

(2)按公允價值衡量金融工具之公允價值評價技術

本公司持有之受益憑證係具有標準條款與條件並於活絡市場交易之金融資產，其公允價值係參照市場報價決定。

(3)民國一〇七年度及一〇六年度間並無任何公允價值等級移轉情形。

(十七)財務風險管理

1.概 要

本公司因金融工具之使用而暴露於下列風險：

- (1)信用風險
- (2)流動性風險
- (3)市場風險

本附註表達本公司上述各項風險之暴險資訊、本公司衡量及管理風險之目標、政策及程序。進一步量化揭露請詳附註六(十六)。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

2.風險管理架構

董事會全權負責發展及控管本公司之風險管理政策。

本公司之風險管理政策之建置係為辨認及分析本公司所面臨之風險，及設定適當風險限額及控制，並監督風險及風險限額之遵循。風險管理政策及系統係定期覆核以反映市場情況及本公司運作之變化。本公司透過訓練、管理準則及作業程序，以發展有紀律且具建設性之控制環境，使所有員工了解其角色及義務。

本公司之董事會監督管理階層如何監控本公司風險管理政策及程序之遵循，及覆核本公司對於所面臨風險之相關風險管理架構之適當性。內部稽核人員協助董事會扮演監督角色。該等人員進行定期及例外覆核風險管理控制及程序，並將覆核結果報告予董事會。

3.信用風險

信用風險係本公司因客戶或金融工具之交易對手無法履行合約義務而產生財務損失之風險，主要來自於本公司現金及約當現金及應收客戶之帳款。

有關現金及約當現金、應收款項之信用風險分析，請詳附註六(十六)。另，截至民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日止，本公司均無提供任何背書保證。

4.流動性風險

流動性風險係本公司無法交付現金或其他金融資產以清償金融負債，未能履行相關義務之風險。本公司管理流動性之方法係盡可能確保本公司在一般及具壓力之情況下，皆有足夠之流動資金以支應到期之負債，而不致發生不可接受之損失或使本公司之聲譽遭受到損害之風險。

流動性風險係由本公司之財務部門所監控，持續監督本公司實際現金流量部位，並使用多方面的資訊，預測並監控本公司在長期與短期之現金流動部位，財務部門並投資額外之現金於適當到期日之存款或短期性投資，並確保本公司之流動性，足以因應即將到期之負債。截至民國一〇七年十二月三十一日止，本公司之營運資金及目前尚有銀行未動支之借款額度153,575千元，應足以支應履行所有合約義務，故未有無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

5.市場風險

市場風險係指因市價變動，如匯率、利率、權益工具價格變動，而影響本公司之收益或所持有金融工具價值之風險。市場風險管理之目標係管控市場風險之暴險程度在可承受範圍內，並將投資報酬最佳化。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司為管理市場匯率及受益憑證價格變動風險，所有重大交易之執行均經董事會之覆核與核准，相關財務操作亦受內部稽核部門之監督。相關之管理說明如下：

(1)本公司暴露於非以功能性貨幣計價之銷售及採購交易所產生之匯率風險。該等交易主要之計價貨幣有美元及人民幣。

有關外幣計價之貨幣性資產及負債，當發生短期不平衡時，本公司係藉由以即時匯率買進或賣出外幣，以確保淨暴險保持在可接受之水準。

(2)投資組合中重大投資均採個別管理，且所有買賣決策均經董事會之核准。

(十八)資本管理

董事會管理資本之目標係確保本公司於繼續經營與成長之前提下，藉由將債務及權益餘額最適化，以提供股東足夠之報酬。

董事會之資本結構管理策略，係依據本公司所營事業之產業規模、產業未來之成本與產品發展藍圖，以設定本公司適當之市場佔有率，並據以規劃所需之營運資金與現金，以對本公司長期發展所需之各項資產規模，做出整體性之規劃；最後根據本公司產品競爭力推估可能之產品邊際貢獻、營業利益率與現金流量，並考量產業景氣循環波動、產品生命週期等風險因素，以決定本公司適當之資本結構。

董事會定期審核資本結構，並考量不同資本結構可能涉及之成本與風險。

截至民國一〇七年十二月三十一日止，本公司資本管理之方式並未改變。

本公司於報導日之負債權益比率如下：

	107.12.31	106.12.31
負債總額	\$ <u>1,247,665</u>	<u>1,159,631</u>
權益總額	\$ <u>4,199,170</u>	<u>4,071,239</u>
負債權益比率	<u>29.71%</u>	<u>28.48%</u>

七、關係人交易

(一)關係人名稱及關係

於本個體財務報告之涵蓋期間內本公司之子公司及其他與本公司有交易之關係人如下：

關係人名稱	與本公司之關係
MCU Holdings Ltd. (MCU)	本公司之合併子公司
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Holtek BVI)	本公司之合併子公司
Sigmos Holdings Ltd. (Sigmos)	本公司之合併子公司
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Kingtek BVI)	本公司之合併子公司
盛凌投資股份有限公司(盛凌投資)	本公司之合併子公司

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

關係人名稱	與本公司之關係
Best Health Electronics Corp. (Best Health)	本公司之合併子公司
悠健電子(東莞)有限公司(悠健)	本公司之合併子公司
Anchip Technology Corporation (Anchip)	本公司之合併子公司
安禧普電子科技(東莞)有限公司(安禧普)	本公司之合併子公司
Best Power Electronics Corp. (Best Power)	本公司之合併子公司
芯群集成電路(廈門)有限公司(芯群)	本公司之合併子公司
合泰半導體(中國)有限公司(合泰)	本公司之合併子公司
Holtek Semiconductor (USA) Inc. (Holtek (USA))	本公司之合併子公司
金科集成電路(蘇州)有限公司(金科)	本公司之合併子公司
Holtek Semiconductor (INDIA) Private Ltd. (Holtek INDIA)	本公司之合併子公司
優方科技股份有限公司(優方)	本公司之合併子公司
Best Solution Electronics Inc. (Best Solution)	本公司之合併子公司
倍創科技股份有限公司(倍創)	本公司之合併子公司
盛通科技股份有限公司(盛通)	本公司之合併子公司
BestComm RF Electronics Inc. (BestComm)	本公司之合併子公司
芯通電子科技(東莞)有限公司	本公司之合併子公司
Crown Rich Technology Holding Ltd.(Crown Rich)	本公司之關聯企業
Fine Chip Electronics Inc.(Fine Chip)	本公司之關聯企業
ForIC Electronics Holding Ltd.(ForIC)	本公司之關聯企業
JXY Electronics Corporation(JXY)	本公司之關聯企業
New Wave Electronics Holding Ltd.(New Wave)	本公司之關聯企業
Newtek Electronics Ltd.(Newtek)	本公司之關聯企業
Quanding Technology Holding Ltd.(Quanding)	本公司之關聯企業
Santek Holdings Ltd.(Santek)	本公司之關聯企業
Truetek Technology Ltd.(Truetek)	本公司之關聯企業
Bestway Electronic Inc.(Bestway)	本公司之關聯企業
欣宏電子股份有限公司(欣宏)	本公司之關聯企業
金濤高科有限公司(金濤)	本公司之關聯企業
泓達科技有限公司(泓達)	本公司之關聯企業
高聖科技股份有限公司(高聖)	本公司之關聯企業
鉛威科技股份有限公司(鉛威)	本公司之關聯企業

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(二)與關係人間之重大交易事項

1.銷售

本公司對關係人之重大銷售金額如下：

	<u>107年度</u>	<u>106年度</u>
HOLTEK(BVI)	\$ 784,925	725,672
欣宏合併子公司	512,531	432,002
優方合併子公司	455,152	380,298
其他	<u>1,601,100</u>	<u>1,576,916</u>
	<u>\$ 3,353,708</u>	<u>3,114,888</u>

本公司之銷售價格依銷售之產品規格而定，並視銷售之數量給予不定幅度之折扣；銷售予關係人之收款條件約為月結60天至90天。本公司與一般客戶之銷售交易收款條件則視個別客戶之交易往來經驗及債信評估結果決定採預收貨款、即期電匯或月結30天至60天不等。

民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日止本公司與採權益法評價之被投資公司間因銷貨交易所產生之未實現銷貨毛利分別為172,043千元及138,115千元，帳列採用權益法之投資項下。

本公司因上述銷貨交易產生之應收關係人款項明細如下：

	<u>107.12.31</u>	<u>106.12.31</u>
HOLTEK(BVI)	\$ 220,903	216,424
欣宏合併子公司	96,514	92,435
優方合併子公司	93,263	67,292
其他	<u>255,857</u>	<u>308,362</u>
	<u>\$ 666,537</u>	<u>684,513</u>

2.進貨

本公司向關係人進貨金額如下：

	<u>107年度</u>	<u>106年度</u>
合併子公司	\$ 9,447	11,349
關聯企業	<u>-</u>	<u>584</u>
	<u>\$ 9,447</u>	<u>11,933</u>

本公司與關係人間之進貨交易條件與一般供應商尚無明顯不同。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司委託關係人提供積體電路銷售服務支出金額如下：

	<u>107年度</u>	<u>106年度</u>
合併子公司	\$ 15,584	18,884
關聯企業	<u>13</u>	<u>492</u>
	<u><u>\$ 15,597</u></u>	<u><u>19,376</u></u>

本公司因上述進貨及其他交易產生之應付款項如下：

	<u>107.12.31</u>	<u>106.12.31</u>
應付帳款-合併子公司(帳列應付帳款-關係人)	\$ 4,816	7,331
其他應付款-關聯企業(帳列其他流動負債)	<u>17,630</u>	<u>-</u>
	<u><u>\$ 22,446</u></u>	<u><u>7,331</u></u>

3.其他交易

民國一〇七年及一〇六年十二月三十一日，本公司因出售機器設備予金科及合泰所產生之未實現利益分別為64千元129千元，帳列採權益法之投資項下。

(三)主要管理人員交易

主要管理人員報酬如下：

	<u>107年度</u>	<u>106年度</u>
短期員工福利	\$ 28,073	23,692
退職後福利	<u>432</u>	<u>432</u>
	<u><u>\$ 28,505</u></u>	<u><u>24,124</u></u>

八、質押之資產

<u>資產名稱</u>	<u>質押擔保標的</u>	<u>107.12.31</u>	<u>106.12.31</u>
定期存款(帳列其他金融資產—流動)	進口關稅保證金	<u><u>\$ 3,612</u></u>	<u><u>3,720</u></u>

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

本公司與ARM公司等簽有技術授權合約，合約中訂定當本公司銷售之產品若有運用約定技術時，需依雙方議定價格支付權利金。

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

十二、其 他

員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總如下：

功 能 別 性 質 別	107年度			106年度		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	30,468	569,315	599,783	31,114	541,973	573,087
勞健保費用	2,227	34,307	36,534	2,235	32,216	34,451
退休金費用	1,595	22,615	24,210	1,475	20,411	21,886
董事酬金	-	14,138	14,138	-	12,176	12,176
其他員工福利費用	1,430	16,942	18,372	1,398	16,383	17,781
折舊費用	2,753	30,494	33,247	4,894	28,065	32,959
攤銷費用	-	54,186	54,186	-	69,433	69,433

本公司民國一〇七年度及一〇六年度之員工人數分別為407人及401人，其中未兼任員工之董事人數分別為4人及4人。

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

民國一〇七年度本公司依證券發行人財務報告編製準則之規定，應再揭露之重大交易事項相關資訊如下：

- 1.資金貸與他人：無。
- 2.為他人背書保證：無。
- 3.期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)：

數量單位：千股(單位)

持有之 公 司	有價證券 種類及名稱	與有價證券 發行人之關係	帳列科目	期 末				備註
				股 數	帳面金額	持股比率	公允價值	
本公司	第一金台灣貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值 衡量之金融資產－流動	13,545	206,914	-	206,914	
本公司	統一強棒貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值 衡量之金融資產－流動	16,550	276,151	-	276,151	
本公司	元大得寶貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值 衡量之金融資產－流動	291	3,490	-	3,490	
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	Unitech Capital Inc.	-	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權益 工具之投資－非流動	2,500	60,848	5.00 %	-	
盛凌投資股份有限公司	譜永投資股份有限公司	-	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權益 工具之投資－非流動	23,124	161,110	3.03 %	-	
盛凌投資股份有限公司	金信科技股份有限公司	-	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權益 工具之投資－非流動	3,330	43,203	13.59 %	-	

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期 初		買 入		賣 出				期 末	
					單位數	金額	單位數	金額	單位數	售價	帳面成本	處分損益	單位數	金額
本公司	統一強棒貨幣市場基金	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	統一投信	-	6,342	105,208	36,738	611,500	26,530	441,890	441,232	658	16,550	275,476 (註)

註：期末金額係取得成本，依市價評價後之帳面金額請詳3。

5. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
6. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關 係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金 額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單 價	授信期間	餘 額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	Holtek BVI	本公司之子公司	銷貨	(784,925)	(18) %	月結90天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	220,903	29 %	(註)
Holtek BVI	本公司	Holtek BVI之母公司	進貨	784,925	100 %	月結90天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(220,903)	(99) %	(註)
本公司	欣宏	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(512,531)	(12) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	96,514	13 %	
欣宏	本公司	對欣宏採權益法評價之投資公司	進貨	512,531	57 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(96,514)	(66) %	
本公司	優方	本公司之子公司	銷貨	(455,152)	(10) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	93,263	12 %	(註)
優方	本公司	優方之母公司	進貨	455,152	100 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(93,263)	(100) %	(註)
本公司	ForIC	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(127,791)	(3) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	16,519	2 %	
ForIC	本公司	對ForIC採權益法評價之投資公司	進貨	127,791	66 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(16,519)	(36) %	
本公司	Newtek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(246,166)	(6) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	32,506	4 %	
Newtek	本公司	對Newtek採權益法評價之投資公司	進貨	246,166	59 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(32,506)	(40) %	
本公司	Crown Rich	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(233,591)	(5) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	32,052	4 %	
Crown Rich	本公司	對Crown Rich採權益法評價之投資公司	進貨	233,591	36 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(32,052)	(22) %	
本公司	鈺威	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(148,581)	(3) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	23,260	3 %	
鈺威	本公司	對鈺威採權益法評價之投資公司	進貨	148,581	7 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(23,260)	(12) %	

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

進(銷)貨 之公司	交易 對象 名稱	關 係	交易情形				交易條件與一般交易 不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進 (銷) 貨	金 額	佔總進 (銷)貨 之比率	授信 期間	單 價	授信期間	餘 額	佔總應收 (付)票據、 帳款之比率	
本公司	New Wave	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(228,132)	(5) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	31,865	4 %	
New Wave	本公司	對New Wave採權益法評價之投資公司	進貨	228,132	51 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(31,865)	(39) %	
本公司	Truetek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(153,335)	(4) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	23,984	3 %	
Truetek	本公司	對Truetek採權益法評價之投資公司	進貨	153,335	41 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(23,984)	(27) %	
本公司	Santek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(155,310)	(4) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	47,820	6 %	
Santek	本公司	對Santek採權益法評價之投資公司	進貨	155,310	78 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(47,820)	(78) %	

註：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

8.應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元

帳列應收款項 之 公 司	交易對象 名 稱	關 係	應收關係人 款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項 期後收回金額	提列備抵 銷售金額
					金 額	處理方式		
本公司	Holtek BVI	子公司	220,903 (註2)	3.59	-	即期收款	37,715 (註1)	-

註1：係截至民國一〇八年一月十八日止收回之金額。

註2：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

9.從事衍生性商品交易：無。

(二)轉投資事業相關資訊：

民國一〇七年度本公司之轉投資事業資訊如下(不包含大陸被投資公司)：

投資公司 名 稱	被投資公司 名 稱	所 在 地 區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
本公司	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	475,831	475,831	15,253	100.00 %	524,475	43,268	43,268 註2	本公司之子公司
本公司	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	69,542	69,542	2,000	100.00 %	120,725	1,632	1,632 註2	本公司之子公司
本公司	Sigmos Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	6,898	6,898	200	100.00 %	22,811	231	231 註2	本公司之子公司
Sigmos Holdings Ltd.	Holtek Semiconductor (USA) Inc.	美國加州	積體電路買賣及技術服務	6,898	6,898	2,000	100.00 %	22,811	231	註1,2	本公司之孫公司
本公司	MCU Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	16,333	16,333	500	100.00 %	650,461	106,251	106,251 註2	本公司之子公司

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
MCU Holdings Ltd.	ForIC Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件之技術支持與諮詢服務	9,733	9,733	300	40.00 %	23,302	3,025	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
ForIC Electronics Holding Ltd.	E-Micro Technology Holding Ltd. (BVI)	B.V.I.	投資海外各項事業	9,473	9,473	300	100.00 %	10,084	1,641	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Truetek Technology Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	16,306	16,306	920	40.00 %	49,594	26,880	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Quanding Technology Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件之技術支持與諮詢服務	1,868	1,868	60	40.00 %	18,746	14,777	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Santek Holdings Ltd.	B.V.I.	投資並提供電子元器件與單片機蕊片之應用與技術諮詢	3,758	3,758	180	40.00 %	22,651	23,354	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Bestway Electronic Inc.	B.V.I.	電子零件之銷售及技術服務	3,470	3,470	800	40.00 %	22,696	11,249	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	New Wave Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	24,784	24,784	800	40.00 %	67,736	36,491	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Newtek Electronics Ltd.	B.V.I.	投資並提供電子元器件與單片機蕊片之應用與技術諮詢	8,105	8,105	1,501	40.61 %	68,739	32,072	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Crown Rich Technology Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件之技術支持與諮詢服務	2,641	2,641	80	40.00 %	61,590	49,270	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Fine Chip Electronics Inc.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件之技術支持與諮詢服務	7,039	7,039	1	40.00 %	2,371	(2,960)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Anchip Technology Corporation	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件之技術支持與諮詢服務	2,937	2,937	1	60.00 %	2,522	1,438	註1,2	本公司之孫公司
MCU Holdings Ltd.	金濟高科有限公司	香港	電子零件之銷售及技術服務	9,907	9,907	2,400	40.00 %	18,452	4,072	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
MCU Holdings Ltd.	泓達科技有限 公司	香港	電子零件 設計及銷 售	5,427	5,427	1,275	33.33 %	8,144	1,015	註1	本公司之 子公司採權 益法評價之 被投資公司
MCU Holdings Ltd.	JXY Electronics Corporation	B.V.I.	電子元器 件及單片 機蕊件之 技術支持 與諮詢服 務	3,664	3,664	1	40.00 %	3,268	934	註1	本公司之 子公司採權 益法評價之 被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Best Health Electronics Corporation	B.V.I.	電子元器 件及單片 機蕊件之 技術支持 與諮詢服 務	20,965	20,965	5	80.00 %	22,669	1,755	註1,2	本公司之 孫公司
MCU Holdings Ltd.	Best Power Electronics Corporation	B.V.I.	電子元器 件及單片 機蕊件之 技術支持 與諮詢服 務	8,844	-	2	100.00 %	8,940	(48)	註1,2	本公司之 孫公司
本公司	Holtek Semiconductor (India) Private Limited	INDIA	電子元器 件及單片 機蕊件之 技術支持 與諮詢服 務	3	-	6	0.10 %	2	(1,186)	(1) 註2	本公司之 孫公司
本公司	盛凌投資股份 有限公司	新竹市	專營投資 業務	429,826	400,000	42,983	100.00 %	490,773	19,229	19,229 註2	本公司之 子公司
盛凌投資股份 有限公司	欣宏電子股份 有限公司	台北市	電子零組 件製造/批 發/零售	95,940	89,140	7,880	40.00 %	116,854	26,731	註1	本公司之 子公司採權 益法評價之 被投資公司
欣宏電子股份 有限公司	A-ONE Wireless Technology Corp.	B.V.I.	電子零組 件製造/批 發/零售	59,204	59,204	2,000	100.00 %	90,082	10,674	註1	本公司之 子公司採權 益法評價之 被投資公司 轉投資之 子公司
欣宏電子股份 有限公司	INNOTEK ELECTRONICS INC.	B.V.I.	電子元器 件及單片 機蕊件之 技術支持 與諮詢服 務	43,810	43,810	800	100.00 %	41,289	8,737	註1	本公司之 子公司採權 益法評價之 被投資公司 轉投資之 子公司
欣宏電子股份 有限公司	優方科技股份 有限公司	台北市	電子零組 件製造、 電子材料 批發零售 、電腦 及其週邊 設備製 造、資訊 軟體服 務及國 際貿易	7,375	7,375	738	36.88 %	14,326	12,044	註1	本公司之 孫公司
盛凌投資股份 有限公司	鈺威科技股份 有限公司	新北市	電子零組 件加工製 造、買賣 進出口	37,500	37,500	5,641	22.39 %	69,322	24,750	註1	本公司之 子公司採權 益法評價之 被投資公司

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
盛凌投資股份 有限公司	高聖科技股份 有限公司	新北市	電子零組 件製造、 電子材料 批發零售、電信 器材批發 零售、電 腦及其週 邊設備製 造、資訊 軟體服務 及國際貿 易	2,350	2,350	235	39.17 %	2,821	1,555	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
盛凌投資股份 有限公司	優方科技股份 有限公司	台北市	電子零組 件製造、 電子材料 批發零售、電腦 及其週邊 設備製 造、資訊 軟體服務 及國際貿 易	8,000	8,000	800	40.00 %	15,540	12,044	註1,2	本公司之孫公司
優方科技股份 有限公司	Best Solution Electronics Inc.	B.V.I.	電子元器 件、電子 材料批發	6,140	6,140	200	100.00 %	40,543	15,636	註1,2	本公司之孫公司投資之子公司
盛凌投資股份 有限公司	天宇微機電股 份有限公司	新竹市	電子零組 件製造、 電子材料 批發零售、電信 器材批發 零售、智 慧財產權 業、資訊 軟體服務 及國際貿 易	10,002	10,002	380	20.00 %	-	611	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
盛凌投資股份 有限公司	盛通科技股份 有限公司	新竹市	電子零組 件製造、 電子材料 批發零售、國際 貿易業及 資訊軟體 服務	40,000	40,000	4,000	100.00 %	21,662	(3,356)	註1,2	本公司之孫公司
盛通科技股份 有限公司	BestComm RF Electronics Inc.	B.V.I.	電子零組 件製造/批 發/零售	14,054	14,054	30	100.00 %	10,788	434	註1,2	本公司之孫公司投資之子公司
盛凌投資股份 有限公司	倍創科技股份 有限公司	新竹市	電子零組 件製造、 電子材料 批發、無 店面零售 業、國際 貿易業	10,000	10,000	1,000	100.00 %	9,895	(41)	註1,2	本公司之孫公司
盛凌投資股份 有限公司	Holtek Semiconductor (India) Private Limited	INDIA	電子元器 件及單片 機晶片之 技術支持 與諮詢服 務業務	2,945	-	6,479	99.90 %	1,654	(1,186)	註1,2	本公司之孫公司

註1：對各該公司投資損益之認列已分別包含於對子公司或孫公司之投資損益中。

註2：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(三)大陸投資資訊：

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益(註5)	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回						
芯群集成電路(廈門)有限公司	積體電路買賣及技術服務	113,551	(註1)	101,027	-	-	101,027	531	100 %	531	113,289	-
合泰半導體(中國)有限公司	集成電路、電子元器件及單片機晶片之批發及進出口業務與諮詢服務業務	292,423	(註1)	272,221	-	-	272,221	35,312	100 %	35,312	326,434	-
新緯科技(深圳)有限公司	電子零件銷售及售後服務	6,769	(註1)	3,383	-	-	3,383	3,483	40 %	1,393	17,940	-
新禾(廈門)電子有限公司	電子元器件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	6,398	(註1)	2,506	-	-	2,506	1,171	40 %	468	19,773	-
諾華達電子(深圳)有限公司	電子元器件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	9,287	(註1)	3,928	-	-	3,928	7,893	40 %	3,157	22,146	-
華榮匯電子科技(北京)有限公司	電子元器件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	19,361	(註1)	3,601	-	-	3,601	(6,091)	40 %	(2,436)	16,106	-
振揚電子(青島)有限公司	電子元器件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	6,315	(註1)	2,634	-	-	2,634	633	40 %	253	6,647	-
新鼎電子(深圳)有限公司	電子元器件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	6,699	(註1)	2,647	-	-	2,647	6,179	40.61 %	2,509	29,383	-
信霖電子商貿(上海)有限公司	電子元器件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	30,293	(註1)	3,911	-	-	3,911	5,786	40 %	2,314	48,358	-
華瑞昇電子(深圳)有限公司	電子元器件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	4,952	(註1)	1,964	-	-	1,964	27,034	40 %	10,814	60,116	-
全鼎電子(蘇州)有限公司	電子元器件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	3,736	(註1)	1,600	-	-	1,600	2,236	40 %	894	18,345	-
金科集成電路(蘇州)有限公司	電子零件銷售及售後服務	69,712	(註1)	69,712	-	-	69,712	1,630	100 %	1,630	120,685	-
健芳電子科技(上海)有限公司	電子元器件及單片機晶片技術研發與諮詢服務	7,541	(註1)	-	-	-	-	(1,197)	40 %	(479)	2,836	-
安禧普電子科技(東莞)有限公司	電子元器件及單片機晶片技術研發與諮詢服務	1,521	(註1)	-	-	-	-	(647)	60 %	(388)	641	-

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益(註5)	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
		資本額			匯出	收回						
集芯源電子科技有限公司	電子元器件及單片機芯片技術研發與諮詢服務	6,843	(註1)	-	-	-	-	(2,287)	40 %	(915)	4,407	-
悠健電子(東莞)有限公司	電子元器件及單片機芯片技術研發與諮詢服務	23,057	(註1)	-	-	-	-	(5,930)	80 %	(4,744)	15,110	-
芯通電子科技(東莞)有限公司	集成電路、電子元器件、單片機芯片的技術研發、技術服務及銷售	9,214	(註1)	-	9,392	-	9,392	(2,574)	100 %	(2,574)	6,351	-

2. 轉投資大陸地區限額：

本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額(註2)	經濟部投審會核准投資金額(註3)	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額
480,481 (美金15,425千元)	547,438 (美金17,853千元)	2,519,502 (註4)

註1：透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

註2：累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額係依實際匯出之歷史匯率換算之新台幣金額；該金額包含盛通本期期末累計自台灣匯出之投資金額9,392千元(美金314千元)。

註3：經濟部投審會核准投資金額係以報導日匯率換算新台幣金額；該金額係包括核准自台灣匯出投資金額計461,620千元(美金15,054千元)、第三地區之盈餘轉增資金額計76,205千元(美金2,485千元)及盛通核准自台灣匯出投資金額計9,613千元(美金314千元)。

註4：依「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定，本公司對大陸投資累計金額未超過主管機關所定投資金額或比例上限。淨值4,199,170千元 $\times$ 60% $\equiv$ 2,519,502千元；另盛通之限額計算為淨值21,662千元 $\times$ 60% $\equiv$ 12,997千元。

註5：經台灣母公司查核之財務報告。

3. 與大陸被投資公司間之重大交易事項：

本公司民國一〇七年度與大陸被投資公司直接或間接之重大交易事項，請詳「重大交易事項相關資訊」之說明。

十四、部門資訊

請詳民國一〇七年度合併財務報告。

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	106.12.31	107.12.31	差 異	
			金額	%
流 動 資 產	4,179,054	4,322,111	143,057	3
不 動 產 、 廠 房 及 設 備	414,729	398,515	(16,214)	(4)
其 他 資 產	770,487	834,874	64,387	8
資 產 總 額	5,364,270	5,555,500	191,230	4
流 動 負 債	1,068,788	1,079,483	10,695	1
非 流 動 負 債	196,636	251,918	55,282	28
負 債 總 額	1,265,424	1,331,401	65,977	5
股 本	2,261,682	2,261,682	0	0
資 本 公 積	142,309	142,309	0	0
保 留 盈 餘	1,699,004	1,832,565	133,561	8
股 東 權 益 總 額	4,098,846	4,224,099	125,253	3
重大變動項目說明：				
1、非流動負債較 106 年度期末增加，主要係遞延所得稅負債增加所致。				

二、財務績效

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

(一) 財務績效比較表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	106 年度	107 年度	增(減)金額	變 動 比例%
營業收入淨額	4,614,917	4,862,807	247,890	5.37
營業成本	2,425,457	2,455,833	30,376	1.25
營業毛利	2,189,460	2,406,974	217,514	9.93
減:未實現銷貨利益之變動	27,374	12,624	(14,750)	(53.88)
已實現營業毛利	2,162,086	2,394,350	232,264	10.74
營業費用	1,218,775	1,283,620	64,845	5.32
營業利益	943,311	1,110,730	167,419	17.75
營業外收入及利益	126,479	134,859	8,380	6.63
稅前淨利	1,069,790	1,245,589	175,799	16.43
所得稅利益(費用)	(133,803)	(175,223)	(41,420)	30.96
本期淨利	935,987	1,070,366	134,379	14.36
其他綜合損益(稅後淨額)	(11,703)	(76,197)	(64,494)	551.09
本期綜合損益總額	<u>924,284</u>	<u>994,169</u>	<u>69,885</u>	7.56
本期淨利歸屬母公司業主	926,188	1,063,990	137,802	14.88
本期淨利歸屬非控制權益	9,799	6,376	(3,423)	(34.93)
綜合損益歸屬母公司業主	914,470	987,931	73,461	8.03
綜合損益歸屬非控制權益	9,814	6,238	(3,576)	(36.44)

增減比例變動分析說明：

- 1、聯屬公司間未實現銷貨利益較 106 年度減少，主要係出貨至轉投資公司，而轉投資公司未出貨至終端客戶之未實現銷貨利益較 106 年度減少所致。
- 2、所得稅費用較 106 年度增加，主要係稅前淨利及所得稅率增加所致。
- 3、其他綜合損失較 106 年度增加，主要係透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資之未實現評價損失增加所致。

三、現金流量

最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析

(一) 107 年度現金流量變動分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流入量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
1,391,728	1,230,452	(1,104,548)	1,517,632	—	—
107 年度現金流量變動情形分析：					
1、營業活動：係營運持續獲利，致使營業活動淨現金流入。					
2、投資活動：存放三個月以上定存增加，致產生投資活動淨現金流出。					
3、融資活動：發放股東現金紅利，致產生融資活動淨現金流出。					

(二) 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流入量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
1,517,632	1,250,000	(1,150,000)	1,617,632	—	—
108 年現金流量情形分析：					
1、營業活動：係預期營運持續成長、獲利增加，致使營業活動淨現金流入。					
2、融資活動：係預期盈餘分派現金股息紅利增加，致產生融資活動淨現金流出。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

本公司轉投資主要係配合公司營運發展所需，建立完整之銷售及技術服務體系，107 年度依權益法認列之投資收益淨額為 97,105 仟元，轉投資狀況請參閱財務報告第 122 頁～第 125 頁附註十三之(二)說明。

1. 轉投資公司之獲利或虧損主要原因係與營收金額相關，本公司將致力於提昇轉投資公司之營收成長並控制成本費用，以改善其獲利狀況。
2. 未來之投資計劃仍以業務發展需求考量，於適當時機評估各項投資計畫。

六、風險事項分析：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

- 1.利率：本公司並無因利率變動，而對本公司損益有重大影響情事。本公司約當現金部位主要以投資銀行定存及貨幣型基金為主，往來之金融單位皆是國內外具有一定評比及規模之機構，以獲取穩定、安全之資金投資報酬。
- 2.匯率：為避免因匯率波動對本公司之營收及獲利造成重大影響，本公司除有專責人員每日觀察外匯市場變化及蒐集相關資訊外，並採取下列具體因應措施：
 - (1)業務單位向客戶報價前，先行對匯率走勢進行審慎評估，並綜合考量影響匯率升貶之各項因素，採取較合理穩健之匯率作為業務報價之基礎，以降低匯率變動對公司營收及獲利之影響。
 - (2)除與往來銀行與專業金融機構保持密切聯繫，期充分掌握國際匯率之走勢外，內部並定期檢討匯率走勢，針對外幣資金部位規範操作策略，另依避險需求採預售遠期外匯等方式，以降低匯率變動之衝擊。
 - (3)開立多種外幣帳戶，視實際資金需求或匯率走勢，調節所持之外幣部位，並盡量以同幣別之銷貨收入支應應付帳款，利用自動避險之特性已規避大部分之匯兌風險。
- 3.通貨膨脹：對本公司損益並無重大影響。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

- 1.本公司最近年度並無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人及背書保證業務，而若從事之衍生性商品交易，主要係為規避外幣存款、外幣應收及應付帳款匯率波動之變動風險，因係避險性質，並未對公司損益造成重大影響之虞。
- 2.本公司訂有「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」，所有程序均嚴格規範作業程序及風險控管，並責成相關單位依程序規定辦理，並未發生重大虧損之情事。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司以微控制器為產品發展主軸，聚焦在家電產品、健康量測、安全防護、電腦週邊、工業控制、車用電子、儀表顯示等領域之市場應用，每年以投入約營業額之 15%~20%作為研發經費，並結合上、中、下游資源進行策略聯盟，以維持公司之產品競爭力。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司對於最近年度國內外重要政策及法律變動皆已採取適當之因應措施，故相關政策及法律變動對於本公司財務及業務並無重大影響。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

面對半導體產業技術不斷提升，本公司除每年投入約營業額的 15%~20%作為研發經費，更因應 IC 設計產業分工日異明顯之趨勢，專注於微控制器 IC 及微控制器週邊 IC 之產品研發與市場開發，並與上游廠商配合使用先進技術，有充分能力因應科技改變及產業變化，為本公司財務及業務帶來正面挹注。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司秉持穩健經營之企業精神，致力於維持本公司既有之良好企業形象，並

且經由嚴格的內部控制及危機管理機制，有效防患於未然，確保企業永續經營。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1.本公司自成立以來營運狀況良好，且由於營運規模較大，代工廠會優先提供足夠產能。另為進一步分散進貨風險及在產能、製程技術、品質良率及交期掌握等綜合因素考量下，本公司亦積極尋找不同之代工產能，目前與數家晶圓大廠及封裝測試之代工廠商合作，並無進貨過度集中之情形。

2.本公司多年來積極開拓市場，客戶群遍佈國內外包含大陸在內之全球各主要市場，充分達到分散風險，避免銷售過度集中之虞。另加強授信管理及要求提供相當之擔保品，持續追蹤帳款收款情形，以期維持穩健的經營結果。

(十)董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：

1.資訊系統損害對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司由資訊整合處負責全公司資訊安全規劃，並依據資訊安全政策以控管及維持公司營運及會計等重要運作的功能，定期向總經理室報告執行情形。

控管作業如下：

(1)端點保護：端點指的是個人電腦與伺服器，其保護機制有：

A.防毒軟體：在個人電腦與伺服器安裝防毒軟體，以攔阻病毒與惡意程式，亦阻擋員工瀏覽惡意網站、釣魚網站等。

B.保持更新：作業系統與軟體的漏洞為資安問題的根本原因之一，保持作業系統與軟體的隨時更新，以有效降低漏洞與風險。

(2)網路保護：

A.新世代防火牆：因應越來越嚴峻的資安挑戰，傳統的防火牆已不敷使用，本公司引進新世代的防火牆，可依照應用程式類型來控管，更加安全。亦包含入侵預防系統，可監視網路或網路裝置的網路資料傳輸行為的電腦網路安全裝置，能夠即時的中斷、調整或隔離一些不正常或是具有傷害性的網路資料傳輸行為。

B.郵件保護：郵件寄到公司伺服器前，會先經過中華電信「郵件守門員」，可篩選掉垃圾、有病毒、勒索等郵件。

C.防駭機制：引進 FireEye 威脅防護平台(Threat Prevention Platform)，此為專為對抗網路犯罪及 APT 滲透攻擊(advanced persistent threat)所打造的防護解決方案，可提供應對高階網路威脅的自動威脅取證及動態惡意軟體防護服務。

(3)資料保護：

- A.備份資料：重要資料透過備份系統，每天晚上備份，本公司採用的備份媒體為硬碟，備份速度快且能卻可確保備份資料一定能還原。
- B.異地備份：透過網路與備份系統的 NetBackup Auto Image Replication 機制，在備份完成後立即將備份資料傳送一份到異地。

(4)健檢機制：

- A.自我檢測：每半年透過弱掃軟體來掃描伺服器，以找出伺服器的安全漏洞，並解決漏洞。
- B.委外檢測：與資安顧問公司合作，每年不定期透過網路收集封包、分析，以確保公司內的伺服器的安全；內部網路部份則配置 Deep Discovery Advisor(DDI)，對內部網路的可疑行為進行分析。若有資安問題可進而再向資安顧問小組請求協助，由熟悉 APT 攻擊的專家依據偵測、分析資料來鑑識，以處理之。

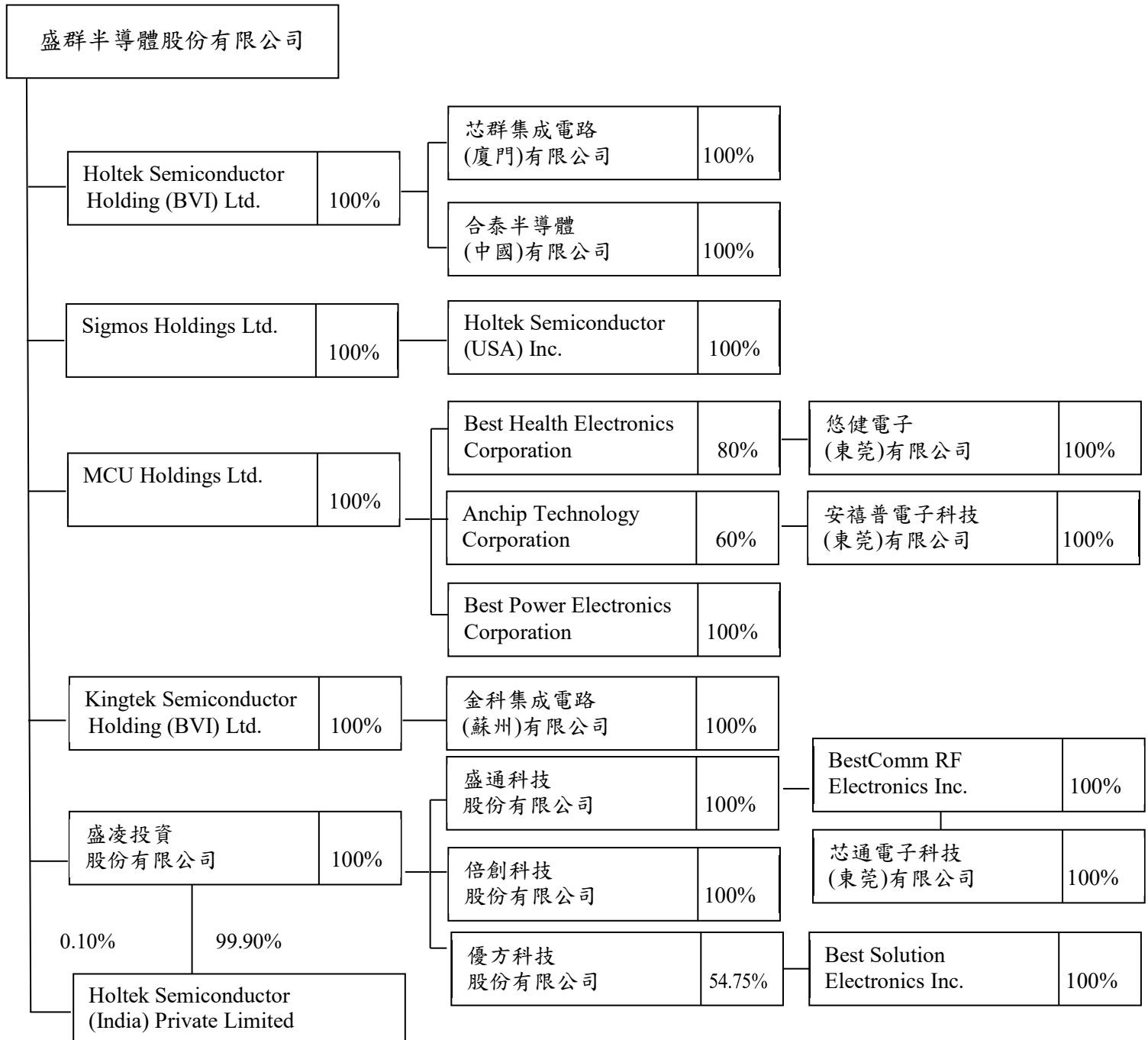
七、其他重要事項：無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業組織概況

1.關係企業組織圖



(二)關係企業基本資料

日期：107 年 12 月 31 日

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業項目
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	88.10	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US\$15,253,360	投資海外各項事業
Sigmos Holdings Ltd.	89.12	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US\$200,000	投資海外各項事業
MCU Holdings Ltd.	91.05	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US\$500,000	投資海外各項事業
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	91.01	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US\$2,000,000	投資海外各項事業
盛凌投資(股)公司	92.03	新竹市大同路 136 號 2 樓	NT\$429,826,000	專營投資業務
芯群集成電路(廈門)有限公司	97.02	中國廈門市軟件園二期觀日路 34 號 202 室	US\$3,500,000	單片機芯片及其應用工具的技術服務
合泰半導體(中國)有限公司	101.07	中國東莞市松山湖新竹路 4 號新竹苑 10 幢(辦公 101 號房)	US\$9,764,280	積體電路買賣及技術服務
Holtek Semiconductor (USA) Inc.	90.05	19 Hammond, Suite 513, Irvine, CA 92618, USA	US\$200,000	積體電路買賣及技術服務
Best Health Electronics Corporation	106.06	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	RMB\$6,000,000	健康量測應用 IC 銷售及技術服務
悠健電子(東莞)有限公司	106.09	中國東莞市松山湖新竹路 4 號新竹苑 10 幢辦公 301	RMB\$5,000,000	健康量測應用 IC 銷售及技術服務
Anchip Technology Corporation	104.11	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	RMB\$1,000,000	安防應用 IC 銷售及技術服務
安禧普電子科技(東莞)有限公司	105.11	中國東莞市松山湖新竹路 4 號新竹苑 10 幢辦公 401	RMB\$300,000	安防應用 IC 銷售及技術服務
Best Power Electronics Corporation	107.05	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	RMB\$2,000,000	電源管理 IC 銷售及技術服務
金科集成電路(蘇州)有限公司	91.04	蘇州工業園區星漢街 5 號 D 幢 3 樓 7/8 單元	US\$2,000,000	積體電路買賣及技術服務
盛通科技股份有限公司	103.01	新竹市大同路 136 號 2 樓	NT\$40,000,000	RF 應用 IC 銷售及設計業務
BestComm RF Electronics Inc.	103.03	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	RMB\$3,000,000	RF 應用 IC 銷售及設計業務
芯通電子科技(東莞)有限公司	107.01	中國東莞市松山湖新竹路 4 號新竹苑 10 幢辦公 201	RMB\$2,000,000	RF 應用 IC 銷售及設計業務
倍創科技(股)公司	105.05	新竹市金山十一街 20 巷 18 號 1 樓	NT\$10,000,000	MCU 模組之銷售及技術服務
優方科技(股)公司	97.05	臺北市南港區園區街 3 之 2 號 4 樓之 2	NT\$20,000,000	觸控應用 IC 銷售及設計業務
Best Solution Electronics Inc.	97.08	Portcullis Chambers, 4th Floor Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	US\$200,000	觸控應用 IC 銷售及設計業務
Holtek Semiconductor (India) Private Limited	107.04	1004, 10 th Floor, Prestige Meridian 1, MG Road Bengaluru – 560001	INR\$6,485,000	電子元器件及單片機芯片之技術支持與諮詢服務業務

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括電子元器件及單片機芯片之技術支持與諮詢服務業務及一般投資業務。

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料

日期：107 年 12 月 31 日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：吳啟勇	15,253,360	100%
	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：高國棟		
Sigmos Holdings Ltd.	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：高國棟	200,000	100%
	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：林正鋒		
MCU Holdings Ltd.	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：高國棟	500,000	100%
	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：林正鋒		
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：吳啟勇	2,000,000	100%
	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：高國棟		
盛凌投資(股)公司	董事長	盛群半導體(股)公司代表人：吳啟勇	42,982,600	100%
	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：高國棟		
	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：張治		
	監察人	盛群半導體(股)公司代表人：廖明通		
Holtek Semiconductor (India) Private Limited	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：高國棟	6,485,000	100%
	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：蔡榮宗		
	董 事	盛群半導體(股)公司代表人：古旭納		
	總經理	蔡榮宗	-	-
芯群集成電路(廈門)有限公司	董事長	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：吳啟勇	-	100%
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：高國棟		
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：張治		
	監察人	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：廖明通		
	總經理	張家志	-	-
合泰半導體(中國)有限公司	董事長	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：吳啟勇	-	100%
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：高國棟		
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：蔡榮宗		
	監察人	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：廖明通		
	總經理	蔡榮宗	-	-
Holtek Semiconductor (USA) Inc.	董 事	Sigmos Holdings Ltd.代表人：高國棟	200,000	100%
	董 事	Sigmos Holdings Ltd.代表人：蔡榮宗		
	總經理	王耀德	-	-
Best Health Electronics Corporation	董 事	MCU Holdings Ltd.代表人：林正鋒	4,800	80%
	董 事	MCU Holdings Ltd.代表人：王明坤		
Anchip Technology Corporation	董 事	MCU Holdings Ltd.代表人：王明坤	600	60%
	董 事	MCU Holdings Ltd.代表人：周玲娜		
	董 事	毛強	400	40%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
悠健電子(東莞)有限公司	董事長	Best Health Electronics Corporation 代表人：洪祥歲	-	100%
	董 事	Best Health Electronics Corporation 代表人：高國棟		
	董 事	Best Health Electronics Corporation 代表人：王明坤		
	監察人	Best Health Electronics Corporation 代表人：廖明通		
	總經理	洪祥歲	-	-
安禧普電子科技(東莞)有限公司	董事長	Anchip Technology Corporation 代表人：毛強	-	100%
	董 事	Anchip Technology Corporation 代表人：王明坤		
	董 事	Anchip Technology Corporation 代表人：周玲娜		
	監察人	Anchip Technology Corporation 代表人：廖明通		
	總經理	毛強	-	-
Best Power Electronics Corporation	董 事	MCU Holdings Ltd.代表人：林正鋒	2,000	100%
	董 事	MCU Holdings Ltd.代表人：王明坤		
金科集成電路(蘇州)有限公司	董事長	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：高國棟	-	100%
	董 事	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：吳啟勇		
	董 事	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：張治		
	監察人	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：廖明通		
	總經理	高國棟	-	-
盛通科技(股)公司	董事長	盛凌投資(股)公司代表人：吳啟勇	4,000,000	100%
	董 事	盛凌投資(股)公司代表人：高國棟		
	董 事	盛凌投資(股)公司代表人：王明坤		
	監察人	盛凌投資(股)公司代表人：廖明通		
	總經理	李文義	-	-
BestComm RF Electronics Inc.	董 事	盛通科技(股)公司代表人：吳啟勇	30,000	100%
	董 事	盛通科技(股)公司代表人：王明坤		
芯通電子科技(東莞)有限公司	董事長	BestComm RF Electronics Inc.代表人：李文義	-	100%
	董 事	BestComm RF Electronics Inc.代表人：高國棟		
	董 事	BestComm RF Electronics Inc.代表人：王明坤		
	監察人	BestComm RF Electronics Inc.代表人：廖明通		
	總經理	蕭見通	-	-
倍創科技(股)公司	董事長	盛凌投資(股)公司代表人：吳啟勇	1,000,000	100%
	董 事	盛凌投資(股)公司代表人：高國棟		
	董 事	盛凌投資(股)公司代表人：蔡榮宗		
	監察人	盛凌投資(股)公司代表人：廖明通		
	總經理	葉秉霖	-	-
優方科技(股)公司	董事長	盛凌投資(股)公司代表人：吳啟勇	800,000	40%
	董 事	盛凌投資(股)公司代表人：王明坤		
	董 事	欣宏電子(股)公司代表人：林既貴	737,500	36.875%
	監察人	新耕投資有限公司代表人：周玲娜	212,500	10.625%
	總經理	樂正平	125,000	6.25%
Best Solution Electronics Inc.	董 事	優方科技(股)公司代表人：王明坤	200,000	100%

(六)關係企業營運概況

日期：107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元(除每股損益為新台幣元外)

企業名稱	資本額	資產 總值	負債 總額	淨 值	營業 收入	營業利益 (損失)	本期(損)益 (稅後)	每股(損)益 (稅後)
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	475,831	747,988	223,513	524,475	799,957	0	43,268	2.84
芯群集成電路(廈門)有限公司	113,551	170,935	57,646	113,289	320,441	(435)	531	註 2
合泰半導體(中國)有限公司	292,423	481,257	154,823	326,434	629,806	31,865	35,312	註 2
Sigmos Holdings Ltd.	6,898	22,811	0	22,811	0	0	231	1.16
Holtek Semiconductor (USA), Inc.	6,898	23,627	816	22,811	28,593	218	231	0.12
MCU Holdings Ltd.	16,333	650,461	0	650,461	0	(91)	106,251	212.50
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	69,542	120,725	0	120,725	0	0	1,632	0.82
金科集成電路(蘇州)有限公司	69,712	242,982	122,297	120,685	317,574	1,792	1,630	註 2
盛凌投資(股)公司	429,826	490,807	34	490,773	0	(43)	19,229	0.45
優方科技(股)公司	20,000	50,773	11,922	38,851	18,456	493	12,044	6.02
Best Solution Electronics Inc.	6,140	136,347	95,804	40,543	476,012	8,063	15,636	78.18
盛通科技(股)公司	40,000	22,641	979	21,662	1,494	(3,862)	(3,356)	(0.84)
BestComm RF Electronics Inc.	14,054	12,530	1,742	10,788	30,265	2,875	434	14.47
芯通電子科技(東莞)有限公司	9,214	6,932	581	6,351	6,580	(2,588)	(2,574)	註 2
倍創科技(股)公司	10,000	10,516	621	9,895	1,538	(95)	(41)	(0.04)
Anchip Technology Corporation	5,071	4,950	746	4,204	8,571	2,084	1,438	1437.54
安禧普電子科技(東莞)有限公司	1,521	3,461	2,820	641	1,332	(649)	(647)	註 2
Best Health Electronics Corporation	26,410	32,646	4,310	28,336	39,603	7,562	1,755	292.55
悠健電子(東莞)有限公司	23,057	16,023	913	15,110	4,454	(5,984)	(5,930)	註 2
Best Power Electronics Corporation	8,844	8,940	0	8,940	0	(39)	(48)	(23.96)
Holtek Semiconductor (India) Private Limited	2,948	1,962	306	1,656	485	(1,181)	(1,186)	(0.18)

註 1：關係企業如為外國公司，相關數字係以報表日期之兌換匯率換算為新台幣列示，107.12.31 兌美元 30.665、人民幣 4.4459；印度盧比 0.4395。

註 2：係為有限公司，並未發行股份，故不列示每股損益。

(七)關係企業合併財務報表：

聲 明 書

本公司民國一〇七年度（自一〇七年一月一日至十二月三十一日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際會計準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：盛群半導體股份有限公司



董 事 長：吳 啟 勇



中 華 民 國 一 〇 八 年 一 月 二 十 八 日

(八)關係企業報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

五、依證券交易法第 36 條第三項第二款規定應揭露事項：無。

盛群半導體股份有限公司



負責人： 吳啟勇

